表紙のイメージ

「Technology Enabling Life」は、企業理念（基本理念、経営理念、ビジョン、TEL Values）を表現したコーポレートメッセージです。Best ProductsとBest Technical Serviceの提供により半導体の技術革新に貢献し、夢のある社会の発展を実現する様子を表しています。

東京エレクトロン株式会社
〒107-6325
東京都港区赤坂5-3-1 赤坂 Bizタワー
Tel.03-5561-7000
www.tel.co.jp

TELは、東京エレクトロン株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

PR3 62-0262

Technology
Enabling
Life

TOKYO ELECTRON

INTEGRATED REPORT 2024

東京エレクトロン
統合報告書 2024

編集方針

統合報告書の発行にあたって

東京エレクトロンは、ステークホルダーの皆さまに当社の中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上についてご報告することを目的として、統合報告書を発行しています。2024年版では、CEOメッセージに加え、中期経営計画の進捗、またマテリアリティの再特定やそれらを軸とした事業活動によるバリューチェーンの展開などについてご説明しています。今後も、ステークホルダーの皆さまからのご要請を的確に把握し、タイムリーかつ透明性の高い情報開示に努めていきます。

対象範囲

報告の対象範囲および関連データについては、東京エレクトロングループ（連結26社）としていますが、一部は日本国内のグループ会社のみを対象としています。

参考ガイドライン

- IFRS財団: 統合報告フレームワーク、IFRS S1号/S2号、SASBスタンダード
- 経済産業省: 価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス
- Global Reporting Initiative (GRI): GRIスタンダード
- 環境省: 環境報告ガイドライン2018年版
- 気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures) の提言

発行時期

2024年9月

対象期間

2024年3月期 (2023年4月1日～2024年3月31日)、一部2025年3月期も対象

お問い合わせ先

東京エレクトロン株式会社
〒107-6325　東京都港区赤坂5-3-1　赤坂Bizタワー
www.tel.co.jp/contactus/

当社に関する主な開示情報

- 統合報告書　www.tel.co.jp/ir/library/ar/
- 有価証券報告書　www.tel.co.jp/ir/library/fs/
- ファクトブック　www.tel.co.jp/ir/library/fb/
- 中期経営計画　www.tel.co.jp/ir/policy/mplan/
- サステナビリティウェブサイト　www.tel.co.jp/sustainability/index.html
- コーポレートガバナンス・ガイドラインおよび報告書　www.tel.co.jp/about/cg/index.html
- 会社案内　www.tel.co.jp/files/about/library/pv8va20000001ffv-att/corporate_guide_j.pdf

東京エレクトロンのロゴについて

東京エレクトロン（TEL）のコーポレートブランドロゴは、当社のさらなる成長に向けた象徴として、2015年に基本理念とビジョンをもとに考案されました。シンプルな造形は、誠実で公明正大な企業姿勢を示し、同時に企業としての存在感と信頼感を表しています。
ロゴの中心にある正方形は、産業のコアを担うテクノロジーの精度の高さを象徴し、若々しい生命感のあるグリーンが、私たちの事業の中心に人と自然環境があることを表しています。また、透明感のあるブルーのカラーは、先進性、未来感を表現しています。当社はこれからも最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します。

Contents

Chapter 1　東京エレクトロンについて

CEOメッセージ　3
企業理念体系　5
会社概要　7
継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト　9

Chapter 2　価値創造ストーリー

半導体製造装置事業の特徴　11
成長の原動力と強み　12
マテリアリティ　13
中期経営計画　15
価値創造モデル　23
ステークホルダーエンゲージメント　25

Chapter 3　バリューチェーンによる価値創造

バリューチェーンの取り組み　27
研究開発　29
調達・製造　33
販売　37
据付・保守サービス　41
バリューチェーンにおけるサステナビリティの取り組み　45
　人材　46
　人権　50
　環境　52
　安全　57
　品質　59
　サプライチェーンマネジメント　60
　業務効率化と新たな価値の創造　61
　知的財産マネジメント　62
　コーポレートガバナンス　63
　取締役会議長・社外役員座談会　71
　資本市場との対話　73
　コンプライアンス　73
　リスクマネジメント　75
　情報セキュリティ　77
　外部からの評価　78
　国際的なイニシアティブへの参画　78

Chapter 4　さらなる成長に向けて

中長期的な展望　79

データセクション

財務概況　81
11年間の主要財務データ　85
サステナビリティデータ　87
株式情報　94

Chapter 1 東京エレクトロンについて

CEOメッセージ

どのような状況でも経済活動が止まらない強くしなやかな社会の構築に向けて、半導体の技術革新を通じてデジタル化と地球環境保全の両立に貢献します。

代表取締役社長・CEO
河合 利樹

信用と信頼を礎にさらなる成長を目指して

ステークホルダーの皆さまには、平素よりご支援とご愛顧を賜り、心から感謝申し上げます。東京エレクトロンは昨年2023年11月11日に創立60周年を迎えました。1963年の創立以来、半導体産業の発展に貢献しこれまで成長を実現できましたのも、ひとえに皆さまのご支援のおかげでございます。当社は信用・信頼の構築を第一に「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念の実践を目指し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に取り組んでおります。

1947年にトランジスタが誕生して以来、PCやモバイルなどの電子機器、またインターネットやプラットフォームサービスなどが発展し、近年では本格的なデータ社会への移行が進んでいます。今後はAIや自動運転、バーチャルリアリティーなど、大規模な計算を必要とするアプリケーションがテクノロジードライバーとなり、市場がさらに成長していくことが予想されます。これらの動きを支えているのはまさに半導体の技術革新です。

このような状況において、半導体市場は2030年には1兆米ドルになることが見込まれています。これまで76年かけて5,300億米ドル規模に成長した市場が、わずか6~7年で約2倍になるということです。一方、さまざまなアプリケーションの運用においては高い情報処理能力とともに消費電力も増加していくため、地球環境保全への影響が危惧されています。そのため半導体には高速、大容量、高信頼性に加え、低消費電力を実現する革新的な技術が必要とされています。

半導体市場の成長に伴い、2022年から2026年までに世界で約100の半導体工場が新たに稼動するという予測もあり、当社が事業を展開する半導体製造装置市場もさらに拡大していくと考えられます。

攻めと攻めの経営により継続的に企業価値を向上

ビジョンの実現と中期経営計画

どのような状況でも経済活動が止まらない、強くしなやかな社会の構築に向けて、デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素が世界の潮流になっています。当社は半導体製造装置メーカーとしての専門性を生かし、半導体の技術革新を推進することで、デジタル化と地球環境保全の両立に貢献すべく、「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」というビジョンを掲げています。このビジョンは企業の独自の資源や専門性を活用して、社会課題を解決する“CSV”(Creating Shared Value) の考え方に基づいています。当社としてのCSVを“TSV”(TEL's Shared Value) と定め、事業活動において社会的価値と経済的価値の創出に努めていきます。

TSVを実践する中で、中期経営計画における財務目標として、2027年3月期までに売上高3兆円以上の規模で営業利益率35%以上、ROE30%以上を設定しております。「利益は製品とサービスの価値の大きさを示す尺度」であると捉え、革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceの提供により、ワールドクラスの営業利益率とROEを目指していきます。

これらを追求することは、当社における“攻め”の経営です。同時に、企業の継続的な成長に向けて不可欠なSafety、Quality、Complianceなどにも注力していきます。これらの項目は一般的には守りであると捉えられていますが、より積極的に取り組むことで当社の強み、すなわち“攻め”にしていきたいと考えています。このような“攻めと攻め”の経営を推進し、私のCEOミッションでもある短期および中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を確実に実現していくことで、真のグローバルエクセレントカンパニーを目指してまいります。

マテリアリティを軸とした事業活動

当社では中期経営計画の達成を目指すにあたり、事業において優先して取り組む重要事項をマテリアリティとして特定しています。2024年3月期には、これまでのマテリアリティである「製品競争力」「顧客対応力」「生産性向上」「経営基盤」について、当社における意義や社会における意義を考慮し、より細分化した内容に見直しをおこないました。

さらなる成長に向けた取り組み

当社の強みは、①半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセスに製品をもつ世界で唯一のメーカーであること、②半導体の進化に必要なEUV露光用の塗布現像装置のシェアが100%であること、③当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、いずれも市場シェア1位、もしくは2位を獲得していること、④世界最大の出荷実績 (約92,000台) を通じて培ったお客さまとの絶対的信頼関係のもと展開する技術サービスとマーケティング、⑤特許保有件数が23,000件を超えており業界においてグローバルNo.1であることが挙げられます。

これらの強みを生かし、中期経営計画の達成とその後のさらなる成長に向けて、2025年3月期からの5年間で研究開発投資1.5兆円以上、設備投資7,000億円以上を計画しています。

“ナンバーワン”、“オンリーワン”の強いnext-generation productsをタイムリーかつ継続的に創出することは、当社の生命線です。自社の研究開発に加え、お客さまやコンソーシアムとの協働などにより世界一の性能をもつ付加価値の高い装置の提供に努め、研究開発の成果を効率的に利益につなげていきます。

またビジネス規模の拡大とともに、生産効率を向上することが重要です。デジタルトランスフォーメーションの展開により、さまざまなオペレーションにおける業務の標準化や平準化の推進、製造現場におけるSmart Manufacturingの導入などを積極的におこなっていきます。

E-COMPASSによる環境負荷の低減とネットゼロ

社会において地球環境保全の重要性がより一層高まる中、当社では環境にフォーカスしたE-COMPASSにより、さまざまな活動を展開しております。具体的には以下の3つの観点において、お客さまやパートナー企業さまと連携し、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減に取り組んでおります。

- ☑ 半導体の高性能化と低消費電力化に貢献
- ☑ 装置のプロセス性能と環境性能の両立
- ☑ 事業活動全体におけるCO_2排出量の削減

これらの取り組みを進める中で2023年12月には、当初2050年としていた長期環境目標ネットゼロの達成時期を2040年へ前倒しし、温室効果ガスの削減に努めています。

やる気重視経営の実践

「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、社員が能力を最大限に発揮できるよう、次の5つのポイントを中心に社員のやる気を重視した経営に取り組んでいます。

やる気重視経営の5つのポイントと主な取り組み

1. **自分の会社や仕事が産業や社会の発展に貢献しているという実感**
   ➡ TSVに基づいたビジョンの実現
2. **会社の将来に対する夢と期待**
   ➡ 売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を達成
3. **チャレンジできる機会**
   ➡ 5年間で1.5兆円以上の研究開発費を投入
4. **成果に対する公正な評価とグローバルに競争力のある報酬**
   ➡ 業績連動型報酬
5. **風通しの良い職場**
   ➡ グローバルでの社員集会や社員との座談会の開催

また「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」というスローガンのもと、3G、すなわちGlobal (国籍)、Gender (性別)、Generation (世代) を大きなテーマとして捉え、人材の多様性の確保に取り組むとともに、ワーク・ライフ・バランスの向上、社員のキャリアパスに向けた施策や教育プログラムの充実化を進めています。

サステナブルな業界の発展を視野に

当社は、半導体製造装置のリーディングカンパニーとして社内のみならずサプライチェーンマネジメントと未来を背負う学生や研究者などの育成もミッションと捉え、積極的に取り組んでいきます。サプライチェーンについては先に述べたE-COMPASSの一層の充実化を図るとともに、人材育成の強化については国内外の大学とのコラボレーションを含む産学官連携プログラムの推進などを通じ、業界のサステナブルな発展に貢献してまいります。

皆さまに愛され信頼される企業を目指して

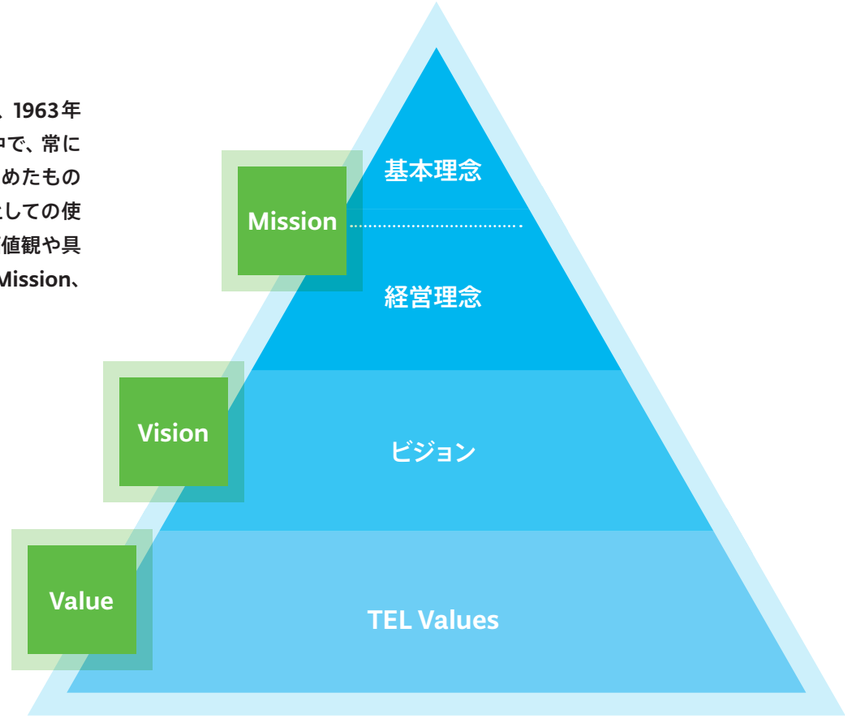
半導体が実現する豊かな未来、進化し続ける半導体、それを支える製造装置市場は新たな成長フェーズに入りました。東京エレクトロンは世界No.1を目指して、これからも挑戦と進化を続け、当社だからできる付加価値の高い世の中にない技術を創造し、社会に提供してまいります。そして、すべてのステークホルダーに愛され、高く信頼され、夢と活力のある会社であり続けられるよう努めてまいります。

引き続き、皆さまのご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長・CEO

企業理念体系

東京エレクトロンの企業理念体系は、1963年の創業当時より今日に至る成長の中で、常に基本としてきた経営の考え方をまとめたものです。中長期的な視点から、企業としての使命とその実現に向けて大切にする価値観や具体的な行動のあり方などを表し、Mission、Vision、Valueで構成されています。



Mission 基本理念 当社の存在意義 (Purpose) や社会的使命

最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します

People. Technology. Commitment.

経営理念 大切にすべき経営の規範

利益について
社会や産業の発展に貢献すべく、利益の追求を重視し企業価値の向上を目指します。

事業分野について
エレクトロニクスを中心とする最先端技術分野において、高品質な製品を提供し市場をリードします。

成長について
技術革新に常に挑戦し、事業拡大と市場創出により継続的な成長を図ります。

品質とサービスについて
顧客の満足と信頼を得るために真のニーズを理解し、品質とサービスの向上に努めます。

社員について
社員は価値創出の源泉であり、創造性と責任感と強いチームワークで情熱をもって業務に取り組みます。

組織について
個々の能力を最大限に発揮し、企業価値を最大化する最適な組織を築きます。

安全と健康と環境について
事業に関わるすべての人々の安全と健康、および地球環境への配慮を第一に考えて行動します。

企業の社会的責任について
企業としての社会的責任を自覚し、社会から高く評価され社員が誇りを持てる企業であるよう心がけます。

Vision ビジョン 基本理念と経営理念に基づき中長期的に実現したい事業像

半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社

東京エレクトロンは、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求します。

当社の専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

そして、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置づけ、ステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

Value TEL Values 社員一人ひとりが遵守すべき心構えや行動規範、価値観

誇り

私たちは、自らが誇りをもてる高い価値をもった製品・サービスを提供します。

最先端の技術製品を最高の品質・技術サービスとともに提供し、お客さまの真の満足を追求します。利益は製品・サービスの価値の大きさを示す尺度であると考え、それを大切にします。

オーナーシップ

私たちは、オーナーシップをもって、考え抜き、やり抜き、やり遂げます。

常に問題意識をもち、課題には情熱と責任感をもって取り組みます。意思決定を早くし、良いと考えることはすばやく実行します。

自覚

私たちは、社会の一員としての自覚をもち、責任のある行動をします。

法令と社会のルールを遵守します。安全と健康および地球環境への配慮を最優先に考えます。地域社会から高く評価される会社であるよう心がけます。

チャレンジ

私たちは、世界No.1を目指し、新しいこと、人のやらないことにチャレンジします。

変化をチャンスと捉え、柔軟かつ積極的に行動します。失敗に対して寛容であるとともに、そのプロセスと結果から学ぶことを重視します。

チームワーク

私たちは、お互いを認め合い、チームワークを大切にします。

オープンに意見を交わし、風通しの良い職場をつくります。ビジネスパートナーとお互いに信頼し、成長できる関係を築きます。

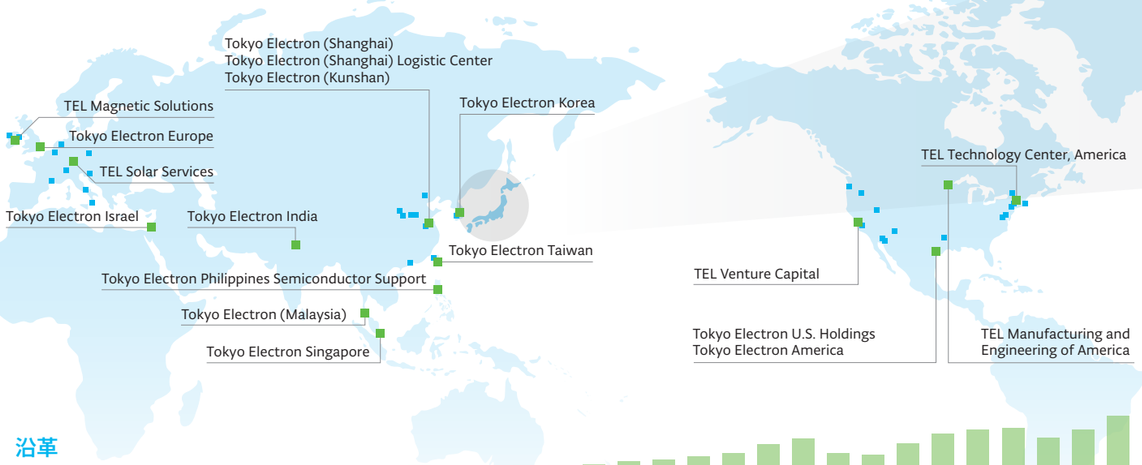
TEL Valuesは、私たちが積み上げてきたものであり、これからも自分たちの手によって積み上げていくものです。

会社概要

当社は、半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとしてグローバルに事業を展開しています。Best Products、Best Technical Serviceにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。事業を通じてサステナブルな社会の構築と発展に貢献することで、基本理念を実践していきます。

拠点数 (2024年4月1日現在)

■本社　■支社、事業所 (サービス拠点を含む)、営業所



国内
6社・**27**拠点

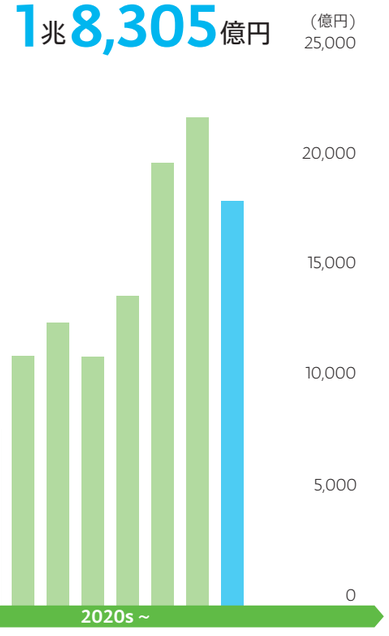
海外
20社・**18**の国と地域・**60**拠点

合計
26社※・**19**の国と地域・**87**拠点
(連結)

※ 現在清算整理中の会社は地図上に表記していません

売上高

2024年3月期
1兆8,305億円



沿革

1960s ~ 技術専門商社として創業

1963
(株) 東京放送の出資により (株) 東京エレクトロン研究所を設立

1964
米国サームコ社から拡散炉の輸入販売代理権を獲得し、販売を開始

1968
テル・サームコ(株)で拡散炉の国内生産を開始

1980s ~ 本格的にメーカーへ移行

1978
(株) 東京エレクトロン研究所から東京エレクトロン (株)へ商号変更

1980
東京証券取引所市場第二部に上場

1984
東京証券取引所市場第一部に指定替え

1986
半導体製造装置の輸出を開始

1990s ~ グローバリゼーションを加速

1990s
サービスや製造を担う会社の設立など国内グループ体制を強化、事業のグローバル化を推進するため世界各国に現地法人を設立

1990
フラットパネルディスプレイ製造装置市場へ本格参入

2000s ~ イノベーションと成長を志向

1994
海外での直接販売・サポート体制を開始

1999
東京証券取引所市場第一部における業種変更「商業」から「電気機器」へ

2006
行動規範として「TEL Values」制定

2007
人材開発強化のため「TEL UNIVERSITY」設立

2015
東京エレクトロン コーポレートガバナンス・ガイドラインを制定

新生TELとして再出発 (ビジョン、中期経営計画の策定、コーポレートロゴ刷新)

2019
企業価値のさらなる向上を目指し中期経営計画を策定

2020s ~

2021
統合報告書の発行を開始

2022
東京証券取引所プライム市場に指定替え

新たなビジョンと中期経営計画を策定

コーポレートメッセージとしてTechnology Enabling Lifeを制定

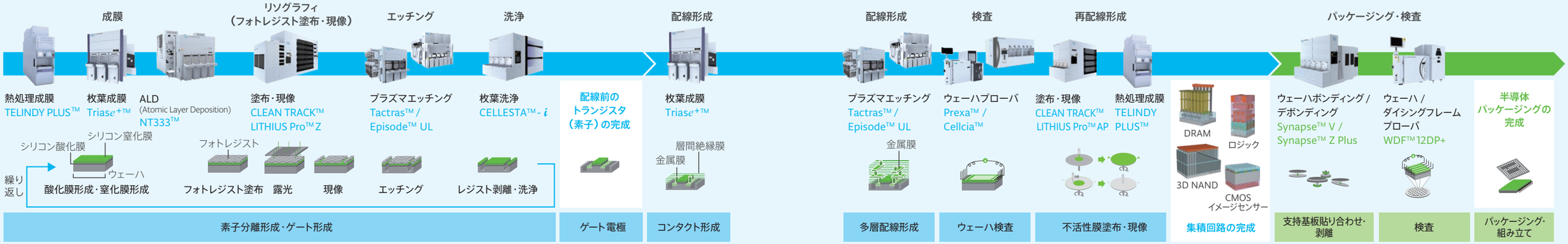
2023
創立60周年

半導体の代表的な用途の変遷

Mainframe Computer → Single Chip Microprocessor → Personal Computer → Mobile Phone → Digital Consumer Electronics → Big Data

半導体製造プロセスおよび当社の主要製品

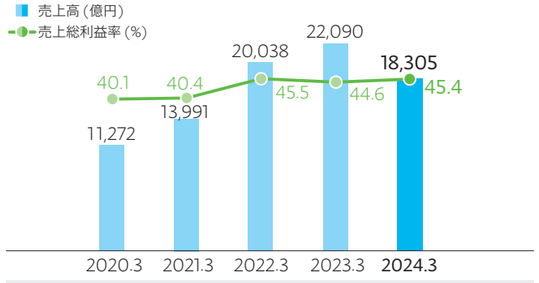
■ウェーハ処理プロセス (前工程)　■検査・組み立てプロセス (後工程)



継続的な企業価値の向上に関する重要指標ハイライト

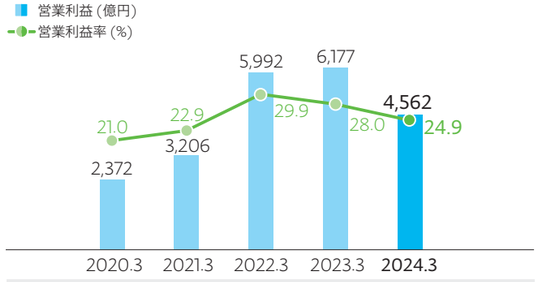
当社では、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上において重要である経営上の指標を明確にし、モニタリングや分析を実施することにより、事業活動における方針の決定やさまざまな判断をおこなっています。

売上高と売上総利益率



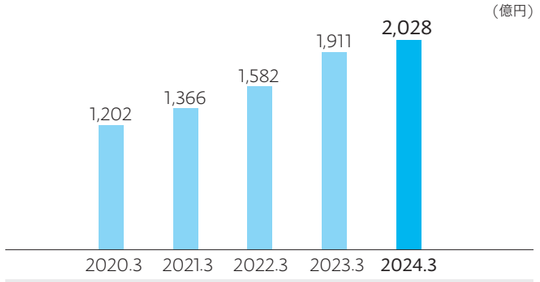
お客さまの設備投資の調整により売上は減少したものの、売上総利益率は、高利益率製品の売上増加により過去最高水準を維持

営業利益と営業利益率



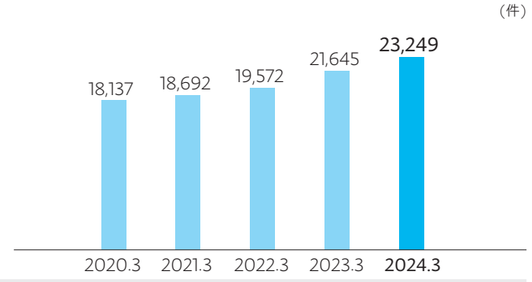
市場の調整期においても、将来に向けた研究開発投資を継続し、営業利益と営業利益率は減少

研究開発費



2024年3月期は2,028億円の研究開発投資を実施。中期経営計画の目標である1兆円に対して順調に進捗。さらなる成長投資として、2025年3月期からの5年間で1.5兆円以上の研究開発投資を計画

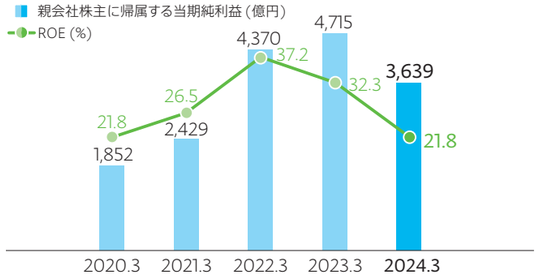
特許保有件数※6



2024年3月末時点の特許保有件数は23,249件であり、昨年に引き続き半導体製造装置業界でNo.1。量と質の両面で競争力のある知的財産権ポートフォリオを構築し、知的財産領域における優位性をグローバルレベルで維持

※6 2020年3月期~2022年3月期は社内データ、2023年3月期~2024年3月期はLexisNexis®PatentSight®データに基づき作成

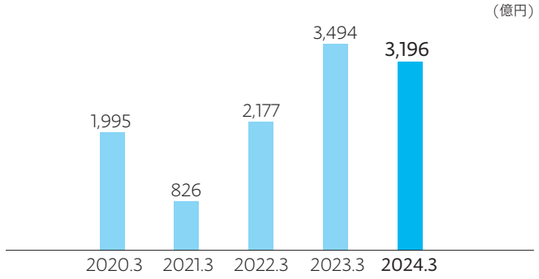
親会社株主に帰属する当期純利益とROE※1



営業利益の減少に伴う親会社株主に帰属する当期純利益は減少に加え、自己資本の増加により、ROEは減少

※1 ROE（自己資本利益率）＝親会社株主に帰属する当期純利益÷期首・期末平均自己資本×100

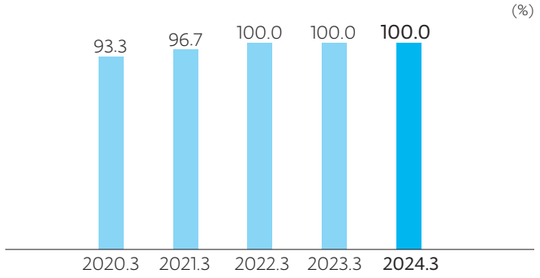
フリーキャッシュ・フロー※2



売上債権の回収が進んだものの、親会社株主に帰属する当期純利益の減少、および将来の市場成長に対応するための設備投資の増加により、前期比減少

※2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

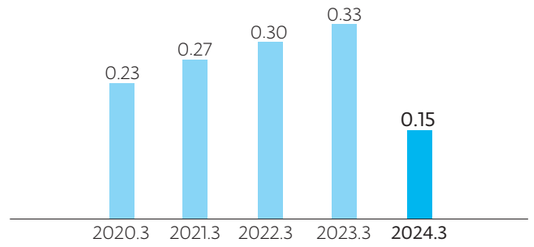
顧客満足度調査「大変満足」・「満足」回答割合※7



2024年3月期は前期に引き続き「大変満足」・「満足」の回答を選択した割合100%を達成。今後もお客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーであることを目指し、創業以来の重要テーマである顧客満足のさらなる向上に取り組む

※7 ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出

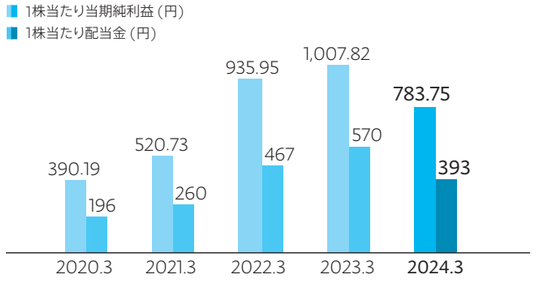
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率（TCIR※8）



2024年3月期は、安全教育の強化や装置安全設計への継続的な取り組みなどにより、半導体製造装置業界トップクラスの0.15を達成。「Safety First」をスローガンに、中期経営計画の目標である0.10以下に向けてさまざまな活動を実施

※8 TCIR: Total Case Incident Rate

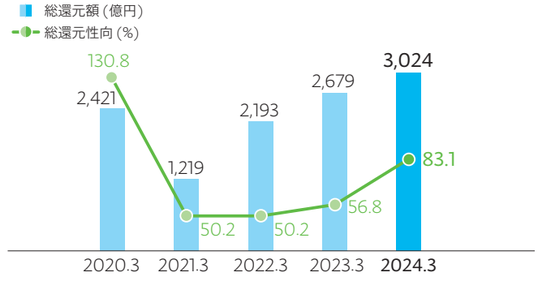
1株当たり当期純利益と1株当たり配当金※3 ※4



親会社株主に帰属する当期純利益の減少により、1株当たり当期純利益、1株当たり配当金も減少

※3 いずれも株式分割反映後の数値
※4 連結配当性向: 50%。ただし、1株当たり年間配当金50円を下回らない。2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

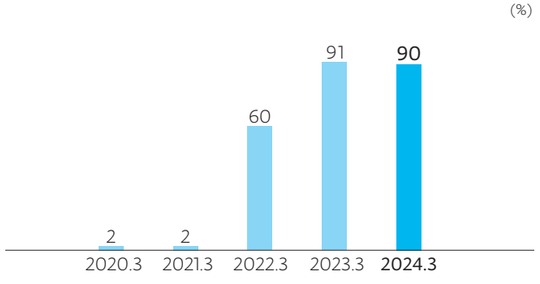
総還元額と総還元性向



支払配当金額は減少したものの、自己株式の取得※5により総還元額は前期比増加

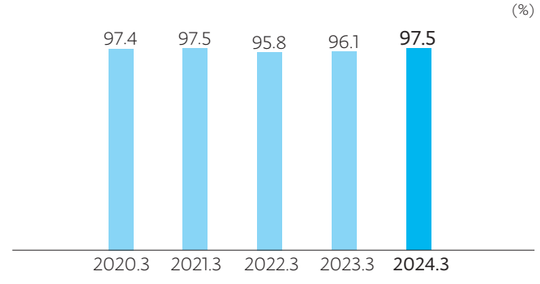
※5 自己株式の取得: 機動的に実施を検討

事業所における再生可能エネルギー使用比率



2024年3月期の使用比率はグローバルで90%（日本国内は100%）。再生可能エネルギー未導入地域への導入を推進するなど、新たに設定した事業所のCO_2総排出量85%削減（2019年3月期比、2031年3月期まで）の達成に向けて取り組みを展開

社員の定着率※9



2024年3月期はグローバルで97.5%の高い定着率を維持。社員が価値創出の源泉であるとの認識のもと、社員エンゲージメントのさらなる向上を目指して継続的かつ効果的に施策を展開

※9 離職率のデータを用いて算出

Chapter 2 価値創造ストーリー

半導体製造装置事業の特徴

AIやIoTの普及に伴いデータ社会への移行が加速し、半導体が担う役割はますます重要になっています。デジタル技術の活用がさらに拡がり、半導体の技術革新が進む中、それを支える半導体製造装置の重要性もより一層高まっています。

半導体製造装置メーカーが継続的に事業を展開するためには、さまざまな領域の専門性を駆使し、最高の性能を備えた装置を開発することが極めて重要です。そのためには、お客さまとの確固たる信頼関係のもと早期にニーズを把握し、中長期視点での研究開発に取り組むとともに、最先端技術の創出に向けてコンソーシアムとの協働を進め、グローバルに研究開発を展開していく必要があります。そして、これらの活動を継続的かつ確実に実施するための設備投資と強固な経営・財務基盤が不可欠です。

また、装置の安定稼動を支える付加価値の高い技術サービスを提供していくことも重要です。そのために、AIの活用などデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進も積極的におこなわれています。

これらに加えて、部品・材料の供給、装置の組み立てや調整、通関・物流などに関わるさまざまなサプライヤーとのパートナーシップに基づくサステナブルなサプライチェーンの構築も欠かすことはできません。さらに高性能・低消費電力の半導体開発への貢献や製造装置の生産性向上、環境負荷低減への対応も半導体製造装置メーカーに求められています。

半導体の技術革新が製造装置市場の成長を牽引

成長の原動力と強み

当社は、創業時より大切にしているステークホルダーとの信用・信頼を礎に独自のビジネスモデルを展開するとともに、「業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力」や、「確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼」、また「環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレンジ精神」を成長の原動力として培ってきました。これらの原動力により創出される強みを当社の事業活動における優位性として最大限に生かすことでさらなる成長を図り、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めています。

成長の原動力

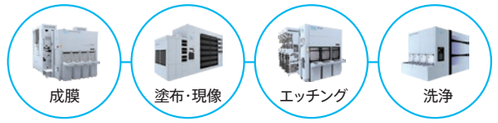
原動力 1
業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力
積極的な研究開発投資により自社開発およびお客さまとの共同開発、また世界屈指のコンソーシアムとの協業を推進することで革新的かつ多様な技術を創出

原動力 2
確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼
高品質かつ高効率なサービスの提供により顧客満足の向上に努め、お客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーとなる

原動力 3
環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレンジ精神
「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、社員のやる気を重視した経営を推進し夢と活力のある会社を実現

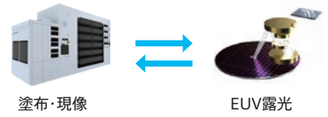
強み

Only one
半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセスに製品をもつ世界で唯一のメーカー



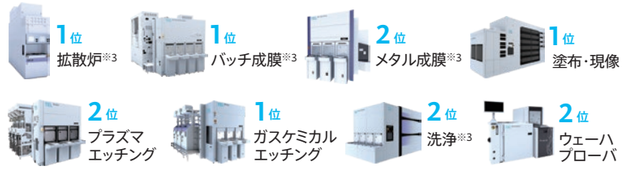
100%
半導体の進化に必要なEUV※1露光用の塗布現像装置のシェアが100%

※1 EUV: Extreme Ultraviolet。半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称



No.1 /No.2
当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、いずれも市場シェア※2 1位もしくは2位を獲得

※2 当社推定（2023年）
※3 各セグメントにおける当社の製品群: 拡散炉は熱処理成膜、バッチ成膜はALD (Atomic Layer Deposition) とCVD (Chemical Vapor Deposition)、メタル成膜は枚葉成膜、洗浄は枚葉洗浄とバッチ洗浄をそれぞれ含む



No.1
世界最大の出荷実績を通じて培ったお客さまとの絶対的信頼関係のもと展開する技術サービスとマーケティング

※4 2024年3月末時点

No.1
特許保有件数が半導体製造装置業界においてグローバルNo. 1

※5 2024年3月末時点。LexisNexis®PatentSight®データに基づき作成

マテリアリティ

当社はビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指す上で、優先して取り組む重要事項をマテリアリティとして位置づけ、毎年見直しをおこなっています。2024年3月期には以下の特定プロセスに沿って、既存のマテリアリティをより細分化した内容に見直し、新たにマテリアリティを特定しました。

優先して取り組むべき重要事項（マテリアリティ）

- ビジョンの実現による基本理念の実践
- 中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上

マテリアリティの特定プロセス

マテリアリティの特定にあたり、そのプロセスの検討については第三者である専門家の助言を受けています。

環境分析・課題の抽出

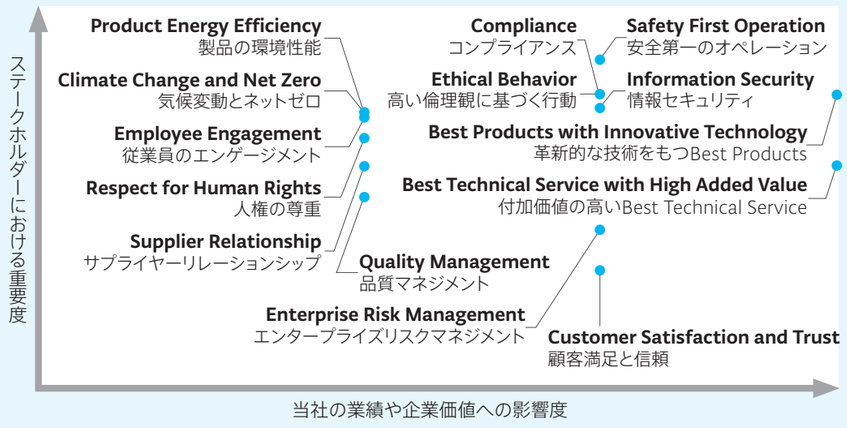
社会における課題やSDGsの取り組み状況、事業を取り巻く環境、ステークホルダーとのエンゲージメント結果※1、また当社の事業活動における重要リスク※2などを分析し、マテリアリティ候補となる課題を抽出しました。

社会における課題
- 気候変動、人権問題、地政学上の対立、サプライチェーンマネジメント、サイバーセキュリティ、物価高騰など

事業を取り巻く環境
- データ社会への急速な移行に伴う半導体および半導体製造装置市場のさらなる拡大、地球環境保全への対応、人権尊重の取り組み、コーポレートガバナンスのさらなる強化など

優先順位づけ・マッピング

抽出した課題について、ステークホルダーへの影響や関心を踏まえた「ステークホルダーにおける重要度」と、当社の継続的な企業価値の向上を見据えた「当社の業績や企業価値への影響度」との二軸で評価を実施し、マッピングをおこないました。



マテリアリティの特定

CEOが参加するコーポレートオフィサーズ・ミーティングにおける討議と決議、取締役会での報告と承認を経て、重要事項と評価した課題をマテリアリティとして特定しました。
加えて、継続的な企業価値の向上に関する重要指標※3との関連性や取り組むSDGsについて確認をおこないました。
また、バリューチェーンにおける主なマテリアリティの取り組みを明確にしました。

※1 ステークホルダーエンゲージメント P. 25-26　※2 リスクマネジメント P. 75-76　※3 継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P. 17-20

特定したマテリアリティ

マテリアリティ	マテリアリティの意義		取り組むSDGs
	当社における意義	社会における意義	
Climate Change and Net Zero 気候変動とネットゼロ	ネットゼロの達成に向けた事業や製品・サービスにおける環境負荷の低減	気候変動リスクの低減と新たな機会の創出	7, 13
Product Energy Efficiency 製品の環境性能	製品の環境性能強化およびプロセス性能との両立	環境に配慮した製品の提供による地球環境の保全	12, 13
Best Products with Innovative Technology 革新的な技術をもつBest Products	革新的な技術をもつ付加価値の高い製品の創出による優位性の確立	半導体の進化によるイノベーションの促進と社会の発展	9, 13
Best Technical Service with High Added Value 付加価値の高いBest Technical Service	お客さまの課題を解決する高度なフィールドソリューションの提供により事業機会を拡大	半導体デバイスの歩留まり向上と装置稼動率の最大化	9, 12
Customer Satisfaction and Trust 顧客満足と信頼	唯一無二の戦略的パートナーとして顧客満足を追求し絶対的な信頼関係を構築	投資対効果の最大化や共創による相互利益の拡大	8, 17
Supplier Relationship サプライヤーリレーションシップ	開発や改善、品質向上などの活動を協業により推進	サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化	9, 17
Respect for Human Rights 人権の尊重	事業活動における人権リスクの低減と個人の尊厳の尊重	差別や不平等、労働や安全などの課題の解決	10, 16
Employee Engagement 従業員のエンゲージメント	個人が能力を最大限に発揮しいきいきと活動ができる環境の構築	ステークホルダーに有益なさまざまな価値を提供	8
Safety First Operation 安全第一のオペレーション	安全を最優先とすることで持続的なオペレーションを実現	安全な社会の構築	12
Quality Management 品質マネジメント	品質優先のオペレーションによる経営効率の追求	品質向上による競争力の強化と新たな価値の創出	12
Compliance コンプライアンス	企業の信頼性と持続的な成長の基盤として法令や規制および業界行動規範などの遵守	コンプライアンス意識の向上やコンプライアンス文化の醸成	16
Ethical Behavior 高い倫理観に基づく行動	社会的責任を自覚し従業員が誇りと幸せを感じることができる企業を目指す	公正で秩序のある社会の形成	16
Information Security 情報セキュリティ	サイバー攻撃や情報漏洩などへの対応によりデータの活用と情報セキュリティの両立	利便性を損なうことなく情報の安全性を確保	9
Enterprise Risk Management エンタープライズリスクマネジメント	事業上のリスクやその影響について適切に対応することで持続的な成長を図る	産業や社会の中長期的な発展に貢献	8, 9

中期経営計画

当社は「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、技術革新のスピードが速いエレクトロニクス産業の中で半導体製造装置のリーディングカンパニーとしてビジネスを積極的に展開しています。2023年3月期にはさらなる成長を目指して「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」という新たなビジョンを掲げるとともに、中期経営計画を発表し、その達成に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

財務目標

中期経営計画においては将来の成長に向けて、ワールドクラスの営業利益率とROE (自己資本利益率) のさらなる向上を目指し2027年3月期をターゲットとした財務目標を設定しました。半導体の重要性が一段と高まり、半導体製造装置市場が今後も大きく成長し続けることが予想される中、バリューチェーンにおけるマテリアリティを軸としたさまざまな取り組みを進めるとともに、Best Products、Best Technical Service を常に追求し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

	2024年3月期実績	財務目標 (達成時期: 2027年3月期)
売上高	1兆8,305億円	3兆円以上
営業利益率	24.9%	35%以上
ROE	21.8%	30%以上

主な取り組み※1

- 当社が得意とする分野や蓄積された技術、経営ノウハウが生きる分野でビジネスを展開
- 将来、お客さまが必要とする高付加価値のnext-generation productsをいち早く市場に投入し、最高水準の技術サービスを提供
- 2023年3月期からの5年間で1兆円以上の積極的な研究開発投資を実施
- 当社がこれまで出荷した業界最多となる約92,000台※2の装置をもとにパーツ販売やアップグレード改造、稼動率向上に取り組み、お客さまが生産するデバイスの歩留まり向上などの課題解決に努めるとともに、これらの高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットにおける収益拡大を図る。また今後、累積100,000台以上となる出荷済装置のサポートに備え、遠隔保守サービスおよび装置の稼動データやAIを活用した予知保全など、高効率かつ高付加価値サービスの構築にも注力
- サプライチェーン全体における地球環境の保全を目指したE-COMPASSを展開。製品や事業所における環境への取り組みを強化すべく、2031年3月期までの中期環境目標とその達成に向けたロードマップを策定し、さまざまな活動を実施。また2040年※3までのネットゼロ達成に向けて、温室効果ガスの排出量実質ゼロを実現する取り組みを推進

※1 これらの取り組みに加え、さらなる高い利益の創出と企業価値の向上を目指し、2025年3月期以降の5年間の成長投資、人材投資を計画。
研究開発投資: 1.5兆円以上、設備投資: 7,000億円以上、人材採用: グローバルで10,000名の採用 (5年累計)
※2 2024年3月末時点
※3 2023年12月にネットゼロの目標達成年を2050年から2040年に前倒し

ビジョン 半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社

短中長期の利益の拡大と継続的な企業価値の向上

財務目標 (2027年3月期): 売上高 3兆円以上、営業利益率 35%以上、ROE 30%以上

売上高
- SAM※4の拡大およびシェア向上
- 付加価値の高い次世代装置の継続的な創出
- 高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットにおける収益拡大
- 研究開発費の投入

営業利益率
- キャッシュ・フローの拡大
- 業務効率化、生産平準化および仕様・部品の標準化による生産性向上
- 社員エンゲージメントの向上
- ワーク・ライフ・バランスの実現
- 安全性向上: TCIR 0.10以下

ROE
- 資本効率の追求
  適切なキャッシュアロケーションとバランスシート・マネジメント
- 資産効率の追求
  生産・スタートアップリードタイム短縮、適正在庫水準の追求、設備投資効率の向上

※4 SAM: Served Available Market

財務責任者メッセージ

当社はビジョンの実現と財務目標の達成に向けて、以下の戦略や政策を実践するとともに、資本市場との対話を通じて企業価値・株主価値の向上に寄与してまいります。

川本 弘
常務執行役員
ファイナンス本部
ディビジョンオフィサー

1 成長戦略

- 売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE30%以上を2027年3月期までに達成する中期財務目標を設定
- 前中期経営計画で達成した営業利益率 (29.9%)、資産効率をさらに高め、キャッシュ・フローの拡大に努めることで、ROE向上など高い資本効率を追求
- 創出したキャッシュを社会の持続的な発展を支える半導体の技術革新を生み出すための成長投資、人材投資に活用

これらに加え、2025年3月期からの5カ年計画として、以下の内容を2024年2月に公表いたしました。今後もさらなる成長に向けたさまざまな取り組みを加速してまいります。

- 1.5兆円以上となる積極的な研究開発投資
- 研究開発および生産能力の拡大、生産性向上に向けた7,000億円以上の設備投資
- グローバルで累計10,000名の人材採用

2 財務戦略

- 事業拡大を見据えた運転資金の確保による経営の安定化
- 強固な財務体質の維持
- 適切なキャッシュアロケーション、バランスシート・マネジメントの追求

当社はこれまで半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとして大きな成長を遂げてきました。今後も次の成長投資に向けてキャッシュを有効活用し、高い成長ポテンシャルをもつ分野でさらなる事業の拡大を追求することで、中長期的な企業価値の向上に努めていきます。そして中期財務目標の具現化に向けて、これをサポートする財務戦略を実行してまいります。

3 資本政策

- 自社の企業価値の的確な把握と株価や時価総額の評価
- 資本コストや資本収益性を意識した最適な資本構成の実現
- キャッシュ・フロー拡大に基づく継続的かつ積極的な株主還元の実行

近年の高い利益成長の実績と将来に向けたさらなる成長への期待を背景に、当社の時価総額は高い伸びを示しており、2024年3月末時点の時価総額は東京証券取引所プライム市場第3位となりました。また2024年3月末時点のPBR (株価純資産倍率) は10倍以上の水準となっております。同時に当社が掲げる積極的な株主還元方針、高水準の成長投資、経営戦略に基づく優秀な人材の確保および育成、お客さまやお取引先さまとの協業やその成果など、当社の企業価値が資本市場で評価された結果、純資産と比較して時価総額が大きく増加しました。

時価総額の推移

4 株主還元策

- 株主さまへの配当については業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する連結配当性向50%を目処とする※
- 自己株式の取得については現状のキャッシュポジションや中長期的な成長投資資金、株価水準、総還元額の状況などに鑑み、機動的に実施

※ ただし1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととし、2期連続で当期純利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

ワールドクラスの中期財務目標を達成し、高水準の配当と機動的な自己株式の取得による株主還元を通して株主価値を高めていきます。

今後もこれらの戦略や政策を確実に実行することにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

継続的な企業価値の向上に関する重要指標

中期経営計画において、財務およびサステナビリティに関する指標を「継続的な企業価値の向上に関する重要指標」として明確にしています。2024年3月期には、これらの重要指標と関連する主なマテリアリティを確認しました。

CEOが参加する四半期レビュー会議にて定期的に進捗状況やアクションプランの確認をおこない、各指標における責任者のもとさまざまな活動を展開しています。

対象分野		指標	達成時期	2024年3月期実績	今後の取り組み	関連する主なマテリアリティ
財務		• 売上高: 3兆円以上	2027年3月期	• 1兆8,305億円	中期経営計画 P. 15-16	
		• 営業利益率: 35%以上	2027年3月期	• 24.9%		
		• ROE: 30%以上	2027年3月期	• 21.8%		
研究開発		• 5年間で1兆円以上の研究開発費の投入による付加価値の高い next-generation productsの継続的な創出	2027年3月期	• 研究開発費 2,028億円 (2023年3月期からの累積3,940億円)	• 持続的成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続 • 開発効率のKPI化とその運用 • ITシステムの開発による開発リスクの可視化やシミュレーションの実施 • 最先端装置の導入やDXの実装などによる開発基盤のさらなる強化	
環境	事業所	• CO_2総排出量: 70%削減 (2019年3月期比) ※ ※ 2025年3月期より目標変更 「CO_2総排出量: 85%削減 (2019年3月期比)」	2031年3月期	• 75%削減	• 事業活動によるエネルギー使用量の見える化や省エネルギー化の推進 • 台湾、韓国、シンガポールにおける再生可能エネルギーの導入推進	
		• 再生可能エネルギー使用比率: 100%	2031年3月期	• 90%	• 再生可能エネルギーの継続的な供給の確保や非化石証書購入の推進	
		• 各事業所におけるエネルギー使用量 (原単位): 前期比1% 削減	毎期	• 11事業所中、2事業所において達成	• 原単位とエネルギー使用量の連動について再確認	
		• 各事業所における水使用量 (原単位): 各基準期水準を維持	毎期	• 13目標中、10目標において達成	• 水使用量削減に関するさらなるアクションの立案と実施	
	物流	• モーダルシフトおよび共同配送のさらなる推進による物流全体 (自社配送分) の CO_2排出量: 30%削減	2027年3月期	• 18.4%削減	• モーダルシフトと共同配送の拡大やEV車の導入	
		• 製品の木材梱包の使用比率を50%以下に削減 (半導体製造装置の梱包)	2024年3月期※ ※ 2025年3月期に延長	• 通期77.6% (第4四半期73.6%)	• STW (Strong Triple Wall) 梱包の標準化とお客さまへのさらなる展開の推進 • 海運に対応できる強化柱入りSTWの導入	
	製品	• ウェーハ1枚当たりのCO_2排出量: 55%削減 (2022年3月期比)※ ※ 2024年3月期中に「ウェーハ1枚当たりのCO_2排出量: 30% 削減 (2019年3月期比)」から目標変更	2031年3月期	• 24%削減	• 装置の省エネルギーのさらなる推進	
社員	エンゲージメント	• エンゲージメント・サーベイのスコア: 継続的な改善 (前回比スコア上昇)、もしくは各地域における他社平均値を超えるスコアを達成	毎回	• 2023年3月期に実施したサーベイ結果を解析するとともに、直接社員の声を聞きながら各社ごとに改善プランを実行 (2024年3月期はサーベイの実施はなし)	• 各社の各組織におけるエンゲージメント課題に関する対策の実施を継続 • グローバル共通の課題である「キャリア機会」に関する対策の検討および実施 (メンタリング、マネージャー向けコーチングトレーニングなど)	
		• 社員の定着率※ 日本: 99% 海外: 業界平均以上 ※ 定年などによる退職は除く	毎期	• 日本: 98.8% • 海外: 業界平均以上 (95.8%)	• 日本: 自己都合退職者の退職傾向や理由を分析し、対策を実施 中途社員に対する職場順応やオファー内容に沿った業務の遂行などのサポート強化 • 海外: 各社別に自己都合退職者の退職傾向や理由を分析し、対策を実施	
	キャリア	• 一人ひとりが上長や周囲のサポートを実感し、自分の将来 (キャリアパス) をイメージしながらやりたいことにチャレンジし成長することで、会社の成長や社会のために価値創出できる環境を構築	2027年3月期	• 自立的なキャリア形成の環境整備と支援 (組織内でのコミュニケーションの充実、動機づけ、キャリア機会の提供、キャリア教育の推進など) • 新任マネージャー教育 (教育期間を3倍に拡充)	• マネージャー向けワークショップの継続により、組織力向上の必要性を理解し行動変容を推進することについてのサポートを強化 • 外部機関と連携して、「開発エンジニアのスキル管理」と「キャリアパスの見える化」を3カ年で推進 • シニアオープンジョブ※の条件検討と、中堅層、マネージャー層を対象としたキャリア教育の実施 ※ 当社グループにおける定年後再雇用の社員向けの社内公募制度	
	ワーク・ライフ・バランス	• 有給休暇取得率 日本: ①80% ②90% 海外: 前期実績と同等以上	日本: ①2027年3月期 ②2031年3月期 海外: 毎期	• 日本: 80.6% • 海外: 69.0% (前期実績65.6%)	• 休暇取得パターンの事例紹介など、主にマネージャー層を対象に有給休暇の取得促進に向けた啓発活動を実施	
	ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン	• 女性管理職比率 日本: 5% グローバル: 8%	2027年3月期	• 日本: 3.1% • グローバル: 6.3%	• ポテンシャル人材に対し、外部研修や女性のネットワーク活用などの機会を提供 • 各社、各ビジネスユニットのKPIを設定	

対象分野	指標		達成時期	2024年3月期実績	今後の取り組み	関連する主なマテリアリティ
サプライチェーンマネジメント	● サプライチェーンサステナビリティアセスメントの実施率※ ※ 2025年3月期より目標追加 「アセスメント結果に応じた改善活動の実施」	資材系: 調達額の85%以上 物流系: 通関関連業者100% 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%	毎期	● 資材系: 調達額の85%以上を達成 ● 物流系: 通関関連業者100%を達成 ● 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100%を達成	● アセスメント調査を踏まえた課題の把握と是正に向けた計画の確実な実施	
	● サプライチェーンBCPアセスメントの実施率※ ※ 2025年3月期より目標追加 「アセスメント結果に応じた改善活動の実施」	資材系: 調達額の85%以上	毎期	● 資材系: 調達額の85%以上を達成	● アセスメント調査を踏まえた課題の把握と是正に向けた計画の確実な実施	
安全	● TCIR※ 0.10以下 (業界グローバル1位) ※ TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率		2027年3月期	● TCIR 0.15	● 現場巡視の強化 ● エルゴノミクス傷害※の防止対策 ● 安全教育体制の整備 ● 事故分析の強化と事故分析に基づく本質安全設計への反映 ※ エルゴノミクス傷害: 人間が扱う機械や器具などが原因で疲れやストレスを感じ、業務に関連した筋骨格系障害を発症すること	
コーポレートガバナンス	● 常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現 1. 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社: 社外取締役比率1/3 (女性2名)※、監査役を含めた自由闊達な議論 ● オフサイトミーティング: 中長期的な戦略・課題などの議論 (年2回) ● CEO 報告: 取締役会でCEO自ら重要な業務執行状況を報告 (毎取締役会) ● CEOミッション: 中期経営計画達成に向けたCEOミッションの共有 ● 代表取締役評価クローズドセッション: 代表取締役を除く取締役・監査役によるセッション (年1回) 2. 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 執行側の最高意思決定機関 (月1回) ● CSS (Corporate Senior Staff) ミーティング: 全社業務執行のグローバル横串の連携 (年4回) ● 四半期レビュー会議: 中期経営計画の進捗をモニタリング (年4回) ※ 2025年3月期に「社外取締役比率1/3 (女性2名)」から「社外取締役比率過半数」に変更		毎期	1. 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社として、社外取締役比率1/2 (6名中3名) を維持。 過半数も視野に、指名委員会での活動を継続 第61期定時株主総会に提案する取締役候補者は、社外取締役比率が過半数 (7名中4名) ● オフサイトミーティング2回 (8月、2月) ● 取締役会で原則毎回、CEOによる業務執行に関する重要事項を説明 ● CEOミッション: 取締役会メンバーと共有 ● 代表取締役評価に関するクローズドセッション: 2回 2. 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 20回 ● CSSミーティング: 4回 ● 四半期レビュー会議: 4回	以下の事項に取り組み、定期的に進捗をレビューすることで、その実効性をさらに高めていく (取締役会の機能と役割) ● 持続的な成長という将来展望から逆算し、中長期視点での当社のありたい姿を取締役会およびオフサイトミーティングで共有し、取締役会が果たすべき機能・役割やガバナンス体制の在り方について継続的に議論していく ● 当社の企業価値向上につなげていく観点から、今後も取締役会のアジェンダ設定を適切におこない、中長期の成長戦略に対する目線合わせと戦略的な議論のさらなる充実を図る (執行体制のさらなる強化と後継者計画の加速) ● 従来のコーポレートオフィサーが本部長を兼務する体制を改め、新たにディビジョンオフィサー制度を導入。これにより、CEOと視座をともにするコーポレートオフィサーはより高度な経営課題に注力するとともに、次世代経営人材を中心に構成されるディビジョンオフィサーが各本部の業務執行を統括する体制とする	
リスクマネジメント	● 強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善 ● 「Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化 本社コンプライアンス専任部署やチーフ・コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・ヘッドを設置するとともに外部機関によるアセスメントの実施や教育を展開※ ● 執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティング、および取締役会への報告 (年2回) を通じて監督・モニタリングを実施 ● 当社グループ全体において適切な対策を確実に実施するため、リスクマネジメント委員会を中心に事業を遂行する上で想定されるリスク (2024年3月期は12項目のリスク) を特定し、各社の活動に展開 ● 安全・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する啓発活動を継続的に実施し、全役員・全社員一人ひとりの意識、および自律的かつ具体的な取り組みを人事評価に反映 ※ 2025年3月期に「本社コンプライアンス専任部署やチーフ・コンプライアンス・オフィサー、リージョナル・コンプライアンス・ヘッドを設置するとともに外部機関によるアセスメントの実施や教育を展開」から「東京エレクトロングループの最高コンプライアンス責任者であるチーフ・コンプライアンス・オフィサーと国内子会社および海外子会社のコンプライアンス担当責任者が緊密に連携し、重大インシデントの未然防止に向けた企業倫理・文化の継続的醸成およびコンプライアンス態勢確立」に変更		毎期	● GRCツール※を用いたグループ全社のリスクマネジメント活動の定着と実行 ● 昨今のビジネス環境を踏まえて継続的にリスク項目の見直しを実施し、2024年3月期は12のリスクを元にリスクマネジメント活動を実践 ● リスクマネジメント委員会の開催、およびグループ各社のさらなる体制の強化に向けて、個社ごとのリスクマネジメント委員会設置に向けた取り組みを実施 ● 倫理委員会、各社/現地法人との定期的な会議を通じたコンプライアンス組織体制の強化。外部機関によるコンプライアンスアセスメントの導入検討 ● 倫理・コンプライアンス・リスクマネジメント研修の継続実施 (新任グループリーダー・部長向け研修) ※ GRCツール: 企業活動に関連するGRC (Governance・Risk・Compliance) 対応を統合することで、多層化・複雑化した企業の管理機能と収集される管理情報を体系的に整理し、適時に経営の意思決定に寄与する仕組み	● グループ全社での実効性の高いリスクマネジメントPDCA体制の確立と、事業遂行において想定される重要なリスクの早期発見と対策の確実な実行 ● RBA監査および外部機関によるアセスメント結果を踏まえた必要なコンプライアンスプログラムの改善と推進 ● 当社グループ人材戦略を踏まえたリスクマネジメント・コンプライアンス教育研修の計画的な実行と見直し (主な対象はマネージャーおよび中途社員・新卒社員)	

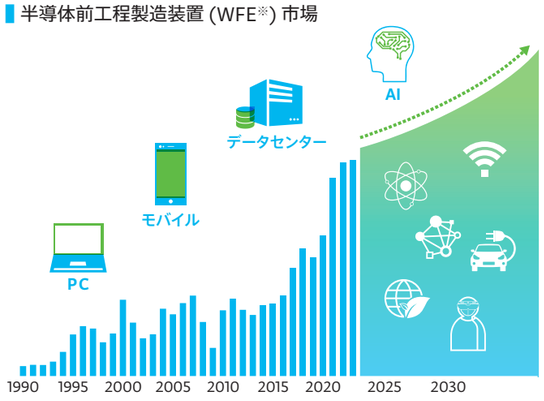
半導体製造装置事業の展望

2023年は半導体在庫の増加に加え世界的な半導体の調整が続きましたが、年後半には需給バランスが改善され、AI向けサーバーによる市場の成長やオンデバイスAIなどへの期待の高まりとともに、半導体産業の成長ポテンシャルが再認識されました。

今後、AIを中心としたさまざまなアプリケーションの拡大とともに、半導体市場および半導体製造装置市場はさらに成長していくことが期待されます。

※ WFE: Wafer Fab Equipment。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置のこと。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む

半導体前工程製造装置 (WFE※) 市場

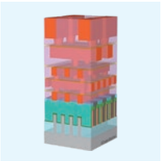


Source: TechInsights Inc. (1990-2023)

半導体デバイステクノロジーの進化と事業機会

半導体市場や半導体製造装置市場のさらなる成長を支えるのは、半導体デバイスにおける技術革新です。ロジック、DRAM、NANDの各デバイスにおいては、さらなる微細化、高積層化によるトランジスタ性能の向上や記憶容量の拡大に加え、製造コストの低減や低消費電力化への要請が今後も高まることが予想されます。当社は、幅広い製品ラインアップを生かし各プロセスの品質を最大化するとともに、プロセス間のインテグレーションにおいても高い付加価値をお客さまに提供することで、半導体デバイスの技術革新に貢献します。

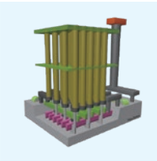
ロジック



最先端のロジックデバイスにおけるトランジスタ構造は、現在のFinFET※1から新たな構造 (GAA NS※2、CFET※3) へ移行していきます。パターニングの複雑化や、さらなる微細化の実現に向けた高NA EUV※4リソグラフィ技術の量産への適用に伴い、ユニットプロセス間の相互最適化の必要性がより一層高まります。また、配線技術においては、Cuに代わる新規材料や、電源配線の抵抗を低減させる裏面配線の開発が進められています。当社の前工程向け装置やウェーハボンディング/デボンディング装置は、このような技術革新の実現に貢献します。

※1 FinFET: Fin Field Effect Transistor。Fin (ヒレ) 状の3次元 (3D) 構造のプロセス技術
※2 GAA NS: Gate All Around Nanosheet。FinFETの次世代技術
※3 CFET: Complementary Field Effect Transistor。新構造のトランジスタ
※4 高NA EUV: 次世代EUVを指し、NA (Numerical Aperture。開口数) を上げることにより解像できる線幅を短くする露光技術

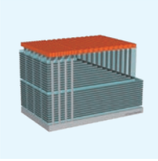
DRAM



DRAMにおいては、高アスペクト比※1のキャパシタとコンタクトを形成する技術の重要性がますます高まります。これらの技術には、当社の成膜、エッチング、洗浄装置が多く採用されています。今後、現在の2次元 (2D) 配置から新しい2D配置への構造変化や、メモリセルを縦方向に積層した3D DRAMへの移行が予想される中、当社はこのような技術革新に貢献していくために、新たな製品やソリューションを継続的に提供していきます。また、AI向けの用途として、データ転送を広帯域におこなうことが可能なHBM※2の需要が高まっています。HBMはDRAMチップを積み上げて製造するため、ウェーハボンディング/デボンディング装置など、従来に比べてより多くのプロセスを実現していく装置が必要となります。当社はこのような最先端技術においてもお客さまと協働してプロセスをつくり上げ、それらをサポートすることで技術革新に貢献していきます。

※1 アスペクト比: ウェーハ上に形成されたパターンの深さと幅の比
※2 HBM: High Bandwidth Memory

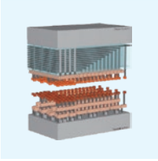
NAND



3D NANDの高積層化がさらに進み、今後500層、1,000層と積層数が増加していくことが予想されます。これに伴い、高アスペクト比の深い穴や溝の加工を実現するエッチング、犠牲膜の成膜と除去、3D構造における原子レベルの成膜技術などが必要となります。メモリ容量の増加とともにデータ転送速度の高速化も求められており、その実現のためには周辺回路の性能向上が欠かせませんが、メモリセル形成時の熱工程により生じる性能やスケーリングにおける制約が問題となっています。これを解決するために、メモリセルと周辺回路を別々のウェーハで製造してボンディングする3Dインテグレーション技術の量産化に向けた開発がおこなわれており、またこれによりチップサイズの最適化も可能になります。当社は、これらの技術要求に応えるべく、エッチング装置やALD※装置、ウェーハボンディング/デボンディング装置のさらなる高性能化に努めています。

※ ALD: Atomic Layer Deposition

アドバンスドパッケージングと3Dインテグレーション



半導体の技術革新を実現していくにあたり、半導体の製造には大きく2つのアプローチがあります。1つは半導体の進化の代名詞でもある微細化で、チップ上での半導体の集積度を高めていくものです。もう1つはアドバンスドパッケージングです。これはAI向けデバイスにおけるプロセッサとHBMの組み合わせなど、複数のチップや機能を1つのパッケージに集積する技術です。アドバンスドパッケージングはすでにさまざまなデバイスに適用されており、今後もその範囲はさらに広がっていくことが予想されます。当社は微細化向けのソリューション提供に加え、この技術におけるウェーハボンディングも重視しています。前工程におけるNANDやCMOSイメージセンサー、およびパッケージング工程におけるHBMなどに適用されるウェーハボンディングを用いた3Dインテグレーションにおいては、前工程全体で培った技術と経験を生かすとともに、ウェーハボンディング/デボンディング装置やレーザエッジトリミング装置の提供により、最先端デバイスやシステムレベルでの性能進化に貢献していきます。

Shift Left

当社は、製品開発プロセスの初期工程に、技術・人材・費用などのリソースを投じるShift Leftを重視し、お客さまと共創した技術ロードマップを実現するための各種技術の開発や、未来の複数世代を見据えた研究に取り組んでいます。

Shift Leftによる製品開発では、お客さまのご要望を早期に把握し、フィードバックで得られた情報を技術開発に反映させ優位性の高い製品を提案することで、お客さまの製品デバイスの歩留まりと量産ライン装置稼動率の最大化に貢献しています。また、お客さまの工場や開発・研究所に早い段階で評価機を納入するオンサイトコラボレーションを推進し、技術開発から量産装置への反映までの早期化と開発効率の最大化を図っています。

開発体制のさらなる強化

当社は、将来の成長を見据え積極的な投資をおこない、開発体制のさらなる強化に努めています。これまで宮城技術革新センターや東京エレクトロン テクノロジーソリューションズの穂坂事業所において新開発棟を竣工しました。さらに、2025年には東京エレクトロン宮城と東京エレクトロン九州において新開発棟の稼動を計画しています。

宮城技術革新センター
(2021年9月竣工)

東京エレクトロン
テクノロジーソリューションズ
穂坂事業所 新開発棟
(2023年7月竣工)

東京エレクトロン宮城
新開発棟
(2025年春竣工予定)

東京エレクトロン九州
新開発棟
(2025年夏竣工予定)

価値創造モデル

当社は保有する資本を最大限に活用し (INPUT)、強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンを展開しています。これにより創出される価値 (OUTCOME) をステークホルダーに提供します。そしてビジョンの実現による基本理念の実践により中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指しています。

INPUT (投入資本) 2024年3月期

財務資本
純資産 **17,601**億円
自己資本比率 **71.1**%
総資産 **24,564**億円

製造資本
製造拠点 合計 **9** (国内6、海外3)
新工場建屋や設備など製造に関する設備投資
部品の標準化・生産の平準化
製造オペレーションにおける長年培ったノウハウや実績
製造基幹システム

知的資本
研究開発拠点 合計 **14** (国内7、海外7)
研究開発投資 **2,028**億円
複数の領域における高い専門性とそれらを統合して製品化する能力
半導体製造プロセスにおける幅広い知見と総合的な技術力
お客さまのご要望や技術動向
デジタル技術やナレッジマネジメントにより蓄積された装置関連データ

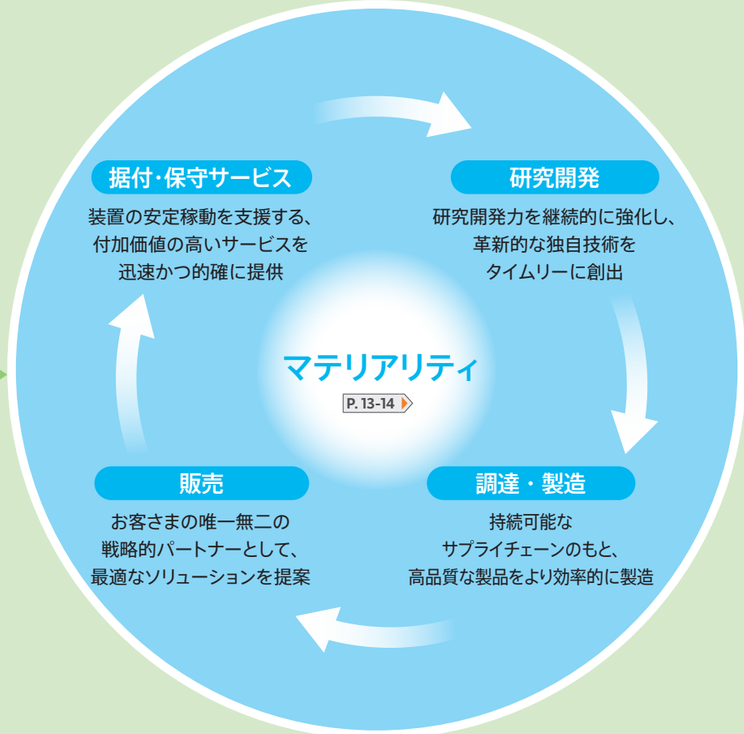
人的資本
従業員数 **17,702**名
エンジニア比率 **68.1**%
さまざまな専門分野の知見を備えた人材
グローバルに活躍できる人材
TEL UNIVERSITYによる人材開発

社会関係資本
長年の実績に基づくお客さまとの信頼関係
お取引先さまとの強固なパートナーシップ
地域社会における事業活動の基盤
業界団体における同業他社との連携

自然資本
エネルギー使用量 **102,260**kL
水使用量 **1,542**千m³

成長の原動力により創出された当社の強み

P. 12



OUTPUT
半導体製造装置
フィールドソリューション

OUTCOME (創出価値) 2024年3月期

財務資本
売上高 **18,305**億円
営業利益率 **24.9**%
当期純利益 **3,639**億円
ROE **21.8**%
年間配当総額 **1,824**億円 (連結配当性向50.1%)

製造資本
累計出荷台数 約**92,000**台 (年間出荷台数 約4,000~6,000台)
最先端技術を備えた高品質、高信頼性の製品
安全第一のオペレーション TCIR **0.15**
生産リードタイムの短縮

知的資本
革新的で付加価値の高い独自技術
市場シェア **1**位または**2**位の製品ラインアップ
半導体製造における最適なソリューション
特許保有件数 **23,249**件
高品質かつ高効率なサービス

人的資本
定着率※ **97.5**%
※ 離職率のデータを用いて算出
価値創出の源泉である社員の成長意欲の向上とチャレンジ精神の発揮
エンゲージメントの高い社員によるステークホルダーとの信頼関係の構築
女性管理職比率※ **6.3**%
※ 高度専門職と定年後再雇用者を含む

社会関係資本
顧客満足度調査「大変満足」・「満足」回答割合※ **100**%
※ ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出
サプライチェーンサステナビリティアセスメント改善率 **29.2**%
(2023年3月期比)
事業活動を展開する地域における雇用機会の創出と国・地方自治体への納税
TEL FOR GOOD※プログラム数 **285**件
※ 当社の社会貢献活動を表すブランドネーム

自然資本
自社のCO_2排出量 **75**%削減
(2019年3月期比、再生可能エネルギー導入などによるCO_2排出量131千t削減)
自社以外のCO_2排出量 (ウェーハ1枚当たり) **24**%削減
(2022年3月期比)
廃棄物リサイクル率 **98.8**%

IMPACT

ステークホルダー	影響
株主・投資家さま	●事業活動により創出した利益の還元 ●中長期的な成長の実現と企業価値の向上
お客さま	●お客さまの価値創造や継続的な成長 ●半導体の製造における生産性の向上 (稼動率や歩留まり) や環境負荷の低減
お取引先さま	●サステナブルで競争力の高いサプライチェーンにおける事業展開 ●当社との協働による取り扱い製品やサービスの付加価値の向上
社員	●夢と活力に満ち、組織と個人における相互信頼のもと存分に能力を発揮できる職場環境の創出
地域社会	●人材育成や雇用機会の創出、環境保全、納税などを通じた地域社会の活性化や持続的な発展
行政機関・各種団体	●法令や条例、業界行動規範などに遵守した事業活動の展開 ●当社との協働による産業や社会の課題解決や発展への取り組み

ビジョンの実現による基本理念の実践

ステークホルダーエンゲージメント

当社では、ステークホルダーとの対話の機会を積極的に設け相互コミュニケーションを図ることにより、ステークホルダーからの要請や期待を的確に把握し事業活動を展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの確固たる信頼関係の構築に努めています。

株主・投資家さま

ステークホルダーとの関係性	● 株主･投資家さまは、当社に資本を提供するとともに、建設的な対話や株主総会での議決権の行使を通して、株主・投資家さま視点でのご意見やご要望、当社への期待を明示 ● 当社は、経営ビジョンや成長シナリオを共有するとともに、株主･投資家さまからいただいたご意見やご要望を経営に生かし、企業価値の向上を図る
ステークホルダーへの提供価値	● 事業活動により創出した利益の還元 ● 中長期的な成長の実現による企業価値の向上
主なエンゲージメント機会	● 決算説明会/中期経営計画説明会/IR Day ● IRカンファレンス/IRロードショー※/個別IR取材 ● 株主総会 ※ IRロードショー：株主・投資家さまを直接訪問するIR活動

お客さま

ステークホルダーとの関係性	● お客さまは、当社が提供する半導体製造装置を購入するとともに、それら装置のメンテナンスなどに必要なサービスを利用 ● 当社は製品やサービスおよびソリューションの提供のみならず、お客さまと複数世代にわたる技術ロードマップを共創し、共同で技術開発を実施
ステークホルダーへの提供価値	● 革新的な技術をもつBest Products ● 付加価値の高いBest Technical Service ● 安全と品質を重視し、環境に配慮した製品やサービス ● 多様なアプリケーションに対応するソリューション
主なエンゲージメント機会	● 技術交流会 ● 共同開発 ● 顧客満足度調査

行政機関・各種団体

ステークホルダーとの関係性	● 行政機関・各種団体は、法令や条例、業界行動規範などの遵守を企業に求めるとともに、企業と連携し産業全体および国や地域レベルでの発展を目指す ● 当社は事業を展開する国や地域において、法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動をおこなうとともに、社会の要請を的確に捉え、課題解決や発展に貢献
ステークホルダーへの提供価値	● 産業や社会の課題解決や発展に貢献するソリューション ● 法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動
主なエンゲージメント機会	● 政府・行政機関との連携 ● 国際的なイニシアティブやNGOなどとの協働 ● 業界団体における活動

お取引先さま

ステークホルダーとの関係性	● お取引先さまは、当社の事業運営において必要な資材や人材、また通関やロジスティクスなどの役務を提供 ● 当社は、お取引先さまが提供する資材や役務などを購入するとともに、それらの開発や改善および品質向上に協働して取り組む。また労働、環境、安全衛生、倫理などに配慮したサステナブルなサプライチェーンを構築
ステークホルダーへの提供価値	● 当社との協働による製品やサービスのさらなる付加価値の向上および社会課題への取り組み ● 半導体製造装置市場における事業機会 ● サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化
主なエンゲージメント機会	● 生産動向説明会 ● TELパートナーズデイ/TEL E-COMPASS Day ● サステナビリティアセスメント ● STQA※監査 ※ STQA: Supplier Total Quality Assessment

地域社会

ステークホルダーとの関係性	● 地域社会は地場産業の発展や人材の育成などを図り、地域社会としての価値向上に努める ● 当社は事業を展開する地域において雇用機会の創出や環境保全の取り組み、納税などにより、地域社会の発展に貢献
ステークホルダーへの提供価値	● 人材育成と雇用機会 ● 地域における環境保全の推進 ● 納税による財務的な貢献
主なエンゲージメント機会	● TEL FOR GOOD (社会貢献活動) ● 事業所見学会 ● 環境報告会

社員

ステークホルダーとの関係性	● 社員は、個々の能力を生かし、また教育機会の活用などにより成長を図ることで、企業価値の向上に寄与 ● 当社では社員のやる気を重視した経営のもと、エンゲージメントの向上を推進
ステークホルダーへの提供価値	● 夢と活力に満ち、組織と個人における相互信頼のもと多様性を尊重し存分に能力を発揮できる職場環境 ● キャリア形成やスキルアップの機会 ● 公正な人事評価と成果に見合った報酬
主なエンゲージメント機会	● 社員集会 ● グローバル・エンゲージメント・サーベイ ● 研修やワークショップ

Chapter 3 バリューチェーンによる価値創造

バリューチェーンの取り組み

当社の特性を生かした優位性の高いビジネスモデルを構築し、マテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンの展開により新たな価値を継続的に創出しています。

バリューチェーンにおける主なマテリアリティの取り組み

研究開発

研究開発力を継続的に強化し、
革新的な独自技術をタイムリーに創出

Climate Change and Net Zero
気候変動とネットゼロ

- 新技術の開発 P. 32

Product Energy Efficiency
製品の環境性能

- 研究開発力の強化 P. 31
- 新技術の開発 P. 32

Best Products with Innovative Technology
革新的な技術をもつBest Products

- 研究開発力の強化 P. 31
- コンソーシアム・アカデミアとの協業 P. 31
- マーケティング P. 32
- 新技術の開発 P. 32

Customer Satisfaction and Trust
顧客満足と信頼

- マーケティング P. 32

Quality Management
品質マネジメント

- 機械学習を用いたAIによるプロセス開発 P. 32

調達・製造

持続可能なサプライチェーンのもと、
高品質な製品をより効率的に製造

Climate Change and Net Zero
気候変動とネットゼロ

- お取引先さまとのコミュニケーション P. 35
- 環境負荷低減の取り組み P. 36

Supplier Relationship
サプライヤーリレーションシップ

- 持続可能な調達戦略 P. 35
- お取引先さまとのコミュニケーション P. 35
- 環境負荷低減の取り組み P. 36

Employee Engagement
従業員のエンゲージメント

- ワールドクラスの製造オペレーション P. 35

Safety First Operation
安全第一のオペレーション

- 持続可能な調達戦略 P. 35
- ワールドクラスの製造オペレーション P. 35

Quality Management
品質マネジメント

- 持続可能な調達戦略 P. 35
- ワールドクラスの製造オペレーション P. 35

Enterprise Risk Management
エンタープライズリスクマネジメント

- 持続可能な調達戦略 P. 35

販売

お客さまの唯一無二の戦略的パートナーとして、
最適なソリューションを提案

Best Products with Innovative Technology
革新的な技術をもつBest Products

- 幅広い製品ラインアップを生かした提案活動 P. 39
- 多様化する半導体市場への展開 P. 40
- 顧客満足向上の取り組み P. 40

Best Technical Service with High Added Value
付加価値の高いBest Technical Service

- グローバルオペレーションの展開 P. 39
- 顧客満足向上の取り組み P. 40

Customer Satisfaction and Trust
顧客満足と信頼

- グローバルオペレーションの展開 P. 39
- 幅広い製品ラインアップを生かした提案活動 P. 39
- 多様化する半導体市場への展開 P. 40
- 顧客満足向上の取り組み P. 40

Safety First Operation
安全第一のオペレーション

- 顧客満足向上の取り組み P. 40

Quality Management
品質マネジメント

- 幅広い製品ラインアップを生かした提案活動 P. 39
- 顧客満足向上の取り組み P. 40

据付・保守サービス

装置の安定稼動を支援する、
付加価値の高いサービスを迅速かつ的確に提供

Climate Change and Net Zero
気候変動とネットゼロ

- 装置のライフサイクルを延長するサポート P. 43

Best Technical Service with High Added Value
付加価値の高いBest Technical Service

- フィールドエンジニアのグローバル化と顧客対応力の強化 P. 43
- 装置のライフサイクルを延長するサポート P. 43
- 付加価値の高いサービスの推進 P. 44
- お客さま向けトレーニングのグローバル展開 P. 44

Customer Satisfaction and Trust
顧客満足と信頼

- フィールドエンジニアのグローバル化と顧客対応力の強化 P. 43
- お客さま向けトレーニングのグローバル展開 P. 44

Safety First Operation
安全第一のオペレーション

- お客さま向けトレーニングのグローバル展開 P. 44

Quality Management
品質マネジメント

- フィールドエンジニアのグローバル化と顧客対応力の強化 P. 43
- 付加価値の高いサービスの推進 P. 44

バリューチェーンにおけるサステナビリティの取り組み P. 45-78

バリューチェーンの取り組み

研究開発

市場や技術の動向とお客さまのニーズを早期に把握し、社内外の知見の活用とともにグローバルな協業を通じて、要素技術から量産製品までの研究開発を効率的に展開します。将来を見据えた独自性の高い技術を開発し、半導体の技術革新に貢献する付加価値の高いnext-generation productsを創出します。

中長期的な価値創造における重要テーマ

- Shift Leftの推進による付加価値の高い技術・製品のタイムリーな開発
- 開発効率のさらなる追求と人材育成の強化
- さまざまな領域における専門性の有機的な統合による、最高の性能を備えた新規製品や新機能の開発

投入する経営資源

知的資本	知的資本	人的資本
研究開発投資 2025年3月期から5年間で **1.5**兆円以上	研究開発拠点 **14** (国内7、海外7)	半導体製造装置に関する **さまざまな専門分野の知見を備えた人材**

差別化ポイント

戦略的な研究開発

- グローバルに展開するマーケティング
- サービスサポートの活動を通じて技術動向やお客さまのニーズを早期に把握し製品の企画開発に反映
- 既存の事業に関連した短･中長期的な開発戦略の策定と実施

協業体制

- 国内外の開発拠点、事業本部、Corporate Innovation本部の密接な連携
- お客さまとの未来の複数世代を見据えた研究開発
- コンソーシアム・アカデミア、お取引先さまなどとの多様な協業

開発効率

- デジタルトランスフォーメーション (DX) の推進によりAIを駆使したデジタル技術による開発効率の追求と新たな価値の創造

知的財産

- 半導体製造装置業界においてグローバルNo. 1の特許保有件数と知的財産マネジメントの展開

創出価値

最先端の半導体製造に寄与する革新的で付加価値の高い **独自技術**	高スループット、高稼動率、省スペースなどにおいて **優位性の高い装置**	ネットゼロの達成に貢献する **環境性能**

関連する主なリスク項目

リスクマネジメント P. 75-76

リスク 2	リスク 9	リスク 11
研究開発	知的財産	人材

研究開発における主なマテリアリティの取り組み

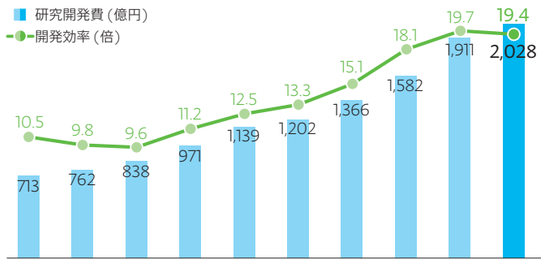
研究開発力の強化

当社では、半導体の技術革新に必要な付加価値の高いnext-generation productsを継続的に創出しタイムリーに市場に投入するため、国内外の開発拠点や、事業本部およびCorporate Innovation本部がそれぞれの独自性を生かし、必要な領域で連携を取りながら技術開発や技術融合を展開しています。要素技術から量産製品までの開発体制を構築し、AI技術を活用したDXを研究開発において推進しています。今後、2025年3月期からの5年間で1.5兆円以上の研究開発費を投入し、これらの活動を継続し加速させていきます。また、研究開発費とその成果物の売上への貢献度をモニタリングすることで、過去5カ年の研究開発費とその後5カ年の売上高を用いて開発の効率性を確認し、さらに開発効率を高める活動もおこなっています。

各開発拠点と事業本部では、先の世代を見据え革新的な技術の開発に取り組むとともに、周辺技術に関わる研究開発も進めています。Corporate Innovation本部では、製品領域ごとの横断的な取り組みを展開するとともに、全体を俯瞰して研究開発の推進と最適化を図っています。また将来の価値創造に向けたシーズの探索や要素技術の研究開発も手がけています。

当社グループ各拠点における優れた研究・開発成果には、グローバル表彰制度に加え、社内技術交流会の優秀賞、環境技術アワード、DXアワードなどを授与し、エンジニアのものづくりへのモチベーション向上に取り組んでいます。

研究開発費と開発効率※の推移



※ 直近5カ年の売上の合計額を6~10期前の研究開発費の合計で割って集計

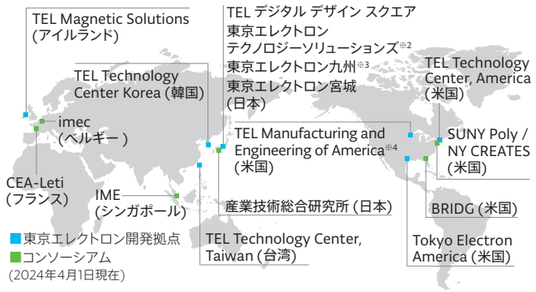
コンソーシアム・アカデミアとの協業

当社は長きにわたり国内外のコンソーシアムやアカデミア(大学)との共同研究開発を続けています。この取り組みは、各地域におけるオープンイノベーション開発のメリットを最大限に生かした開発基盤の整備にも役立っています。近年では、日本のみならず海外の主要な大学とのコラボレーションにより半導体業界における人材育成の強化にも努めています。

TEL Technology Center, Americaでの前工程、後工程領域の研究はもとより、次世代AIのハードウエア開発や先端ロジック開発、量子コンピューティング開発をおこなう世界的な研究ハブへの参画、パターニング技術のEUVおよび高NA EUV領域やロジックプロセス開発におけるimecとの協業、非営利官民パートナーシップであるBRIDGEとの提携など、アプリケーションから製品まで幅広い開発を推進しています。技術革新のスピードが速い半導体産業において、先行して新技術を開発することは企業の成長の源泉です。先端露光技術の開発のみならず、10年先を見据えた市場調査をおこない技術変化点を抽出・特定し、CFETやTMDC※1などの新構造・新材料によるイノベーションの創出にも貢献していきます。

また日本最大級の公的研究機関である国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)との協業では、産総研がもつ世界有数の研究環境と人材とともに、多様化が進む半導体デバイス製造に必要な先端要素技術開発、およびTMDCや2次元材料の研究に取り組むことにより、当社独自の研究開発力の強化につなげています。

※1 TMDC: Transition Metal Di-Chalcogenide。遷移金属カルコゲナイド。WS2、MoSe2など2次元トランジスタに適用される材料



※2 藤井本社、穂坂事業所、東北事業所
※3 合志本社、大津事業所
※4 Chaska Head Office、Chelmsford Office

マーケティング

当社では、デバイス技術やお客さまの製品ロードマップ、競合分析をもとに、事業本部やアカウントおよびコーポレート組織のマーケティング部門がそれぞれ適切に役割を果たし相互に連携することで、中長期経営計画の実現を目指しています。

事業本部のビジネスユニット(BU)に所属するマーケティング部門は、各BUのターゲット市場におけるお客さまのニーズを満たす先進的なnext-generation productsの企画や、それに基づくプロモーション活動を展開します。一方、アカウントおよびコーポレート組織に所属するマーケティング部門は、お客さまにおける将来のHVP(High Value Problem)を解決するため、事業本部のnext-generation productsを組み合わせたクロスBUでのインテグレーションや事業本部の製品ポートフォリオに含まれない新市場向けの先進的な新製品の企画、またそれらの企画に基づくソリューションの提案をおこないます。

事業環境の変化が著しい半導体業界においては、状況に合わせたタイムリーな方針変更をその都度実施する柔軟性が必要です。それぞれのマーケティング部門が協力して活動を展開することにより、市場ニーズを先取りしお客さまの製品に貢献するとともに、当社の製品競争力の向上およびShift Leftの推進につなげています。

新技術の開発

当社では、さまざまな領域の専門性を駆使しそれらを有機的に統合していくことにより、新技術や新規製品の開発に取り組んでいます。一例として、積層化が進む3D NANDにおいて、400層を超える積層構造にメモリチャネルホール※1を形成する、新しいエッチング技術を開発しました。これまで絶縁膜エッチングでは実用化されていなかった極低温領域での、絶縁膜のエッチング速度を格段に上げる新たなプロセスを開発し、このプロセスに対応する装置を実現しています。この画期的な新技術を用いることにより、高アスペクト比※2の深さ10 μmのエッチングを、33分という短時間で優れた形状(図2)に加工することができ、地球温暖化係数を従来比で84%削減することが可能となります。本技術は、今後のさらなる大容量3D NANDの技術革新に貢献していきます。

※1 メモリチャネルホール: メモリ素子となる穴
※2 アスペクト比: ウェーハ上に形成されたパターンの深さと幅の比

図1. 3D NAND

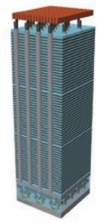
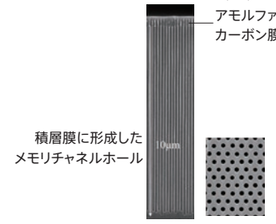


図2. ホールパターンの断面図(左)とホール底部の断面図(右)



Copyright 2023 The Japan Society of Applied Physics

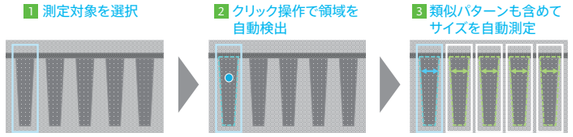
機械学習を用いたAIによるプロセス開発

社会においてAIの実用化が進む中、当社では全社で利用可能な生成系AIシステムをいち早く導入しています。また、製品開発を加速するため、半導体製造装置向けソフトウエアに特化した生成系AIの開発にも取り組んでいます。

半導体製造プロセスの開発においては、ウェーハへの加工結果を確認するために走査電子顕微鏡(SEM)で撮影した画像を活用し、配線幅やホール径などさまざまな微細構造のサイズを測定して、所望の結果が得られているかどうかを判断しています。

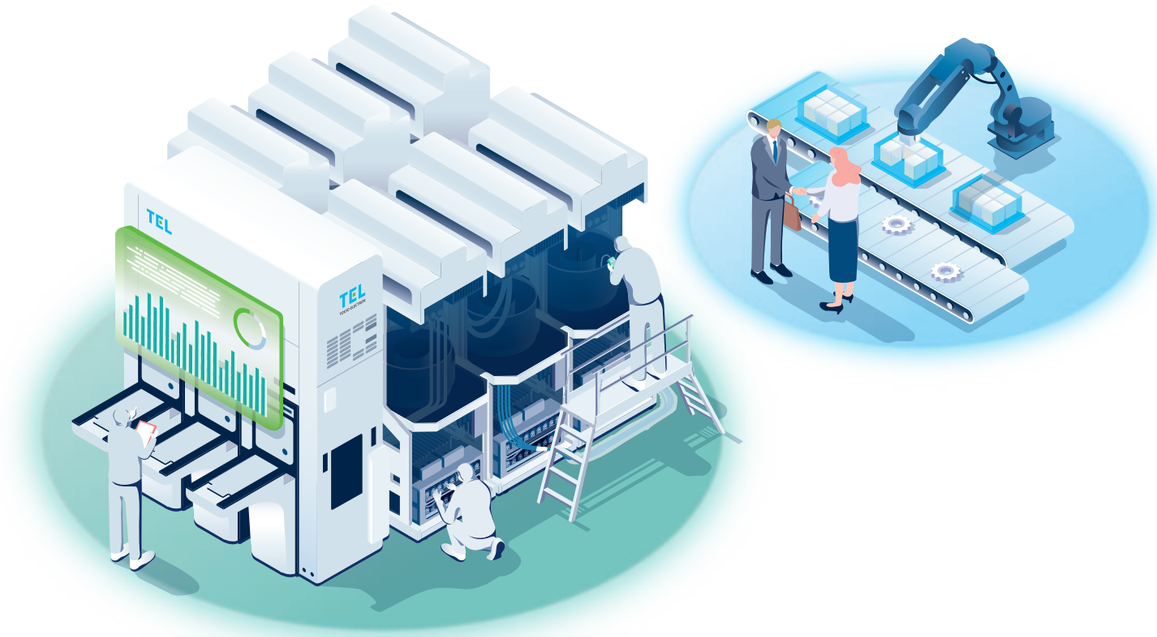
これまでこの作業には機械学習を応用したツールを開発し使用してきましたが、新たな形状の測定の準備には多くの時間を費やしていました。2024年3月期には、どのような形状であっても迅速かつ容易に測定ができる画像測長ツールを新たに開発しました。この新ツールにより、測定の事前準備が不要となり、プロセス開発に携わるエンジニアは簡単な操作のみでウェーハの形状を測定することが可能となり、プロセス開発における生産性の向上を実現しています。

自動測長ツールの利用イメージ



バリューチェーンの取り組み

調達・製造



安全性や高品質、高信頼性を目指した生産革新を継続的に追求し、環境に配慮した製造オペレーションの構築を進めています。市場の変動に迅速に対応すべく標準化・平準化を進め、Smart Manufacturingの展開によりさらなる効率化を図ります。お取引先さまとのパートナーシップによる持続可能なサプライチェーンを構築し、安定的な生産体制を確立します。

中長期的な価値創造における重要テーマ

- Smart Manufacturing構想の実現によるワールドクラスの製造オペレーションの確立
- 営業利益率・ROEのさらなる向上につながる効率化の追求や経営資源の最適配分
- お取引先さまとの確かな信頼関係に基づく価値の共創

投入する経営資源	製造資本・人的資本	製造資本	社会関係資本
	半導体製造装置の事業において **長年培ったノウハウ(人・モノ)**	最新のデジタル技術を駆使した **製造基幹システム**	お取引先さまとの **強固な協業関係**

差別化ポイント

品質と信頼性
- 品質方針に基づく品質優先オペレーションの徹底
- 製造ノウハウ・知見の活用や各工程における徹底した品質管理の実施

高生産性の追求
- Shift Leftによる業務の効率化
- 標準化・平準化の推進
- Smart Manufacturingの展開

持続可能な調達活動
- お取引先さまとの協働による新たな価値の創出
- ONE TEL※オペレーションによる効率化の追求
- 労働安全衛生などサステナビリティの取り組み

※ 当社グループが一丸となって同じ目標を達成すること

ネットゼロに向けた取り組み
- 事業所や物流における環境負荷低減活動
- サプライチェーン全体におけるパートナーシップ
- 製品使用時のCO_2排出量の削減

創出価値

最先端技術を備えた **高品質、高信頼性の製品**	安定的かつ効率的な製造オペレーションによる **生産リードタイムの短縮**	**地球環境保全への貢献**

関連する主なリスク項目

リスクマネジメント P. 75-76

リスク 4	リスク 5	リスク 6	リスク 7
調達・生産・供給	安全	品質	環境対応

調達・製造における主なマテリアリティの取り組み

持続可能な調達戦略

半導体製造装置事業では、サプライチェーンマネジメントの重要性がますます高まっています。事業活動を効率的かつ確実におこなうためには、持続可能な調達活動を戦略的に推進していくことが極めて重要です。

コーポレート生産本部では、サプライチェーンBCPアセスメントの定期的な実施、リスク部品の調査、サプライヤーマップのシステム化をおこない、サプライチェーンリスクの可視化を図っています。またプロアクティブな調達活動として、各製造拠点間における部品補完体制の強化や調達プロセスの検討、調達と部品在庫の最適化などについてグループ全体で取り組んでいます。

加えて、短期のみならず中期の受注見通しを営業部門と製造部門が共有することで販売計画と生産・調達・在庫計画の調整をおこない、安定的な調達を確実にするとともに生産およびスタートアップ工程の平準化に努めています。

これらの取り組みを通して、装置の製造や立ち上げにおける安全や品質、効率性のさらなる向上を目指していきます。

お取引先さまとのコミュニケーション

当社は、お取引先さまとの円滑なコミュニケーションが重要であるとの考えのもと、生産動向説明会やTELパートナーズデイなどを定期的に開催し、市場動向や当社の経営方針・事業方針、サステナビリティの取り組みなどについてお取引先さまに共有する機会を積極的に設けています。また、RBA行動規範への準拠やE-COMPASSの取り組みなどについて理解を深めていただけるよう、お取引先さまを対象とする説明会を開催しています。当社は、内閣府や経済産業省、中小企業庁などが推進する「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列などを越えた新たな連携の構築や、お取引先さまとの望ましい取引慣行の遵守などに取り組むことを宣言する「パートナーシップ構築宣言」を公表しています。これからもお取引先さまと協働でグローバルオペレーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値の向上に努めていきます。

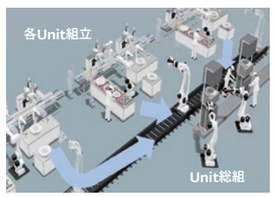
ワールドクラスの製造オペレーション

Smart Manufacturingによるものづくり改革

当社は、製造拠点における生産革新を継続的に追求し、製品品質と収益性の向上に努め、長年培った知見と蓄積したデータを活用することで、ワールドクラスの製造オペレーションを展開しています。

東京エレクトロン宮城では、2021年10月に稼動した宮城技術革新センターを中心にものづくり改革に取り組んでいます。具体的には、安定した品質で製品をつくり出すとともに、作業の人的負荷やインシデントの低減を実現するため、Smart Manufacturing Lineの構築を推進しています。

物流工程において自動倉庫システムやキットロボットを導入することで、これまでに生産性を30%向上させました。今後、製造工程やそれらを支える管理間接工程も含めて総合的な改革を進めることで生産技術をさらに進化させ、生産性を飛躍的に高めていくことを目指しています。製造ラインのみならず製品設計の改革にも取り組むことで機械作業が可能な工程をつくり出し、その機械作業からさまざまなデータを取得・分析・活用することにより、Smart Manufacturingの実現とさらなる推進に努めていきます。



Smart Manufacturing Lineイメージ

宮城技術革新センターでの自動機評価風景

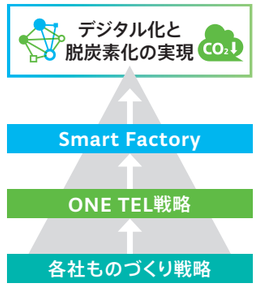
標準化・平準化

当社は中長期経営計画の実現に向け、各生産工程における重要なテーマとして部品の標準化と生産の平準化を推進し、さらなる生産性の向上を目指しています。具体的には、グループ各社で異なる部品を採用する際の基準を見直すことにより、ONE TELとして既存装置や今後開発される装置で使用される部品の共通化比率を向上させていきます。また勘と経験に頼った作業体系から脱却すべく、BOM※1、BOP※2、マスター情報の整備を徹底しデータベース化することで、作業の見える化と標準化を促進していきます。加えて、それらのデータベースの分析手法や評価基準をグループ統一の方法で確認することで、生産・調達におけるパフォーマンスを可視化します。

これまでは各主要製造拠点において、製品ごとの生産体系により最適化されたビジネスモデルに合わせてさまざまな活動を推進してきました。今後は、部品の標準化と生産の平準化を実現することで、世界トップレベルの製造工場を目指すとともに、省人化やワーク・ライフ・バランスの向上に取り組んでいきます。

※1 BOM: Bill of Materials。部品表
※2 BOP: Bill of Process。工程表

生産領域における基本戦略



ベストインクラスの研究、開発、生産体制

当社は開発製造拠点の多拠点化に取り組んでいます。半導体製造の難易度が上がるにつれ、従来の技術や装置のみでは今後の半導体の技術革新への追従が難しくなることから、既存のプロダクトに加え、新たなプロダクトの開発を加速させることが重要です。

そのために、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ (山梨、岩手)、東京エレクトロン宮城、東京エレクトロン九州 (熊本) に続き、米国ミネソタ州のTEL Manufacturing and Engineering of Americaを第4の開発製造拠点と位置づけ、国内拠点と同等の工場機能の確立を目指して活動を展開しています。また当社は、研究開発やプロセスインテグレーションの拠点としてニューヨーク州にTEL Technology Center, America、半導体の知見が集約するカリフォルニア州およびテキサス州にTokyo Electron Americaを有しています。TEL Manufacturing and Engineering of Americaではこれらの拠点における研究開発情報を集約し活用することで、開発から生産までのリードタイムを短縮し、お客さまに当社装置をより早く納入することに努めています。

近年ではデバイス製造の複雑化や高難易度化により、以前にもましてShift Leftの重要性が高まっています。当社では既存プロダクトの強化とともに世の中にない新たな技術の創出をおこない、それらをいち早く装置に実装する取り組みを推進しています。日本国内に加え、米国内においても開発から生産までの一気通貫の体制を構築することで、ベストインクラスのオペレーションを追求していきます。

TEL Manufacturing and Engineering of America

環境負荷低減の取り組み

当社は、2040年にネットゼロを達成するため、E-COMPASS※1の活動を積極的に展開し、事業所や物流、サプライチェーンにおいてさまざまな施策を実施しています。

各事業所では、エネルギーの見える化や省エネルギー施策の実施、再生可能エネルギー (電力) の購入を継続しています。物流では、モーダルシフト※2や環境負荷の少ない梱包材料の積極的な採用を推進しています。これらの取り組みが評価され、令和4年度「エコシップマーク」認定※3において国土交通省海事局長表彰対象に選定されました。

また環境の取り組みにご協力・ご貢献いただいたお取引先さまに対して、「環境パートナー」の表彰や「グリーンパートナー」の認定をおこなっています。

※1 E-COMPASS P. 52
※2 モーダルシフト: 自動車や航空機による輸送から、より環境負荷の低い鉄道や船舶による輸送に転換すること
※3 エコシップ・モーダルシフト事業実行委員会主催

バリューチェーンの取り組み

販売

Best Products、Best Technical Serviceの提供により、お客さまと強固な信頼関係を構築し、唯一無二の戦略的パートナーとなることを目指しています。多彩な製品ラインアップを有する半導体製造装置メーカーとしての強みを生かし、最適なソリューションを提案することで、お客さまによるさらなる価値の創造に寄与していきます。

中長期的な価値創造における重要テーマ

- 顧客対応力と顧客満足の向上
- Best Products、Best Technical Serviceの提供による相互利益の拡大
- 主要顧客におけるポジションの維持向上

投入する経営資源	知的資本	知的資本	社会関係資本
	Account Sales本部、Global Sales本部、およびビジネスユニット、海外現地法人などが連携した **グローバルセールス・サービス体制**	多種多様な製品ラインアップから生まれる **幅広い知見と総合的な技術力**	長年の実績に基づく **お客さまとの信頼**

差別化ポイント

お客さまとの共創

- お客さまと将来の技術ロードマップを共創
- 4世代およびその先を見据えた技術の同時並行評価
- Shift Leftの技術開発

最適なソリューション

- 前工程における連続した4つのキープロセス装置
- MAGIC※市場向け装置やリニューアルモデルなどの提供
- 前工程と後工程の技術の融合

※ 多様化する半導体市場への展開 P. 40

グローバルオペレーション

- お客さまのご要望の的確かつタイムリーな把握
- Account Sales本部およびGlobal Sales本部による展開

顧客満足の追求

- 唯一無二の戦略的パートナー
- 独自の顧客満足度調査と改善活動

創出価値

4世代およびその先を見据えた技術の同時並行評価による革新的な技術を備えた **付加価値の高い製品**	多様なアプリケーションに対応する **製品やソリューション**	グループ全体での密接な連携による **顧客対応力**

関連する主なリスク項目

リスクマネジメント P. 75-76

リスク 1	リスク 3	リスク 10
市場変動	地政学	情報セキュリティ

販売における主なマテリアリティの取り組み

グローバルオペレーションの展開

当社は、お客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーとなるため、Account Sales本部とGlobal Sales本部を設置し、お客さまの求める技術やサービス、ソリューションなどの迅速な提供に努めています。Account Sales本部では、従来のお客さまである大手半導体メーカーよりメモリ、ロジック、ファウンドリなどにおける次世代最先端技術のニーズをご共有いただき新技術開発につなげていくとともに、Global Sales本部では、急成長する中国市場や産業用IoT市場向けの製品を取り扱う国内外のお客さまのご要望に対応しています。

これらの本部とビジネスユニット、開発・製造部門、サービス部門、海外現地法人などが緊密に連携し、ONE TELとしてグループ全体でグローバルオペレーションを展開することにより顧客対応力のさらなる強化に取り組んでいます。

幅広い製品ラインアップを生かした提案活動

当社は、前工程における成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄といった連続した4つのキープロセスの装置や、後工程における検査やボンディング/デボンディングプロセスの装置など、幅広い製品ラインアップを展開しています。これらを生かした提案活動をおこなうことでお客さまの課題を解決し、競争優位性の高い半導体製造の実現に貢献します。

前工程においては、①バッチ、セミバッチ、枚葉の特性を生かしながら新材料や新構造に対応し、最適な膜厚および膜質制御を可能とする成膜装置、②最先端のEUV露光に対応する塗布現像装置、③微細な構造への精密加工や高選択比の深い穴や溝の加工を実現するエッチング装置、④微細なパターンを倒壊させることなく歩留まり低下の要因となる異物や残渣を除去する洗浄装置を中心に、革新的かつ究極のプロセス性能をもった装置開発を進めています。連続した4つのキープロセスの装置を有することにより、前後の工程の理解に基づくプロセスインテグレーションをはじめ、さまざまなアプローチにより、お客さまの課題に対するソリューションの提案を可能にしています。具体的な提案には、極めて狭いパターニング加工に必要なハードマスクの成膜とエッチングにおけるプロセス手法や、深穴エッチング後に生じる残渣物に応じた洗浄方法および洗浄後の表面状態に応じた前処理を含む成膜手法などが含まれます。

当社の製品ラインアップ

後工程においては、ウェーハ検査工程で使用されるウェーハプローバや3次元実装を実現するボンディング/デボンディング装置なども取り揃えています。今後は生成AIサービスの性能向上と応用範囲の拡大に向けて先端ノードを用いた微細化技術とともに半導体のさらなる高性能化が求められます。その高性能化を実現するために、Chipletと呼ばれる個片化した半導体を組み合わせたアドバンスドパッケージング技術の導入が加速しています。これらの要求に応えるべく、当社ではChipletに不可欠なKGD※向けテスト装置の導入や、次世代の微細化技術とパッケージング技術のそれぞれに必要なボンディング工程へのソリューションの提供を積極的に進めていきます。

これらの取り組みに加えて、装置の稼動率の最大化を目指したリモートサポートシステムやソフトウエアを含めた最適なソリューションを提供することで、お客さまの開発・製造における生産性や品質の向上に貢献していきます。また複数世代にわたる製品の製造に関するお客さまからのご要望に対応すべく、納入済装置の性能改善にも継続的に取り組んでいます。

※ KGD: Known Good Die。信頼性も含めて品質保証されている半導体チップ

多様化する半導体市場への展開

近年、デジタル技術による仮想空間の普及や自動車のEV化・自動運転レベルの進展、デジタルトランスフォーメーション (DX) やグリーントランスフォーメーション (GX) の推進に伴うIoTや生成AIに代表されるコミュニケーション向けデバイスなど、さまざまなアプリケーションに対応した半導体の多様化が進んでいます。このような多様化する半導体の市場を当社ではMAGIC (Metaverse, Autonomous mobility, Green energy, IoT & Information, Communications) 市場と定義し、最先端で培った技術と豊富な出荷実績に基づく経験を生かしビジネスの強化を図っています。

当社では、これまで300mm装置の成熟 (レガシー) 世代市場におけるお客さまを中心に各ビジネスユニットによる機能改善の提案を継続的におこなってきました。そして、さらなる需要に対応するためDSS (Diverse Systems and Solutions) BUを設立し、今後も高い成長が見込まれるMAGIC市場に経営資源を効率的に投入することで、継続的な企業価値の向上に努めています。一例として、SiC※1プロセスの200mm化を見据えた最適な装置群の提供や、メタバース向けWaveguide※2やμLED対応など新たな技術開発にも取り組み、さまざまな機能開発をお客さまとともに進めています。

さらに既存装置の活用を検討されているお客さまの多様なニーズに応えるため、既存装置に対する生産性向上のオプション提案、また200mm装置のライフサイクルを延長すべくリニューアルモデルの拡充をおこなっています。すでに販売中の「ALPHA-8SE™ i」、「UNITY™ Me+」「NS300+ 200mm Conversion」に加え、2024年3月期には塗布現像装置のリニューアルモデルとして「CLEAN TRACK™ Act™ 8Z」の販売を開始しました。

※1 SiC: シリコンカーバイド。シリコン (Si) と炭素 (C) で構成される化合物半導体材料
※2 Waveguide: 導波路。光学的な特性をもつ物質を用いて作成された、通信に光を用いる伝送路

顧客満足向上の取り組み

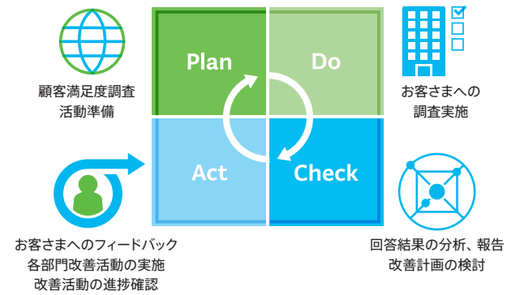
当社は、創業以来の重要なテーマである顧客満足向上の取り組みによりお客さまとの確固たる信頼関係の構築に努めています。技術革新のスピードが速い半導体製造装置業界においては、お客さまである半導体メーカーと将来の技術ロードマップを共創し、4世代およびその先を見据えた技術の同時並行評価を推進することで、Shift Leftの技術開発を加速させています。これにより半導体デバイスの歩留まりの向上や装置稼動率の最大化など、お客さまの生産性向上に貢献する優位性の高い製品の提供を実現しています。

また、世界各地のお客さまの拠点に当社のカスタマーエンジニアを配置し、納入装置が早期に最大限の性能で稼動するためのサポートを提供するとともに、特定した技術課題に対する効果的なソリューションの提案や次世代装置開発へのフィードバックをおこなうなど、お客さまに寄り添った取り組みを継続的に実施しています。

これらの活動を展開するとともに、当社独自の「顧客満足度調査」を毎年実施しています。この調査で得られた情報をビジネスユニット (プロダクト)、アカウント (お客さま)、機能 (ソフトウエア・開発など) ごとに分析し、その結果を営業、装置・工場、サービスなどの各関連部門と共有することで、実務レベルの改善を実行するPDCAサイクルを展開しています。

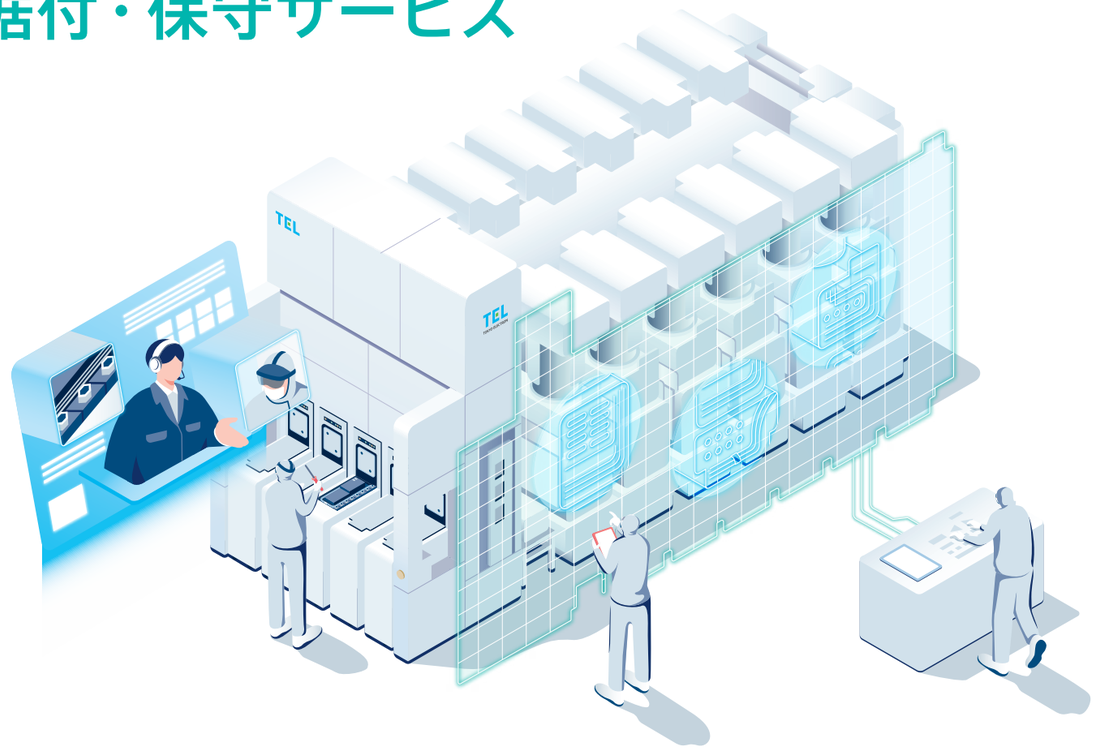
このような活動が高く評価され2024年3月期も多くのお客さまから引き続きベストアワードを受賞しました。お客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーとなるため、今後も革新的な技術をもつBest Productsと付加価値の高いBest Technical Serviceを提供し、顧客満足のさらなる向上を追求していきます。

PDCAサイクル



バリューチェーンの取り組み

据付・保守サービス



多種多様なアプリケーションに対応するさまざまな世代の装置の安定稼動をサポートするため、最先端のデジタル技術やナレッジマネジメントツールを駆使し、付加価値の高いBest Technical Serviceを展開します。世界最大の納入実績を生かし、お客さまの課題を解決する高度なフィールドソリューションを提供することで、サービス品質のさらなる向上を推進しています。

中長期的な価値創造における重要テーマ

- 付加価値の高いサービスの提供による顧客満足の向上
- 包括契約型サービスなどの拡販によるサービス収益の最大化
- デジタル技術を駆使した高品質かつ高効率なサービスの追求

投入する経営資源

知的資本	知的資本	人的資本
19の国と地域・**87**拠点におけるサービスサポートの基盤	デジタル技術やナレッジマネジメントなどを活用した**サービスデータベースとリモートサポート体制**	専門性が高く広い知見をもつ**約5,300名**のフィールドエンジニア

差別化ポイント

フィールドエンジニア

- グローバルに活動するフィールドエンジニアによる迅速かつ的確なサービス
- 継続的なエンジニアのスキルアッププログラム

DXによる効率化

- 作業履歴を一元管理するService CRM※の展開
- 遠隔保守サービスやリモートサポートツールの活用による高度なフィールドソリューションの提供

※ Service CRM: Service Customer Relationship Management

納入実績

- 世界最大の納入実績による装置データの利活用
- 確かな技術サービスに基づくお客さまとの絶対的な信頼関係

装置のライフサイクル

- 継続的な装置運用の支援
- 環境負荷低減への取り組み

創出価値

グローバル展開による装置納入からメンテナンスまでの**一貫したサービス**	さまざまな世代にわたる**装置の長期安定稼動への貢献**	お客さまの生産性向上に寄与する**品質の高い技術サービス**

関連する主なリスク項目

リスクマネジメント P. 75-76

リスク 5	リスク 6	リスク 11
安全	品質	人材

据付・保守サービスにおける主なマテリアリティの取り組み

フィールドエンジニアのグローバル化と顧客対応力の強化

今後、急速な事業規模の拡大が予想される中、フィールドエンジニアを増員し戦力としていち早く活躍できる人材の育成や、既存のフィールドエンジニアのスキル向上を効果的に図ることが極めて重要です。

当社ではSEMI (国際半導体製造装置材料協会) の基準を満たしたグループ共通のスキル管理体制を構築し、毎年細かく設定された目標をもとにスキルアップを図っています。このように管理されたエンジニアのスキル情報を活用し最適な人材配置をおこなうことで、お客さまに提供するサービスの品質向上に役立てています。

また、海外現地法人向けエキスパートエンジニア教育として、一定期間、国内製造拠点でトレーニングを受けたエンジニアを帰国後に現場に再配置するプログラムを展開しています。このプログラムに参加することで、エンジニアは装置技術の知識を深めるとともに、開発・製造部門のエンジニアやビジネスユニットとのコミュニケーションスキルをさらに向上させることができます。加えて、お客さまのニーズを取り入れた質の高い技術サポートを提供し、高いスキルレベルでグローバルに活躍できる現場リーダーを育成するプログラムも推進しています。

お客さまおよび当社のエンジニア向け装置トレーニングにおいては、トレーニング機やインストラクターのスケジュール、およびトレーニングのリクエストから受講履歴までの情報などを専用のシステムで一元管理し、より多くのエンジニアが受講できる環境を整えています。

さらに世界中のお客さまの現場にエンジニアを配置し、それらのエンジニアを国を問わず必要な場所に効率的に派遣できる体制を構築しています。質の高いサービスを提供するために、派遣するエンジニアの資格や教育状況を迅速に確認するとともに、教育の全体像を見える化し、最適なタイミングかつ短時間で効果的な教育を実施するための改革を進めています。

また、各サービス拠点のリニューアルや拡張を進め、お客さまのニーズに合ったサポートを迅速かつ効率的に提供できる環境を整備していきます。

装置のライフサイクルを延長するサポート

お客さまに長く装置をお使いいただくための取り組みの一環として、装置のライフサイクルを延長するサポートサービス「LEAP※」を展開しています。半導体製造装置のサポートは、パーツの生産が中止となることや、安全および品質維持が困難となることから、通常、装置の生産中止後7年~8年で終了します。このためサポートが終了した装置は廃棄され、後継装置への入れ替えがおこなわれます。このような状況において、当社では生産中止パーツの再設計をおこない、修理などのサポート体制を再構築し強化することで、生産中止後15年以上の期間にわたり装置のライフサイクルの延長を可能とするサポートを提供しています。

装置の仕様や運用に関する変更管理の制約から装置の入れ替えが難しいお客さまや、装置の継続的な活用を望まれるお客さまの支援をおこなうことで、装置の廃棄を減らし環境負荷低減の取り組みを推進するとともに、お客さまの長期間にわたる装置の運用に貢献します。

※ LEAP: Lifecycle Extension and Availability Program

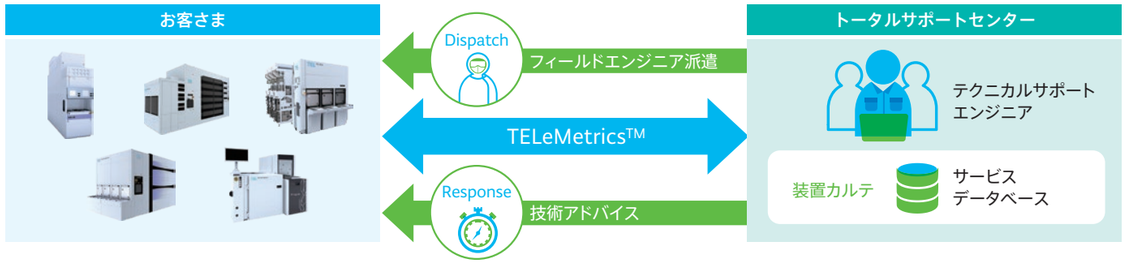
付加価値の高いサービスの推進

日本、米国、中国、欧州にトータルサポートセンター (TSC) を開設し、専門性の高いエンジニアによるグローバルなサポート体制を構築しています。

日々の活動における装置対応などの大量な作業履歴をグローバルで一元管理されるService CRMに蓄積し、ナレッジマネジメント活動として装置カルテ作成やトラブル対応の検索ツールを構築することで、TSCや現場のフィールドエンジニアによるお客さまへの迅速かつ質の高いサービスの提供に役立てています。また、フィールドエンジニアが現場で作成する社内向け作業手順書を一元管理して、作業手順書の作成効率や品質、検索性などを向上させるシステムの開発をおこない、グローバルに展開する準備を進めています。加えて、遠隔保守サービスTELeMetrics™やリモートサポートツールなどの活用により、お客さまのさまざまな課題の解決に取り組んでいます。

当社では、お客さまの製造拠点にフィールドエンジニアが常駐して装置の保守をおこなうサービスや、従量課金や定額課金による保守作業、保守部品・消耗部品の提供、部品のリペアなどを総合的におこなう包括契約型サービス (TEL Service Advantage Premium) など、装置の安定稼動に向けたさまざまな契約型サービスを提供しています。

さらに、トラブル解決時間の短縮やプロセス性能の安定化を図るため、装置から出力されるデータを集約して分析し、主要部品の故障タイミングの予測や事前の交換提案をおこなうことで、お客さまの装置稼動率向上につながる活動を継続的に実施しています。

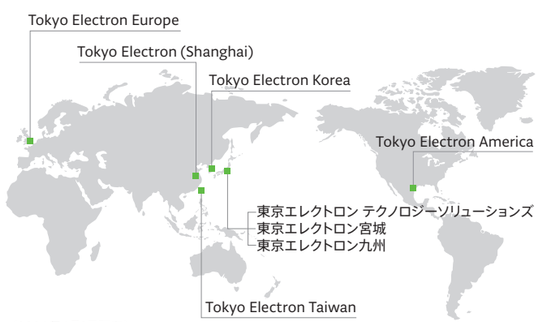


お客さま向けトレーニングのグローバル展開

当社では、お客さまに製品を安全にご使用いただけるよう、開発生産拠点を中心に世界各地にトレーニングセンターを開設し、装置の操作やメンテナンスに関するトレーニングをグローバルに展開しています。お客さまの安全を第一に考え、状況の変化に柔軟に対応しながらリモートトレーニングや動画なども活用し、効果的な実施に努めています。

今後は、海外現地法人のトレーニングセンターのリニューアルや、トレーニング装置のラインアップ拡張を継続的に進めていくなど、トレーニング環境のさらなる整備に取り組んでいきます。

主なお客さま向けトレーニング拠点



(2024年4月1日現在)

バリューチェーンにおけるサステナビリティの取り組み

当社におけるサステナビリティの取り組みはビジョンの実現による基本理念の実践です。サステナビリティの取り組みについて以下のガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標からなる4つの枠組みで整理し、活動を推進しています。

4つの枠組みにおける主な活動内容

ガバナンス

- サステナビリティ統括部を本社に設置し、グループ全体でサステナビリティの取り組みを推進
- サステナビリティ担当執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を年2回開催。コーポレートオフィサーおよびディビジョンオフィサー、国内グループ会社・海外現地法人社長が参加し、サステナビリティに関する短・中長期目標の設定や進捗管理、サステナビリティ関連方針の策定や個別テーマに関して討議。重要案件については執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティングで決議を実施
- グループ全体のサステナビリティの取り組みについて適宜取締役会にて報告をおこない、取締役会はそれを監督

戦略

- 企業の独自の資源と専門性を生かして社会課題を解決するCSV=TSV (TEL's Shared Value) の考えに基づき、事業活動において社会的価値と経済的価値の創出に注力
- 優先して取り組む重要事項をマテリアリティとして特定※し、成長の原動力により創出された強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンを展開
- 事業活動においてさまざまなサステナビリティの取り組みを推進するとともに、革新的な技術をもつBest Productsや付加価値の高いBest Technical Serviceの提供により、産業や社会における課題解決やSDGsの達成に貢献し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を実現

※ 2024年3月期にマテリアリティの見直しを実施 マテリアリティ P. 13-14

リスク管理※

- 半導体を取り巻く地政学や市場変化などのさまざまなリスクに適切かつ迅速に対応するとともに、持続的な成長を実現すべくリスクマネジメント体制を構築し、より実効的な活動を推進するためエンタープライズ・リスクマネジメントを展開
- 事業を遂行する上で直面し得るリスクについて、将来を見据えて十分に検討をおこなうことにより影響を最小化するのみならず、それらを事業機会として捉え、適切に対応
- グループ全体で横断的・網羅的なリスクを洗い出し、影響度と蓋然性の高いリスクを当社の重要リスクとして特定するとともに、各リスクオーナーを設置。またCEOやディビジョンオフィサーが参加する会議体において特に課題があるリスクについて取り組み状況の確認と改善策について討議

※ リスクマネジメント P. 75-76

指標と目標

- 中期経営計画における継続的な企業価値の向上に関する重要指標※1およびサステナビリティ年度目標※2を設定
- 重要指標および年度目標の達成状況や今後の取り組みについてレビュー会議にて定期的に確認
- 各指標や目標における責任者のもと、達成に向けた活動を展開

※1 継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P. 17-20
※2 当社ウェブサイト「サステナビリティ年度目標と実績」 www.tel.co.jp/sustainability/goals-and-results/index.html

人材

企業の成長は人。社員は価値創出の源泉

当社は「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、社員一人ひとりが個々の可能性を生かし高い目標に向けてチャレンジできる多くの機会を社員に提供しています。特に人材マネジメントにおいて「TEL Values」「やる気重視経営」「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン」の3つを大切にしています。

TEL Values P. 5-6

創業以来、当社が積み重ねてきた「東京エレクトロンの価値」、「東京エレクトロンらしさ」を振り返り、未来に向けて大切にしたいものをTEL Valuesとしてまとめています。TEL Valuesでは、経営層・社員が一丸となり環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、存分に力を発揮するための原点となる考え方を「誇り」「チャレンジ」「オーナーシップ」「チームワーク」「自覚」の5項目で示しています。またTEL Valuesの浸透を図るため、CEOおよび経営層からのメッセージ発信、日々の業務でTEL Valuesを体感・体現している社員へのインタビューの共有を実施しています。このような取り組みを通じて、社員が失敗を恐れず新しいことに挑戦することや、さまざまな部門・グループ各社が課題解決に向けて協力することの重要性を伝えています。また、新人教育においては経営層による講話やグループワークによる行動計画の策定、自分自身の強みや持ち味を「My Values」として討議することを通じて、入社時からTEL Valuesの理解と実践を促しています。当社においてTEL Valuesは、世代を超えて継承していく重要な価値観と位置づけており、世界中の社員がTEL Valuesの実践に努めています。

やる気重視経営

当社は19の国と地域、87拠点で事業を展開しており、異なる文化的背景や経験、属性をもつ人材が価値観を共有し、グループ一丸となって価値創造に取り組むことが重要であると認識しています。当社で働く社員一人ひとりがエンゲージメントを高く保ち、能力を十分に発揮することが、企業の成長に直結すると考え、社員のやる気を重視した経営方針「やる気重視経営」を実践しています。具体的には、以下の5つのポイントを踏まえ、重点施策に取り組んでいます。

やる気重視経営における5つのポイント
1 自分の会社や仕事が産業や社会の発展に貢献しているという実感
2 会社の将来に対する夢と期待
3 チャレンジできる機会
4 成果に対する公正な評価とグローバルに競争力のある報酬
5 風通しの良い職場

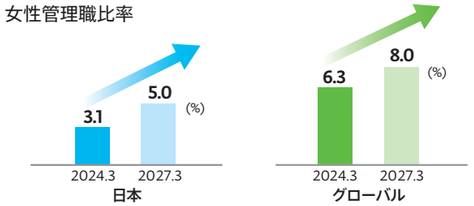
重点施策の事例として、グローバル共通のジョブ型の等級制度 (GTC: Global TEL Career-paths) の運用や高度専門職人材のキャリアパス (TCL: Technical Career Ladder) の明確化、および社員の成長やパフォーマンス向上を促す評価制度の導入など、グローバルな競争に勝ち抜く人事制度を整備し、社員がチャレンジできる機会の創出やキャリア形成の支援を積極的におこなっています。

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン (DE＆I)

当社では経営層の強いコミットメントのもと、継続的なイノベーションの創出や企業価値の向上につながる経営の柱として、DE＆Iを積極的に推進しています。「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」をスローガンに、国籍、性別、世代を大きなテーマとして捉え、3G (Global・Gender・Generation) の考えのもと、グループ各社で以下のような取り組みを実施しています。

- 世界で多様な経験をもつ社員 (国内社員と海外社員の比率=55:45) が活躍できるよう、グローバル共通の人事制度を基盤とし、国や地域を跨いだキャリア形成・人材交流を促進
- サクセッションプランニングにおいて、ジェンダーダイバーシティを意識したタレントパイプライン (人材育成計画) 形成をおこない、女性管理職比率※1を2027年3月期までに日本5.0%、グローバル8.0%にする目標に向けた取り組みを実施。女性社員の比率の推移を考慮の上、今後さらなる目標値を設定

女性管理職比率



- 社員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランディングなどへの積極的な投資をおこない、各地域における一般的な女性エンジニア比率※2と同等以上の女性エンジニアを採用
- 今後5年間において、グローバルで合計10,000名の新卒および中途採用の雇用を計画。また、日本国内においては当社グループで培った経験や知見・スキルを生かせるよう定年後再雇用制度を整備。このような取り組みを通じて、幅広い世代の社員が能力を最大限に発揮すべく組織の活性化を推進
- 社内の推進リーダーや社外の専門家によるDE&I Talkを2020年より開始。共通の特性や経験をもつ社員がネットワークを構築する機会の創出、産休・育休の取得前後におけるキャリア座談会などを実施

※1 高度専門職と定年後再雇用者を含む
※2 理工学専攻の女性比率

「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン・ウィーク（DE＆I Week）」の開催

2024年1月、これまで実施していたDE＆I Talkから規模を拡大し、世界中の当社グループで働く社員を対象としたDE&I Weekを開催しました。具体的には、DE＆Iの理解を促進するためVRを活用し「もし自分がその立場だったら、一体何を感じ、どのように思うのか」を体験してもらう研修や女性エンジニア交流会、男性育休推進イベント、アンコンシャスバイアス※に関する講演会などDE&Iのさまざまな角度から計15のイベントを実施しました。このようなイベントへの参加を通じて、社員の関心や理解を深め、「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」のスローガンのもと、グループ全体のDE＆I推進につなげています。

※ アンコンシャスバイアス：無意識バイアス、無意識の偏見。自分自身が気づいていないものの見方や捉え方のゆがみ・偏り

DE＆Iの主な取り組み

当社では、グローバルで国や組織間の垣根のない企業として多様な人材を生かし、バランスの良い体制やチームづくりを目指して、次のような取り組みを実施しています。

- 海外現地法人を含むすべてのグループ各社においてDE＆I活動レポートを作成し公開することで、拠点ごとの活動を可視化。また社内報や社内向けウェブサイト、SNSなどを活用して社内外に向けた情報を発信

- 社外向けウェブサイト内に"DE&I"を2024年に新規公開。「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」の考えのもと、3GにDiverse Work Styles（多様な働き方）を加えた4つのテーマを重点領域としてDE＆Iを積極的に推進する活動を紹介
- 「キャリアデザインセミナー for Women」を開催。約160名の社員が自主的に参加し、キャリアを主体的に考えるセルフリーダーシップの基礎知識などを習得。自分軸に基づくキャリアデザインや自分の強みを生かしたリーダーシップなど、当社でのキャリアの可能性を探求
- 2021年から、NPO法人J-Win※1のプログラムに社員が参加。多様性の高い社外の環境下で他社メンバーとの活動を通じ、自身がロールモデルとする人との出会いやキャリアアップを目指し、管理職や上級管理職※2に挑戦する意欲の向上に寄与
- 共通の特性や経験をもつ社員がネットワークを構築する機会の創出としてEmployee Resource Group（ERG）を継続的に支援
- 2021年4月のLGBTQ+相談窓口設置に続き、2022年10月1日に同性パートナー定義を制定し慶弔関係の適用を開始。今後はソフト（制度）の拡充とハード（設備）の充実を目指し、当事者だけでなくすべての社員がいきいきと働ける環境づくりを継続的に推進
- 新卒採用や中途採用において、性別、国籍、世代などに関わらず、専門性や経験、将来的な期待値などを考慮の上、当社での活躍が見込まれる人材を継続的に採用

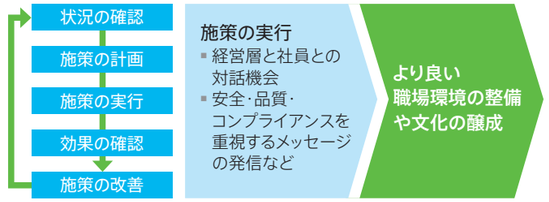
※1 NPO法人J-Win：「特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク」は、企業におけるダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援することを目的に、2007年4月に設立された企業メンバー制の団体
※2 グローバル人事制度による一定レベルまたは一定職位以上の社員

社員エンゲージメント

社員エンゲージメントの向上は、企業におけるパフォーマンスの最大化や持続的な成長に不可欠な要素です。当社では「社員は価値創出の源泉」であるとの認識のもと、社員エンゲージメントの現状把握や課題抽出に向けた「エンゲージメント・サーベイ」を2016年3月期から定期的に実施しています。

2023年3月期に実施したサーベイでは、ほぼすべての国内グループ会社および海外現地法人でエンゲージメントスコアが改善し、全体では2016年3月期比で18ポイント上昇しました。サーベイから得た結果や社員の声をもとに、全社員が自由闊達な雰囲気の中で個々の能力を最大限に発揮しながらいきいきと活動し、建設的な議論や意見を交わせる風土・文化の醸成に向けて取り組み、より良い職場環境の整備に努めています。具体的には、社員集会の開催などにより経営層が現場の意見を取り入れるための情報交換を実施し、グループ全体で経営層と社員の双方向の対話をおこない、コミュニケーションの活性化に取り組んでいます。また、ワーク・ライフ・バランスのさらなる改善やデジタルトランスフォーメーションを通じた業務の効率化、安全・品質・コンプライアンスなどに関する取り組みを推進することで経営基盤の充実や強化を進めています。これらの成果もあり、2024年3月期の社員定着率※は、グローバルで97.5%、日本では98.8%という非常に高い水準となっています。今後もさまざまな活動を継続的かつ効果的に実施していきます。

※ 離職率のデータを用いて算出



人材育成

当社では、急速に変化するビジネス環境の中でグローバルに活躍できる人材の育成に取り組んでいます。社員一人ひとりのパフォーマンスを最大化するために、社員のやる気を重視し、会社と社員の双方が成長し続けるための人材戦略をグローバルに展開しています。

2023年には、半導体の技術革新をリードする人材輩出に寄与することを目指し、日米の大学によって構成される「半導体の人材育成と研究開発に関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ（UPWARDS）※」へ参画しました。

TEL UNIVERSITY体系図

	新人・若手	中堅	管理職・高度専門職・幹部	経営
階層別教育	導入教育（新卒・中途）			
	OJTプログラム（新卒・中途）			
	若手育成	中堅社員教育	マネージャー教育	
			リーダー教育	
目的別教育	技術教育（セミナー・ワークショップ）			
	ビジネススキル			
	グローバルコミュニケーション			
	キャリアサポート			
	全社必須 ウェブ教育			

TEL UNIVERSITYは、2007年に設立された当社の内部教育機関であり、学びの文化の醸成や、社員一人ひとりが自己成長できる機会を提供しています。TEL UNIVERSITYを通じて、将来の当社の発展に不可欠な人材を育成するために次の取り組みを実施しています。

TEL UNIVERSITY

TELの人材育成の基本方針

1. 社員の自己啓発と自己責任が能力開発の基本である
2. 職場・現場が人を育てる
3. 会社は気づきを提供し、仕組みを構築する

※ UPWARDS: U.S.- Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors

グローバル＆オンデマンドによる学習

社員一人ひとりの成長スピードはそれぞれ異なるため、各自のニーズやタイミングに合わせて学習できるオンデマンド教育を取り入れています。働き方の多様化に対応し、オンラインやリモート教育を積極的に活用し、世界中どの拠点からでも学習できるよう共通のプラットフォームを提供しています。

キャリア形成の支援

グローバル人事制度による社員のレベルや目標に応じた基本的なスキルの早期習得に向け、プログラムの拡充を図っています。学びや経験を積み重ね、また自身のキャリア形成について、社員がより具体的なイメージができるような情報やツールの提供による支援をおこなっています。

リーダー育成

当社では、将来を担う次世代リーダーを早い段階から発掘し、計画的に育成しています。これにより、中長期的に企業価値の向上を実現することを目指しています。次世代経営者候補には、社外研修への参加などによるネットワークの構築や幅広い視野の醸成、360度フィードバック※などの機会を提供し、社外取締役を含む経営層が計画的なアサインメントの検討やレビューをおこなっています。

また後継者候補のマネジメント向けには、それぞれの職責に応じた階層別の研修を拡充することでより実践的なスキルの向上を図り、ビジネスの現場において人材を育てるサイクルの推進に努めています。

※ 360度フィードバック: 社員の部下、同僚、上司からのフィードバックと、社員自身による自己評価を収集するプロセス

ワーク・ライフ・バランス

休暇制度

当社では、適切な労働時間の管理や休暇の取得が社員の生産性向上にも寄与すると考え、長時間労働の是正や休暇制度の充実とその取得の推進に取り組んでいます。有給休暇取得率の中期目標として80%以上※1を掲げ、社員に対する計画的な取得への啓蒙活動をおこない、取得状況の定期的なモニタリングや取得率向上に向けたマネジメントを推進しています。2024年3月期の有給休暇の取得率は80%と、中期目標を達成する水準となりました。

また、当社の独自性の高い休暇制度として各国の状況に合わせたリフレッシュ休暇制度をグローバルで導入しています。この制度では社員が心身のリフレッシュを図り、就業意欲を高めることを目的としています。日本の場合は勤続10年以上の社員を対象に、勤続年数5年ごとに2週間から1カ月の特別休暇 (法定外有給休暇) を付与しています。2024年3月期には、日本で630名、海外で827名の社員がリフレッシュ休暇を取得しました。また、育児休業、子の看護休暇や子育て応援休暇※2、有給の介護休暇などさまざまなライフイベントに合わせた制度の構築に努めています。育児休業期間においては最長で「子どもが満3歳に達する日」まで延長することを認める他、育児による勤務時間短縮の措置の対象を小学校卒業までの子どもを養育する社員にまで拡充しています※1。

リフレッシュ休暇
1,457名
(グローバル)

※1 対象は日本
※2 子の看護休暇: 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする社員に対し、年5日の有給休暇を付与、子育て応援休暇: 中学校就学の始期に達するまでの子の養育をする社員に対し、年5日の無給休暇を付与

健康経営

当社が継続的に発展していくためには、社員一人ひとりが充実した日々を送り、パフォーマンスを最大限に発揮することが重要です。社員が健康で安心して働ける職場環境の整備に努めており、その考え方を取りまとめた「健康宣言※1」を2012年に発表しました。その上で、人事担当役員のもと、各事業所に産業医や保健師といった医療職を配置し、有効な健康管理体制を構築しています。

健康に関する具体的な取り組みは、法令に基づく各種健康診断や、担当産業医による長時間労働者への面接指導などを実施している他、希望者には社外の産業カウンセラーによるカウンセリングの機会を提供しています。また、マネジメント層を対象にしたラインケア※2セミナーも定期的に開催し、必要に応じて国内グループ会社の健康担当者や医療従事者との連絡会議をおこない、健康に関するサポートを強化しています。

さらに「コラボヘルス※3」の考えに基づき、東京エレクトロン健康保険組合と連携し健康診断の検査データを活用して、社員個人の状況に応じた保健指導や効果的な予防・健康づくりを実践する「データヘルス※4」の取り組みを積極的に展開しています。

その結果、国内グループ会社全体で「健康経営優良法人※5 2024」に認定され、2020年3月期から5年連続で上位500社に選ばれました。

今後もウェルビーイング※6の観点から、社員が目的意識をもって主体的に仕事に取り組みいきいきと働けるよう、健康に配慮した環境整備を推進していきます。

※1 健康宣言:「Eat」「Rest」「Walk」「Talk」の観点より、健康課題に応じたさまざまな取り組みを推進
※2 ラインケア: 管理職 (部長や課長などの管理監督者) が、自身が管理する部下やチームメンバーの心の健康状態を気づかい、ケアをおこなうこと
※3 コラボヘルス: 健康保険組合などの保険者と企業が積極的に協力し合い、労働者やその家族の健康増進を効果的および効率的におこなうこと
※4 データヘルス: 医療保険者が電子的に保有された健康医療情報を活用し、分析した上で加入者の健康状態に即しておこなわれる、より効果的・効率的な保健事業を指す
※5 健康経営優良法人: 地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度
※6 ウェルビーイング: 身体的、精神的、社会的に完全に「良好な状態」

人権

人権についての考え方

企業活動がグローバルに展開される中、社会では人権に関する問題が深刻化しています。このため当社では、自社を含むサプライチェーン全体において、人権課題を排除し、持続可能な事業活動をおこなうことが重要と考えます。

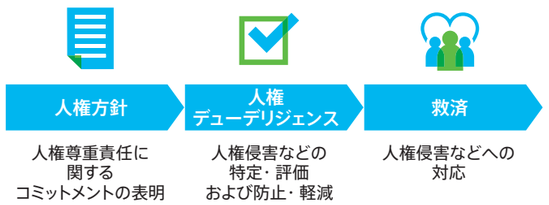
当社は企業の社会的責任を自覚し、高い倫理観に基づいた行動が不可欠であると認識しています。創業以来、特に人権尊重の考え方を重視し、「基本理念」および「経営理念」でその考え方を明文化しています。人権尊重は、事業活動が関与する人権への負の影響を排除するだけでなく、事業活動を支えるすべての人々を尊重し、持続可能で夢のある社会を実現するための重要な取り組みと捉えています。当社は、事業活動のあらゆる側面に人権尊重の考え方を取り入れ、個人がその能力を最大限に発揮し、いきいきと活動できる企業文化の醸成に努めています。

人権方針と推進体制

当社では、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」と、その中で言及されている「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」、また「国連グローバル・コンパクトの10原則」および「RBA行動規範※1」を参照し「東京エレクトロングループ人権方針※2」を制定しています。本方針では、「自由、平等、非差別」「雇用の自主性」「製品安全と職場の安全衛生」「結社の自由」「適切な労働時間と休憩・休日・休暇の確保」の5つを重要項目と定め、役員および従業員における周知を徹底するとともに、お取引先さまへは本方針に沿った事業活動の展開を要請しています。当社では、株主・投資家さまやお取引先さまを含むすべてのステークホルダーと積極的に対話をおこなうことで、社会からの要請や期待に応えるよう努めています。また、社内におけるウェブ教育やお取引先さまを対象とした説明会を通じて人権意識の向上に取り組み、実効性の高い人権尊重を推進しています。

当社ではサステナビリティ統括部が中心となり人権への取り組みを推進し、重要事項についてはサステナビリティ委員会で審議され、CEOが出席するコーポレートオフィサーズ・ミーティングで承認されます。サステナビリティ担当執行役員は、人権に関する重要案件の状況や進捗、結果などについて取締役会で報告し、取締役会はそれを監督します。

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った取り組み



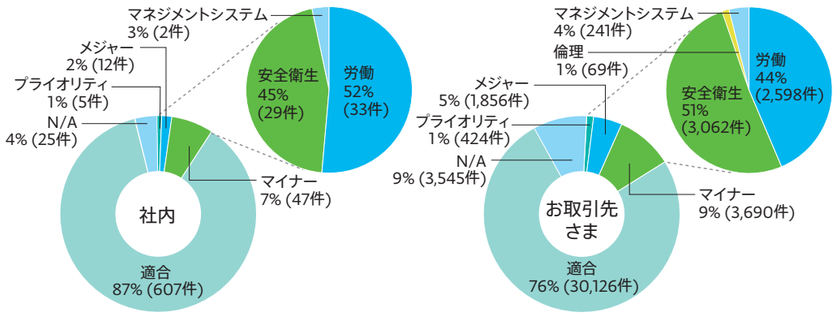
※1 RBA行動規範: RBA (Responsible Business Alliance) が、エレクトロニクス業界のサプライチェーンにおいて、労働環境が安全であること、労働者が敬意と尊厳をもって扱われること、製造プロセスや調達が与える環境負荷に対して企業が責任をもっていることを確実にするために規定した基準
※2 当社ウェブサイト「人権」 www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/index.html

人権デューデリジェンス

当社では、毎年サプライチェーン全体における人権への負の影響 (人権リスク) を特定し、是正のアクションに取り組み、またその実効性の追跡評価を積極的におこなう人権デューデリジェンスを実施しています。

2024年3月期には、国内外の当社グループ12社と、資材・人材・通関・梱包などのお取引先さま約690社を対象に、RBAの監査基準に基づく調査を実施しました。その結果、「方針・手順」「労働時間と連続勤務」「避難訓練」「応急処置」「苦情処理メカニズム」を優先度の高い人権リスクとして特定し、サプライチェーン全体でリスクを低減するためのさまざまな是正アクションを展開しています。また、2023年3月期に確認された優先度の高い人権リスク項目のうち、「身分証明書の会社保管」に関しては社員へ年金手帳を返却し、「方針・手順」「応急処置」などについても改善が認められたことから、是正のアクションの実効性を確認しました。改善状況に一部課題がある項目については、それらの是正アクションの実効性を検証しています。

2024年3月期の調査結果※



RBAの監査基準に基づく当社の適合および人権リスクの分類と定義は以下のとおりです
プライオリティ：特に深刻とされる課題について、重大なリスクを抱える状態にあり、優先的かつ早急な改善の必要性がある、メジャー：緊急性の高い課題について、重大なリスクを抱える状態にあり、早急な改善の必要性がある、マイナー：各分野について、軽微ではあるが課題やリスクが認められる状態にあり、改善の必要性がある、適合：各分野について、課題は認められず要件に適合している状態にある、N/A：設問に対して「設問内容が該当しない」と回答されたものを表す

※ 比率については四捨五入しているため合計が100にならない場合があります

人権デューデリジェンスのステップ

人権への負の影響の特定 ▶ 負の影響の防止・軽減 ▶ 実効性の追跡評価 ▶ 情報提供と外部とのコミュニケーション

優先度の高い人権リスクと是正のアクションおよび改善状況

※ 改善状況　○: 顕著な改善が認められる　△: 一部課題あり

人権リスク	主な課題	社内	お取引先さま	是正のアクション	改善状況※
労働					
方針・手順 • 強制労働・債務労働 • 児童労働 • 懲戒処分としての減給 • 宗教上の慣習 • 結社の自由	• 方針・手順の内容が不十分 • 効果測定プログラムが用意されていない • 外国人労働者が理解できる言語で用意されていない • 従業員への周知が不十分		✔	お取引先さま •「東京エレクトロングループ人権方針」の周知徹底 • RBA要請内容の説明会の開催 • 方針・手順の策定と多言語化での対応 • 社内周知徹底	○
労働時間と連続勤務	• 労働時間の超過 • 連続勤務	✔	✔	社内 • 労働時間/日数の周知と徹底 • 定期的なモニタリングによる注意喚起と効果の確認 お取引先さま • 週単位での労働時間管理の実施 • 定期的なモニタリングによる注意喚起と効果の確認	△
安全衛生					
避難訓練	• 従業員の参加率100%未達 • 日没後の訓練が未実施	✔	✔	社内/お取引先さま • 手順の策定 • 訓練の実行と不参加者へのフォロー対応 • 日没後の訓練計画と実行 • 訓練実施記録の作成と管理、問題点の整理と共有	△
応急処置	• 応急処置手順が整備されていない • 十分な数の応急処置要員がいない		✔	お取引先さま • 手順の策定 • 適正な数の応急処置要員の配備	○
マネジメントシステム					
苦情処理メカニズム	• 外国人労働者が理解できる言語で用意されていない • 従業員への周知が不十分		✔	お取引先さま • 多言語化での対応 • 社内周知徹底	△

救済

当社は人権に関する被害に迅速かつ適切に対処することが重要であるとの認識のもと、救済に積極的に取り組んでいます。すべてのステークホルダーを対象にした内部通報制度を活用することで、確実な救済措置を可能にする救済メカニズムの整備に努めています。

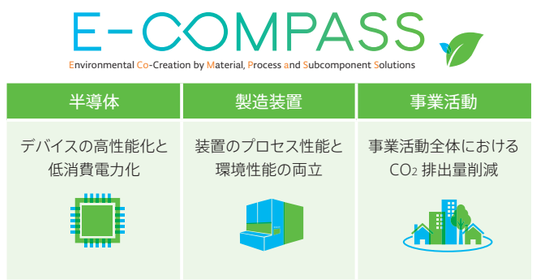
具体的な取り組みとして、2024年3月期には労働者の雇用関連費用の負担に関する不適合が確認されたお取引先さまに対して是正のアクションをお願いしました。

今後も高い倫理観に基づく人権の取り組みを積極的に展開し、自社を含むサプライチェーン全体における人権リスクの低減や救済を推進していきます。

環境

E-COMPASS

当社はリーディングカンパニーとして、環境にフォーカスしたイニシアティブであるE-COMPASS (Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent Solutions) を展開しています。E-COMPASSでは、半導体、製造装置、事業活動の3つの観点においてお客さまやパートナー企業さまと連携し、事業活動を通じて半導体の技術革新と環境負荷低減の実現を目指します。E-COMPASSを中心に、サプライチェーン全体で技術的にも社会的にも価値ある製品・サービスを提供し、持続的な成長につなげていきます。



お取引先さまとの取り組み

当社は今後ますます発展するデータ社会と地球環境保全を両立するために、これまでの取り組みをより一層加速させる必要があると考えています。お取引先さまとのさらなる連携強化を図るため、2024年3月にすべてのお取引先さまを対象とした説明会「TEL E-COMPASS Day 2024」をオンラインと会場のハイブリッド形式で実施し、E-COMPASSの活動進捗やネットゼロに対する取り組みについての共有、また環境に関する教育資料やサポートプランなどについて詳しく説明しました。第3回目となる今回は合計約900名のお取引先さまにご参加いただき、当日の会場ではそのうち約70名のお取引先さまと活発な意見交換をおこないました。

2023年12月には「TELパートナーズデイ」において、E-COMPASS活動に多大なご協力をいただいたお取引先さま3社を環境パートナーとして表彰しました。また2024年4月には、「E-COMPASS サーベイ」としてアンケート調査を実施し、お取引先さまの取り扱い製品における環境配慮の状況や環境法規制への対応、事業における環境負荷低減の活動などについて確認をおこないました。その結果を踏まえ、9月には環境法規制対応およびCO_2排出量削減活動が優れているお取引先さまに対して、敬意と感謝を表しグリーンパートナーの認定を実施する予定です。

2040年までにネットゼロ※を達成するためには、自社におけるCO_2排出量削減のみならず、お客さまやお取引先さまの製造現場におけるCO_2排出量削減のご協力も欠かせません。当社では一部のお取引先さまと協議をはじめ、この目標の実現に向けた施策の具体化に取り組んでいます。また、各製造拠点にネットゼロ担当者を配置し社内体制の整備を進めています。お客さまやお取引先さまとのパートナーシップを通じて、サプライチェーン全体で地球環境の保全に積極的に取り組んでいきます。

※ 自社の活動 (スコープ1、2)、自社以外の活動 (スコープ3) における温室効果ガスの実質排出量を2040年までにゼロにする

環境マネジメント体制

環境対応の重要性が高まる中、当社では環境担当の取締役を責任者とする環境推進室を本社に設置し複数の会議体を運営することにより、グループ全体で中長期的な環境課題に対する取り組みを推進しています。そして、表1の会議体を通してCEOを含むマネジメント層まで、各取り組みの進捗状況を報告しています。

当社は、2017年3月に製造子会社を中心にグループ全体で一括取得したISO 14001認証に則り、環境影響評価を実施し有益な環境側面を抽出するとともに、環境マネジメントプログラムや内部監査チェックリストのフォーマットをグループ内で統一し運用しています。また、頻繁に改正される各国の環境法規制を遵守するため、PFAS※などに関する規制の情報収集の早期化に努め、プロアクティブな対応を進めています。当社では2024年3月期においても環境関連の事故・違反、また訴訟などはありませんでした。

※ PFAS: Per and Poly Fluoroalkyl Substances。有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物の総称

表1

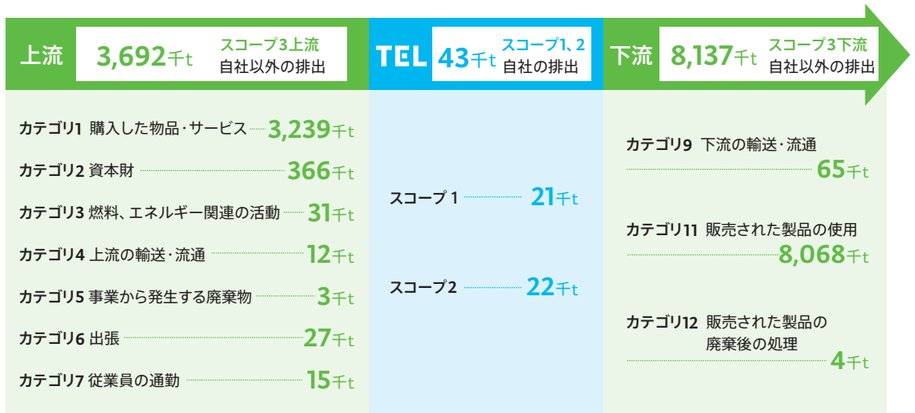
会議名	主な参加メンバー	会議内容	開催頻度
環境活動定例報告会	CEO、コーポレートオフィサー、製造会社社長、環境担当の取締役	グローバル環境会議やTELコーポレート環境会議での討議事項の報告、承認案件の審査	4回 / 年
製造会社社長会※	製造会社社長、環境担当の取締役など	環境課題への対応の進捗についてモニタリングや監督	4回 / 年
TELコーポレート環境会議	環境担当のGM、所属長など	グループ全体の環境活動の推進、グループ全体での目標設定	適宜開催
グローバル環境会議	本社とグループ会社の役員が任命したメンバー	環境課題に対する個別目標の設定、進捗のモニタリング、目標達成に向けた働きかけ	2回 / 年

※ 製造会社社長会では環境の他、安全や品質、サプライチェーンマネジメントなどに関する業務の報告や課題の共有をおこなっている

バリューチェーン全体のCO_2排出量

当社は、「Technology for Eco Life」の環境スローガンのもと、最先端の技術と確かなサービスによる環境問題の解決を目指し、バリューチェーン全体で生じる環境負荷の把握と、その削減に向けた事業活動を推進しています。

当社のスコープ1およびスコープ2のCO_2排出量合計は43千tであるのに対し、スコープ3は上流活動と下流活動の合計11,829千tと、全体の99.6%を占めています。中でも製品使用時のCO_2排出量が8,068千tと全体の約70%を占めていることから、稼動時のCO_2排出量の少ない製品の開発が重要であると考えています。



2023年12月に当初2050年としていたネットゼロの目標達成年を2040年へ10年前倒ししました。気候変動に関する対応は国際的に喫緊の課題と認識されています。当社としても新たな目標のもと、さまざまな施策を実行し、地球環境の保全に努めるとともに、グローバルエクセレントカンパニーとしてネットゼロを積極的にリードしていきます。

当社は、2023年10月に2031年3月期に向けて設定した温室効果ガス削減目標が科学的根拠に基づいた目標であると認められ、SBT※認定を取得しました。

※ SBT: Science Based Targets。SBTはパリ協定が求める水準と整合した、5年~15年先の目標年として企業が設定する目標

SBT 認定目標

- 事業所のスコープ1および2の温室効果ガス排出量を2031年3月期までに70%削減 (2019年3月期比)
- 再生可能エネルギー (電力) の使用比率を2031年3月期までに2019年3月期の2%から100%に増加
- 販売した製品の使用によるスコープ3の温室効果ガス排出量を2031年3月期までにウェーハ1枚当たり55%削減 (2022年3月期比)

環境目標と進捗状況

◎: 目標を上回り達成　○: 順調に進行中　△: 目標達成に向けて加速が必要

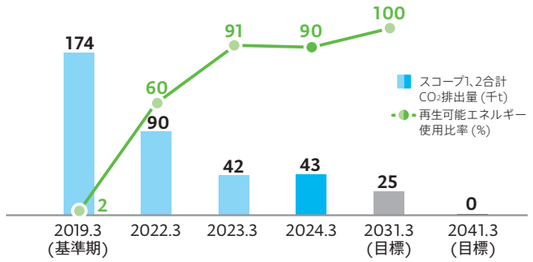
項目	対象	目標値	達成時期	2024年3月期	評価
事業所	CO_2総排出量	70%減	2031年3月期	75%減	◎
	再生可能エネルギー (電力)	100%	2031年3月期	90%	○
	エネルギー使用量 (原単位)	前期比1%減	毎期維持	2/11　事業所にて目標達成	△
	水使用量 (原単位)	基準期維持	毎期維持	10/13　目標にて目標達成	○
製品	ウェーハ1枚当たりCO_2排出量	55%減	2031年3月期	24%減	◎
物流	CO_2排出量	30%減	2027年3月期	18.4%減	○
	木枠からSTW※1への切り替え	50%	2024年3月期※2	通期 22.4% (第4四半期 26.4%)	△

※1 STW: Strong Triple Wall。3層からなる強化段ボール　※2 達成時期を2025年3月期に延長

自社の排出 (スコープ1、2) への取り組み

2031年3月期までに再生可能エネルギー使用比率100%かつ事業所のCO_2総排出量を2019年3月期比70%削減、さらに2041年3月期までにネットゼロの達成を目指しています。全社における2024年3月期の再生可能エネルギー使用比率は90%となりました。その結果、省エネ活動の効果もあり事業所のCO_2総排出量は基準期から75%削減となり目標を前倒しで達成しました。2025年3月期からは目標値を85%削減に変更し、CO_2排出量削減に向けた取り組みをさらに推進していきます。

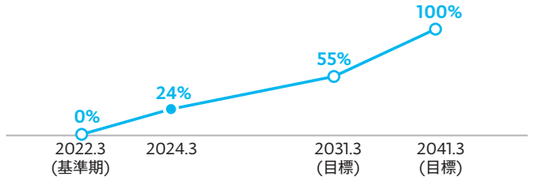
再生可能エネルギー導入などによるCO_2排出量の削減



自社以外の排出 (スコープ3) への取り組み

ウェーハ1枚当たりのCO_2排出量を2031年3月期までに2022年3月期比55%削減とする目標および2041年3月期までのネットゼロの達成を目指しています。2024年3月期のウェーハ1枚当たりCO_2排出量は、基準期比24%の削減となりました。

製品のCO_2排出削減率の推移



物流における取り組み

2024年3月期はSTWの採用とモーダルシフトを積極的に推進しました。STWは重量が軽いため輸送にかかるCO_2排出量の削減が見込まれるとともにリサイクルが可能であり、木材より環境負荷を低く抑えられます。2024年3月期に50%以上の木枠梱包のSTWへの切り替えをおこなう目標としていましたが、実績は通期で22.4%となりました。今後、STW梱包の標準化とお客さまへのさらなる展開に努め、2025年3月期に50%以上と目標達成期を延長して活動を推進します。また、大阪・福岡間のフェリー活用を大幅に拡大するなどモーダルシフトや共同配送化による物流分のCO_2排出削減率は18.4%となりました。これらの取り組みが評価され、エコシップ・モーダルシフト事業実行委員会主催の令和4年度「エコシップマーク」認定において国土交通省海事局長表彰対象に選定されました。

製品開発における取り組み

当社は環境負荷を低減した製品の開発に積極的に取り組んでいます。3D NAND向けに超高速かつ地球温暖化係数84%減を実現したエッチング技術や、レーザ加工で必要な純水が不要となる最先端デバイス3次元実装の技術革新に貢献するレーザ剥離技術の開発など、当社の技術を生かした環境性能の高い装置開発を推進しています。

「気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) 」提言に関する取り組み

当社は、気候変動が事業におよぼすリスクと機会について、TCFD提言に基づく検討をおこない、さまざまな対応策を講じるとともに、透明性の高い情報開示に努めています。2024年3月期にはIFRS S2号※1の内容も検討し、可能な範囲での開示をおこなっています。

また、ネットゼロの目標達成年を2050年から2040年に前倒し、目標達成に向けた取り組みを積極的に展開しています。

TCFD提言への取り組み状況

項目	内容
ガバナンス	● 環境推進室とサステナビリティ統括部を本社に設置し、グループ全体でTCFD提言への取り組みを推進 ● 気候変動関連のリスクと機会への対応や目標の進捗について、サステナビリティ委員会で報告・審議され、CEOが出席するコーポレートオフィサーズ・ミーティングにて承認 ● 環境およびサステナビリティ担当執行役員は、これらの取り組みについて取締役会で報告をおこない、取締役会はそれを監督 ● 本社とグループ会社の役員が任命したメンバーが参加するグローバル環境会議にて、目標設定や進捗のモニタリング、達成に向けた働きかけを実施
戦略	● 気候変動に伴う事業への中長期的なリスクと機会を特定するため、以下の点に考慮して分析を実施 • 事業所の立地 • 気候変動による自然災害の発生と被害の状況 • お客さま、投資家さま、NGO、地域社会からの要請 • 政策や規制・税制 • 再生可能エネルギーや省エネルギーに関する技術動向・市場動向 • 外部機関による気候変動予測のシナリオや調査結果 ● 1.5℃シナリオにおいては移行リスクとして燃料・エネルギー課税に伴うエネルギーコストの上昇など、また4℃シナリオにおいては物理リスクとして異常気象に伴う影響などを特定。機会面においては、技術開発による気候変動対応への先行的な取り組みを特定 ● リスクは、バリューチェーンの上流、直接操業、下流にて発現し、機会は、直接操業、下流にて発現と分析 ● これらのリスクと機会への対応として、シナリオ分析の結果を事業戦略へ反映し、再生可能エネルギーの導入の推進やエレクトロニクス製品の低消費電力化に寄与する革新的な製造技術の提供を通じて、サプライチェーン全体における温室効果ガスの削減や中長期環境目標の達成に向けた取り組みを実施。特定したリスクと機会への対応については、定期的に見直すことで、企業としてのレジリエンス (気候変動への対応力) を向上
リスク管理	● エンタープライズ・リスクマネジメント※2の展開により、事業活動におけるさまざまなリスクの洗い出しを実施し、気候変動を含む「環境対応」を影響度と蓋然性の高い重要リスクの1つとして位置づけ、取り組みを展開 ● 「環境対応」リスクに対し、低減策の検討や実行、効果のモニタリング、リスクのコントロール状況の把握などをおこない、PDCAサイクルを回しながらマネジメントを実施 ● 関連部門や会議体で提言された短中長期における全社的なリスク管理については環境担当の取締役をメンバーに含む製造会社社長会の承認を得て、グループ会社の施設や部門で推進 ● CO_2排出量のスコープ1、2については、排出量の多い国内主要製造拠点にてCO_2排出量削減に向けた対策を実施するとともに、グローバル全体で再生可能エネルギーの導入を推進 ● スコープ3については、販売した製品の使用時のCO_2排出量が当社のバリューチェーン全体の約70%を占めていることからCO_2排出量の少ない製品の提供が重要であるとの認識のもと、さまざまな環境技術の開発に注力、またお取引先さまの事業におけるCO_2排出量削減を推進 ● 異常気象などに起因する自然災害の発生を想定して事業継続計画を策定し、当社が事業を継続的に操業できるよう、お取引先さまとともに対策を実施。国内の各主要製造拠点について自然災害のリスク分析を実施し、災害リスクが低いことを確認
指標と目標	● データ社会の進展とサプライチェーン全体における地球環境の保全に向けて、E-COMPASSの取り組み※3を推進 • 半導体製造装置技術により、世界中で使用される半導体デバイスの高性能化と低消費電力化に貢献 • 半導体製造装置のプロセス性能と環境性能の両立 • 当社の事業活動全体におけるCO_2排出量削減※4 ● 中長期環境目標の取り組み※5 ● 世界情勢や市場動向からスコープ3におけるネットゼロの目標を2040年に前倒し ● ネットゼロの目標において削減が困難な排出量に対しては炭素クレジット証書からオフセットすることを検討 ● IFRSのGHG排出量※4に関する開示

※1 IFRS S2号: IFRS (International Financial Reporting Standards: 国際財務報告基準) サステナビリティ開示基準 S2号 気候関連開示
当社ウェブサイト「TCFD」 www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/index.html
※2 リスクマネジメント P. 75-76 ※3 E-COMPASS P. 52
※4 当社ウェブサイト「環境目標と進捗状況」 www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/index.html ※5 環境目標と進捗状況 P. 54

気候変動の影響により想定されるリスクと機会、当社の対応

時間軸: 短期5年以内、中期2030年、長期2050年
採用シナリオ: 1.5℃シナリオ (気温上昇1.5℃の場合)、4℃シナリオ (気温上昇4℃の場合)
範囲: 当社グループ全体および上流・下流を含むバリューチェーン全体

種類 (シナリオ)	リスクまたは機会項目	発現時期	想定されるリスクまたは機会	当社への影響	影響度の評価※1	当社の対応
移行リスク (1.5℃シナリオ)	● 炭素税※2およびエネルギーコストの増加	短期~中期	● 以下の炭素税が課されると想定 2026年3月期: 10,875円/t-CO_2程度 2041年3月期: 29,725円/t-CO_2程度 ● 電気代・燃料代の高騰	● 当社の温室効果ガス (GHG) 排出量および再生可能エネルギー使用量が2024年3月期と同水準であるとすると、炭素税は以下のとおり増加 2026年3月期: 5億円/年増加 2041年3月期: 12億円/年増加 ● 輸送費の増加 ● 調達価格増加 (調達価格へのエネルギーコスト転嫁)	Low	● 中期環境目標達成に向けた、事業所における省エネルギー化の推進、再生可能エネルギーの導入。国内全事業所における再生可能エネルギー使用比率は2024年3月期に100% (グローバル90%) を達成。また、2024年3月期の水準で算定した炭素税導入による負担増加額は、2021年3月期に想定した額より2026年3月期は11億円、2041年3月期は31億円減少。これまでのリスク評価を「Low~Middle」から「Low」に変更
	● 気候変動を含む環境課題や環境関連法規制などへの対応	短期~長期	● お客さま、投資家さま、NGO、地域社会からの評価の低下 ● お客さまからの要求・要請やエネルギー規制への対応の遅れ	● レピュテーションリスクの増加 ● 設備投資・研究開発費の増加 ● 売上高の減少 ● 規制違反による訴訟や罰金の発生	Low~High	● サプライチェーンにおけるE-COMPASSの取り組みにより、中長期環境目標の達成に向けた活動を展開 ①半導体デバイスの高性能化と低消費電力化に貢献する半導体製造装置技術の開発 ②装置のプロセス性能と環境性能の両立 (製品使用時のウェーハ1枚当たりCO_2排出量削減を実現する技術の開発など) ③事業活動全体におけるCO_2排出量削減 (サプライチェーン上の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入を推進など) ● 各国で改訂される環境法規制に適切かつ迅速に対応 ● TCFDへの賛同と枠組みの活用により、リスクマネジメントを展開 ● 統合報告書やウェブサイトなどで上記の活動に関する情報開示を推進
物理リスク (4℃シナリオ)	● 異常気象	短期~中期	● 当社、お客さま、お取引先さまへの影響 (サプライチェーンの寸断、生産・出荷の遅延、操業停止など)	● 調達額の増加 ● 売上高の減少 ● 保険料の増加	High	● 事業継続マネジメント (BCM) に基づいた事業継続計画 (BCP) の更新と活動の実施、また計画に合わせて定期的なBCP訓練を実施 ● 取引先BCPアセスメント※3によるリスク対応の実施。アセスメントの一環としてお取引先さまの洪水・土砂災害ハザードマップによるリスク調査・評価、および洪水・土砂災害対策状況を確認し、必要に応じてリスク対応のフォローアップを実施 ● 風水害 (大雨・台風など) への全社的な対応基準を整理するとともに、2024年3月期に全従業員を対象とした風水害対策に関するウェブ教育を実施 ● 被災状況の早期確認と速やかな復旧を目指し、調達品生産拠点のデータベース化を推進 ● 異常気象による災害発生に備えた保険への加入
	● 気温上昇	中期~長期	● 気温上昇に伴いクリーンルームなどにおける空調装置の稼動増加	● エネルギーコストの増加	Low	● サプライチェーンにおけるE-COMPASSの取り組みにより、中長期環境目標の達成に向けた活動を展開 (内容については上記①②③を参照) ● サプライチェーン上の気候変動対応、環境規制対応、環境技術革新など ● 最先端の研究開発をグローバルレベルで推進し、革新的な技術をもつBest Productsをタイムリーかつ継続的に供給 ● 地球温暖化係数84%減を実現する次世代以降の3D NAND向けエッチング技術や、純水使用量の大幅な削減とウェーハ調達時のCO_2削減に貢献するウェーハ接合後研削プロセスフリーの剥離技術開発
機会 (共通)	● 環境に関わるオペレーションの効率化	短期~中期	● 生産性の向上	● エネルギーコストの減少	High	
	● 先行的な気候変動対応への取り組みや技術革新による製品・サービスにおける付加価値創出	中期~長期	● GHG低排出製品・サービス開発のためのイノベーション、低消費電力デバイスの製造に寄与する装置や技術の開発など、新たな価値創出のための取り組みが加速	● 売上高の増加	Middle~High	
	● グローバルオペレーションにおけるレジリエンスの構築		● 低消費電力デバイス製造に寄与する装置や技術の開発など、新たな価値創出による競争優位性や事業機会確立			

※1 影響度の評価: 当社内にてリスクや機会の影響度を評価した結果を記載
※2 炭素税: 温室効果ガス排出に伴う増税分はIEA (International Energy Agency: 国際エネルギー機関) のNZEシナリオ (Net Zero Emissions by 2050 Scenario) を参照。1米ドルを145円で換算
※3 取引先BCPアセスメント: 調達額の80%以上 (2023年3月期より調達額85%以上) を占める資材系のお取引先さまに対し、2014年3月期より継続的にBCPアセスメントを実施

生物多様性および森林保全

当社は、2023年3月期に生物多様性および森林保全のためのコミットメントを策定しました。2024年3月期には自然関連財務情報開示タスクフォース (TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) の理念に賛同し、その活動を支援するTNFDフォーラムに参画しました。さらに、TNFDへの対応として、TNFDの基本概要の理解と、TNFDの推奨するLEAPアプローチ※1に基づく優先地域の特定や現状の整理、およびお取引先さまにおける状況や認識を確認するためのヒアリングをおこないました。

当社は、ネイチャーポジティブ※2への移行に向け、事業活動が自然に与える負荷や自然の損失によるリスクの検討をおこない、それらの適切な情報開示に努めます。また、ステークホルダーとも連携しながらバリューチェーン全体で自然資本や生物多様性への取り組みをおこなっていきます。

※1 LEAPアプローチ: Locate (発見する) Evaluate (診断する) Assess (評価する) Prepare (準備する) のアプローチ
当社ウェブサイト「環境」 www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/index.html
※2 ネイチャーポジティブ: 自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させること

廃棄物削減の取り組み

当社は廃棄物削減の取り組みとして、廃棄物排出量の抑制とリサイクルに努めています。廃棄物の適正管理を目的とした電子マニフェスト※1の運用の他、廃棄物の発生量の推移や発生する原因を把握するために、廃棄物集計状況や設備の現場確認をおこない、廃棄物発生の著しい建屋・工程・設備を特定し、分別や工程の追加を含む廃棄物量を削減するための施策を実施しています。具体的には、リサイクル率を向上・廃棄物量を削減するため、分別の徹底や、資源の無駄遣い防止の徹底、パーツ類の在庫の適正化、納入品の通い箱の利用、緩衝材の再利用、リサイクル可能な処分業者への委託などを実施し、埋め立て処理や単純焼却される廃棄物を削減しています。さらに廃棄物置場を改造して容積を増やし収集頻度を削減することで、廃棄物処理のコスト削減だけでなく、環境負荷低減に努めています。

これらの取り組みの結果、2024年3月期の単純焼却や埋め立て処分の対象となる廃棄物排出量は234t、リサイクル率※2は98.8%となり、2007年3月期より18年連続で目標とする「リサイクル率97%以上」を達成しています。また海外事業所におけるリサイクル率も92.9%となり、高水準を維持しています。

※1 電子マニフェスト: 産業廃棄物管理票 (紙マニフェスト) に代えて、情報処理センターと排出事業者、収集運搬業者、処分業者が通信ネットワークを使用して、産業廃棄物の流れを管理する仕組み
※2 リサイクル率: (再資源化量/廃棄物排出量)×100

安全

安全についての考え方

当社では、「Safety First」のスローガンのもと、開発・製造・輸送・据付・メンテナンスなど各種の業務遂行において、経営層から現場担当者まで、すべての人が安全を最優先とし、安全性の向上に向けて、積極的かつ継続的な改善に努めています。

事故報告システム

事故が発生した際には経営層を含めた当社グループすべての安全関係者と情報を速やかに共有し、事故報告システム (TIRS※) を用いて事故対応の状況確認、ならびに当該部署が主体となって再発防止策の実施および効果を確認しています。

※ TIRS: TEL Incident Report System

製品の安全設計

当社は、開発段階から製品のライフサイクルも含めたリスクアセスメントを実施し、その結果を本質安全設計※1に反映させることで、装置が人に危害をおよぼすリスクの低減を図っています。厳格化が進む法規制をグローバルに調査し、国際的な安全規格やSEMI Standards※2に基づき、当社から出荷する装置について第三者審査機関による適合確認をおこなっています。また、装置を納入する各国・各地域の安全規制に対応する体制を構築し、海外現地法人と連携しながら適切に対応しています。

※1 本質安全設計: 機械の設計を工夫することにより、機械が人に危害をおよぼす原因そのものを取り除くこと
※2 SEMI Standards: 半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置、材料メーカーなどに貢献する国際的な業界団体であるSEMIが、これらの国際工業規格の統一を目的に定めた規格

安全教育

当社では安全に関する従業員の意識向上や安全な職場づくりのために、「基礎安全教育」と「上級安全教育」の2つのプログラムを軸として世界共通で展開し、対象となる従業員に対して受講を義務づけています。

「基礎安全教育」では、全従業員が職場で業務を安全に遂行できるよう安全の基本を学ぶことを目的としています。入社時には導入教育をおこない、また3年ごとに更新教育を実施することで安全意識の維持向上に努めています。

また、入社から2年目を迎えた社員に対しては、「基礎安全教育」を補完する目的で、「2年目社員の基礎安全教育」を実施しています。「基礎安全教育」の内容をもとに、特に事故件数の多い重量物持ち上げによる腰痛や転倒事故の防止に特化した教育となっており、危険予知訓練も併せて実施することにより安全への感度向上を図っています。

「上級安全教育」では、製造現場やクリーンルーム内で作業をおこなうエンジニアに対する専門性の高いプログラムであり、毎年更新教育を実施しています。加えて海外転勤者に対しては、各国の安全ルールや法令に関する教育をおこなっています。

このような安全教育の強化や装置安全設計への継続的な取り組みにより、2024年3月期のTCIR※は、半導体製造装置業界トップクラスの0.15を達成しています。中期経営計画の目標であるTCIR 0.10以下の達成に向けてさらなる取り組みを実施していきます。

※ TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率

事故防止への取り組み

当社では、より安全な業務環境の構築を目指して、以下のような活動を展開しています。

安全総点検

お客さまの現場における各種サービス業務や装置据付作業、そして当社の製造現場などでの作業や社内設備管理に関する安全点検項目を準備し、グループ全体で定期点検を実施しています。

この定期点検により、作業安全、教育方法、設備の安全管理方法などの課題を明らかにすることで、各グループ会社における自主的な安全環境の整備や改善活動に役立てています。

安全仕様のフィードバック

お客さまから安全仕様に関わる変更のご要求を受けた場合や装置設計に起因した事故が発生した場合などに、それらの情報を速やかに設計部署へフィードバックし検討を進められる組織体制の強化に取り組んでいます。

お取引先さまとの安全活動

お取引先さまに作業を依頼する場合においても、当社の基本的な作業安全ルールやお客さまにおけるルールなどを記載した資料を事前に共有しご理解をいただくことで、お取引先さまとともに安全活動の推進に努めています。

品質

品質向上に向けた取り組み

従業員一人ひとりが、品質保証活動を正しく理解し実践するためには、達成すべき目標を明確に定義し、それを広く浸透させる環境の整備や文化の醸成が重要です。当社は、品質保証のあるべき姿から「品質についての考え方」と「品質方針」を定め、品質の重要性を従業員に向けて発信し、意識づけをおこなっています。さらに規程や品質基礎教育について適宜見直しをおこない最新の内容を実践しています。また適切な品質情報の見える化により従業員が常に自身の役割と目的を認識し、業務の中で主体的な品質活動を実践するよう促すことで、製品の品質トラブルに対する未然防止の強化に努めています。従業員がさまざまな場面で相互に品質確認を徹底しておこなうことで、業務プロセスの改善と成長につなげ、お客さまのご期待を上回る品質の高い製品やサービスを提供しています。

品質についての考え方

当社では、品質についての考え方を以下のように定義しています。

「東京エレクトロングループは、提供する製品およびサービスが高い品質であることを目指します。それは開発に始まり製造・据付・保守すべての工程を含む、また営業活動の顧客対応業務も品質とみなします。わたしたちは、お客さまの成功を支える高品質の製品およびサービスおよび革新的なソリューションを提供し続けます」

また、品質方針を次のように定め、その実践に努めています。

品質方針

1 「品質優先」
品質の安定は顧客満足のみならず、期待どおりの生産計画を達成し、メンテナンス負荷を低減する基盤であり、一時的なコスト増よりも優先します。

2 フロントローディングと自工程保証
最先端の技術に基づき開発設計段階から品質をつくり込み、すべての業務プロセスにおいて、自らの工程品質を完結することで、高品質の製品を提供し続けます。

3 品質と信頼
品質に問題が生じた場合には、製造・販売・サービス部門が一丸となって、事実に基づき本質的な原因究明に全力で取り組み、速やかな解決に努めます。

4 継続的改善活動
お客さまの満足・信頼につながる活動に対して、品質目標や指標を設定し、PDCAサイクルを回しながら、継続的改善を実施していきます。

5 ステークホルダーとのコミュニケーション
製品品質に関わる必要な情報をタイムリーに発信するとともに、ステークホルダーの期待に適切に対応していきます。

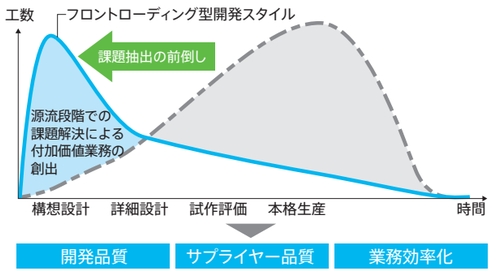
当社では、全社共通の品質方針に基づく規程を、開発・設計・製造・サービスなど主要業務区分ごとにTELマニュアル(TM)、TELガイドライン (TG) として定め、製造拠点を含む当社グループ全体やお取引先さまと共有し運用しています。

また、各製造拠点ではこのTMおよびTGを基盤とした品質マネジメントシステムを構築しています。各製造拠点では品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001:2015を取得するとともに、内部監査および第三者機関による監査を重ねPDCAサイクルを効率的に運用することで、継続的な改善に努めています。本社を中心とする品質保証部門では、前期の実績をもとに毎年品質に関する目標を設定し、定期的にそれらに対する達成度のレビューをおこなっています。

さらに自工程保証※1の実施により、品質に関わるリスクマネジメントや開発・設計審査を開発段階から厳密におこなうとともに、シミュレーションを用いた顧客運用の検証の徹底に努めています。この自工程保証活動を通じて、各工程の精度向上や手戻りによる対応コスト※2の低減に取り組み、上流工程において従業員が付加価値のより高い業務に注力する時間の創出を可能にすると同時に、Shift Left (フロントローディング) を推進しています。

※1 自工程保証: 各工程で不適合を生じさせない、後工程に流さないことを総合的に進める取り組み
※2 手戻りによる対応コスト: 不適合が生じた際に工程をさかのぼってやり直すためのコスト

Shift Left (フロントローディング) の取り組み



サプライチェーンマネジメント

サプライチェーンマネジメントについての考え方と体制

当社は、健全で持続可能なサプライチェーンを構築するため各国の法令、社会規範およびRBA行動規範に基づいた調達方針を策定し、お取引先さまとともに本方針に基づく活動を実践しています。

また、部品・原材料などを取り扱う資材系、役務を提供する人材系、ロジスティクス業務を担う物流系など、パートナーとして当社事業を支えるお取引先さまとの信頼関係の構築に努めています。お取引先さまとの継続的なコミュニケーションを通じて、労働、安全衛生、環境、倫理などのあらゆる観点からサプライチェーンにおける課題を確認しています。これらの課題は、CEOによる監督のもと関連部門で共有し、改善策に取り組んでいきます。今後も、グローバルスタンダードに準拠したオペレーションをお取引先さまと協働で展開することで、サプライチェーンにおける価値創造に努めていきます。

サプライチェーンにおける取り組み

サステナビリティの展開

当社ではRBA監査基準に基づき、労働、安全衛生、環境、倫理などの分野に関するサステナビリティアセスメントを資材系、人材系、物流系※などのお取引先さまを対象に、2014年3月期より毎年実施しています。2024年3月期には、お取引先さま向けにサステナビリティアセスメントに関する説明会を実施し、最新のアセスメント結果と各項目における是正のポイントについてご説明するとともに、是正活動をお願いしました。また、雇用関連費用について不適合が確認されたお取引先さまには個別に是正活動をお願いし、改善につなげています。当社では、サプライチェーンにおけるすべての人々が自由な意思に基づいて労働することを確実にするため、強制労働や債務労働を一切許容しない方針を明文化し、主要なお取引先さまへ伝達しています。

このようなアセスメントの実施に加え、国内外の主要製造拠点においてRBA監査を今後も受審していくことにより、お取引先さまとともにRBA行動規範の遵守をさらに推進していきます。

※ 資材系: 調達額の80% (2023年3月期より85%) 以上を占めるお取引先さまに対し調査を実施、人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) に対し、2019年3月期より100%継続的に調査を実施、物流系: 通関関連業者に対し、2019年3月期より100%継続的に調査を実施

責任ある鉱物調達

当社は、人権侵害や労働問題などを引き起こす要因となっている非合法に搾取・採取された鉱物調達への対応を企業の社会的責任であると捉え、これらを使用した原材料や、含有する部材・部品などの採用を排除していく方針です。この方針に則り、OECD※1による「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」に沿って、責任ある鉱物調達調査をおこなっています。2024年3月期は対象鉱物を3TG※2とし10回目となるCMRT※3を使用した調査の実施により、紛争非関与と判定する根拠の1つであるRMAP※4準拠製錬所に該当する238社を特定することができました。また、紛争に関与した3TGを使用した調達品は確認されませんでした。調査結果についてはお取引先さまと共有し、2025年3月期からは対象鉱物にコバルトを追加するなど、今後もデューデリジェンス活動を実施していきます。

※1 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development。経済協力開発機構
※2 3TG: タンタル、スズ、タングステン、金
※3 CMRT: Conflict Minerals Reporting Template。紛争鉱物に関する国際ガイドラインを制定しているRMI (Responsible Minerals Initiative) により提供された、紛争鉱物報告のための調査フォーマット
※4 RMAP: Responsible Minerals Assurance Process。RMIが提唱・主導する紛争鉱物不使用製錬企業プログラム

調達BCP

当社はBCPの一環として、お取引先さまとともに継続的な災害対策活動に取り組んでいます。複雑化するサプライチェーンを適切に把握するためITシステムを活用し可視化を進めながら、災害発生時にいち早く被災状況を確認し復旧に向けて速やかに協働できるよう、調達品の生産拠点をデータベース化しています。2024年3月期における登録拠点数は約32,000拠点となり、災害発生時の被災状況調査を3回実施しました。また、お取引先さまに対してBCPアセスメントを実施し、その回答内容を分析してお取引先さまにフィードバックすることで、懸念点などの改善につなげています。

サプライチェーンサステナビリティの展開

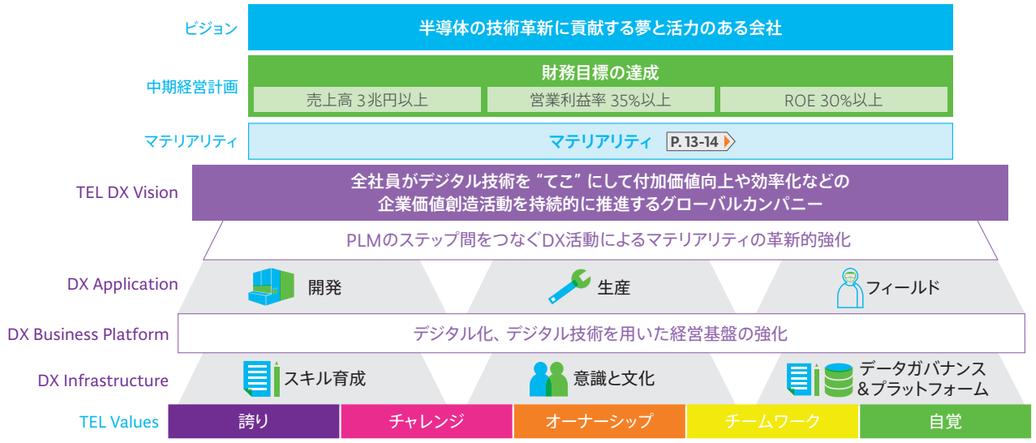
業務効率化と新たな価値の創造

デジタルトランスフォーメーション (DX) の取り組み

当社は、DXの取り組みを経営ビジョンと経営計画を達成し企業価値を創造するための手段かつ契機であると考え、2021年1月に「TEL DX Vision」および「TEL DX グランドデザイン」を策定しました。デジタル化により、経営の重要事項であるマテリアリティを軸とした事業活動を加速・強化していくことを目的に、商品改革と業務改革※を推進していきます。

※ 商品改革: 開発から量産までのさまざまな場面においてお客さまの価値創造に貢献すること、業務改革: 製品の企画段階から保守までのさまざまな場面において資本効率を向上させること

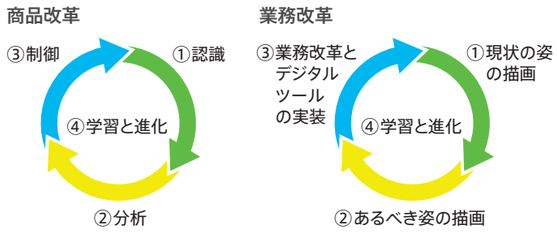
TEL DX グランドデザイン



商品改革では、①認識 (センシングとモニタリング)、②分析と予測、③制御、④学習と進化 (自律化) のプロセスを繰り返しながら高度な課題を解決し、顧客価値の向上を目指します。

また、業務改革では、あるべき姿を描きながら、社内業務の現状を把握し、デジタルツールの活用を通じて業務プロセスを変革し、資本効率の向上を実現していきます。さらに、これらの改革を実現する上で必要な経営基盤およびビジネスサポート部門におけるデジタル活用も推進しています。

デジタル活用による商品改革と業務改革



DX人材の育成については、DXを推進する上で必要な人材を定義するとともに (DXエンジニア)、スキルの習得を目的とした育成計画を策定し、取り組んでいます。さらに、DXエンジニアに限らず、全社員が日々の業務においてデータを活用するためのデータ基盤やデータガバナンスの構築、デジタル文化の醸成にも取り組んでいます。具体的には、外部からDXやAIの有識者を招聘した講演会の開催や、社内でデジタル関連のイベントを実施しています。

DXの取り組みを企業価値の創造につなげるため、2020年11月にはDX活動の本拠地として札幌に「TEL デジタル デザイン スクエア」を開設しました。半導体製造に求められる最先端ソフトウエア技術の開発や、生成AIなどを含む最先端のデジタル技術の開発に取り組んでいます。

また、2023年5月には本社において経済産業省が定めるDX認定制度に基づく「DX認定事業者」に認定されました。

DX認定

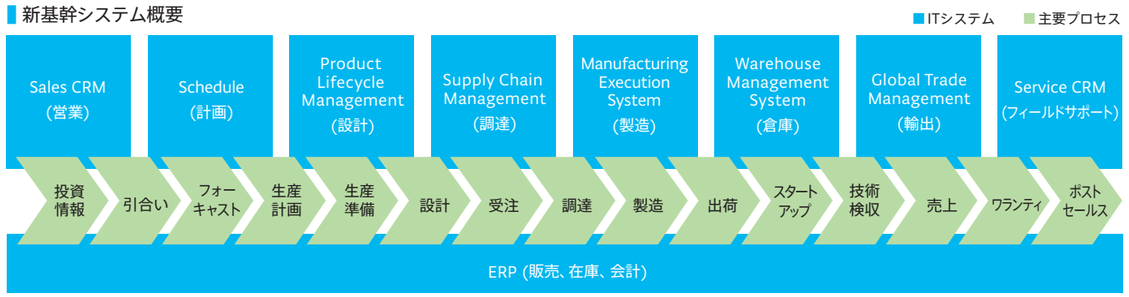
業務効率化

当社では生産性と品質のさらなる向上を目指し、業務や国の垣根を越えた新基幹システム (ERP※) の導入を進めています。本システムの目的は、①大幅な業務効率の改善、②変化に迅速に対応した経営判断、③DXを見据えたグローバル統合情報の活用による新たな価値の創出です。

すでに本システムが導入されている本社に加え、2024年3月期には海外現地法人と国内製造拠点における最初のシステム導入が完了しました。今後はこれまでの過程で得られた知見を最大限に活用し、後続の拠点への導入を順次進めていきます。またパートナー企業さまのご協力のもと、業務効率の改善やシステムパフォーマンスをさらに強化するために、機能開発などをおこないグローバル統合システムを実現します。

※ ERP: Enterprise Resource Planning。企業の「会計業務」「人事業務」「生産業務」「物流業務」「販売業務」などの基幹となる業務を統合し、効率化、情報の一元化を図るためのシステム

新基幹システム概要



知的財産マネジメント

当社は知的財産の保護・活用によって事業活動をサポートし、企業収益の向上につなげることを基本的な考え方として知的財産マネジメントを推進しています。

技術革新が成長を牽引する半導体業界において、持続的な成長を実現していくため、産学連携を含む研究開発をグローバルに展開しています。知的財産部門が各地の開発・生産拠点において研究開発部門や事業部門と連携するとともに、本社においてもマーケティング部門と連携することで、開発におけるシーズや市場のニーズに基づき創出されるイノベーションを適切に保護し、Shift Leftを重視した研究開発戦略に対応する知的財産権ポートフォリオを構築しています。

2023年に創出された発明の数は、日本で1,186件、海外で303件にのぼりました。グローバル特許出願率は5年連続で約75%を維持し、許可率※は日本で81%、米国で80%に達しています。また、国内外のパートナー企業さまやコンソーシアム・アカデミアとの協業においても数多くの発明を創出しており、過去3年間で61件の特許を共同出願しています。

その結果、2024年3月末時点の特許保有件数は、半導体製造装置業界でNo. 1の23,249件であり、知的財産の分野における優位性をグローバルレベルで構築しています。

また、当社の特許ポートフォリオは、他社への影響力や近年の技術的価値上昇度などにおいて高い評価を受けており、2023年に引き続き、「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2024」、および「LexisNexis Global Top 100 Innovation Momentum 2024」にも選出されています。

Top 100 Global Innovator 2024 Clarivate

当社は、知的財産を中長期的な企業価値向上における重要な資産と位置づけており、今後も量と質の両面で競争力のある知的財産権ポートフォリオを構築することで自社技術の差別化を図り、製品競争力の向上に努めていきます。

※ 2023年算出値

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社は、グローバル競争に勝ち抜き、持続的な成長を実現していくために、それを支えるコーポレートガバナンス体制を構築することが重要であると考えています。そのため、ワールドワイドのリソースを最大限に活用するための仕組みを構築するとともに、多様な意見を取り入れ、経営基盤および技術基盤を強化し、グローバル水準の収益力を確立することのできるガバナンス体制を整備していきます。当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン※」を制定し、これまで他社に先駆けて整備・強化してきたコーポレートガバナンスの枠組みを示しています。

※ 当社ウェブサイト「コーポレートガバナンス」 www.tel.co.jp/about/cg/

ハイブリッド型のガバナンス体制

当社は、取締役会から独立した監査役会による監査機能を確保しつつ、取締役の過半数を社外取締役とすることで、取締役会の独立性を高め、監督機能を強化しています。また、指名委員会および報酬委員会を設置し、いずれも委員の過半数を社外取締役とし、委員長も社外取締役が務めています。さらに、コーポレートオフィサー制度を導入し、適切な権限委譲により、迅速な意思決定と機動的な業務執行による強い執行体制の整備を図っています。このように、監査役会設置会社の長所を活かし、指名委員会等設置会社の要素も取り入れたハイブリッド型の実効性のあるガバナンス体制を構築しています。

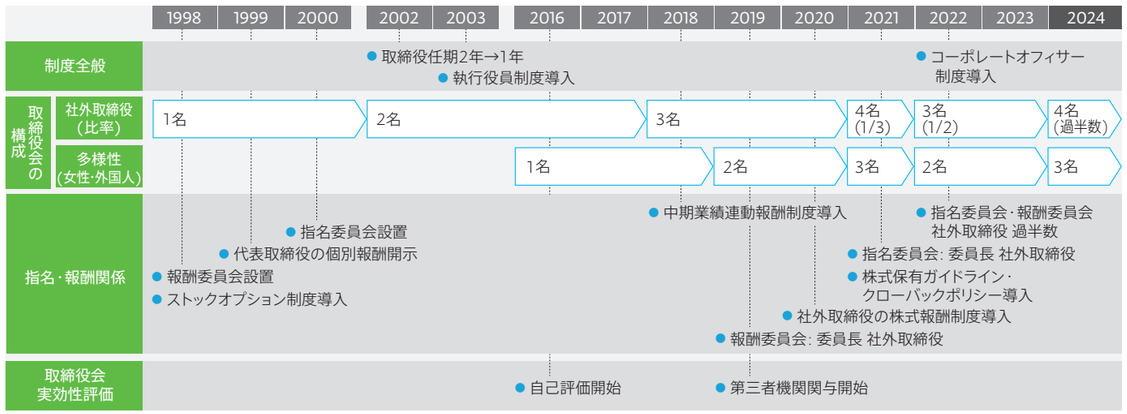
当社のコーポレートガバナンスの特長

独立性・多様性のある取締役会	執行側の機能強化	他に先駆けた先進的な取り組み
●社外取締役比率過半数 (社外取締役4名、社内取締役3名) ●取締役7名のうち2名が女性取締役 ●指名委員会および報酬委員会は、いずれも社外取締役が過半数、委員長も社外取締役	●執行側の最高位の職位として、コーポレートオフィサー制度を導入 ●執行側の最高意思決定機関として、コーポレートオフィサーズ・ミーティングを設置し、取締役会から執行側に適切に権限移譲	●社外取締役の株式報酬制度導入 ●取締役・コーポレートオフィサー・執行役員に対する株式保有ガイドライン※1、業務執行取締役・コーポレートオフィサーに対するクローバックポリシー※2の導入

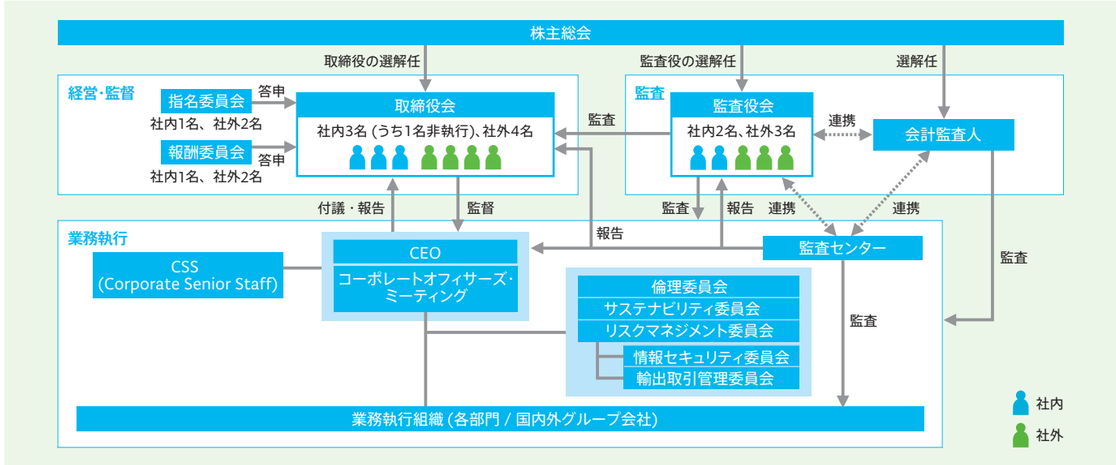
※1 経営陣が持続的な企業価値の向上とステークホルダーとの利益の共有をより確かなものとするために導入。(2021年7月1日発効。2024年4月30日に、CEOと社内取締役・コーポレートオフィサーについて改訂。) ガイドラインの改訂後または就任後5年以内に、以下の価値に相当する当社株式を保有することを目標としています。
<CEO>固定基本報酬 (年額) の6倍　<社内取締役・コーポレートオフィサー >固定基本報酬 (年額) の3倍　<社外取締役・執行役員>固定基本報酬 (年額) の1倍

※2 2021年7月1日発効。業務執行取締役およびコーポレートオフィサーの故意の不正行為を主因として、財務数値の重大な修正が必要となると認められる場合に、業績連動報酬の返還を要求します。返還の対象となり得る報酬は、該当行為が認められた事業年度およびその前の3事業年度において受け取った業績連動報酬のうち過大な部分。

コーポレートガバナンスの変遷 (1998年以降)



コーポレートガバナンス体制図



※ 執行側の各種委員会の目的
倫理委員会 (年2回) : 倫理基準に基づく実践状況の検証、企業倫理に関する教育・啓蒙活動の立案・支援、コンプライアンス推進活動の確認
サステナビリティ委員会 (年2回) : サステナビリティ関連方針の検討と策定、サステナビリティ目標の設定と管理、全社プロジェクトの推進 (環境・人権・RBAなど)
リスクマネジメント委員会 (年2回) : 全社リスクマネジメントの展開と共有、リスクオーナーと連携した各リスク項目におけるリスクシナリオの精査および対策への体制や仕組みの整備
情報セキュリティ委員会 (年2回) : 情報セキュリティ戦略と施策の周知、情報セキュリティ計画の現状などの共有
輸出取引管理委員会 (年1回) : 輸出コンプライアンス活動の推進

取締役会およびオフサイトミーティングの主な議題

CEO	● CEOの業務執行状況報告 (毎回) ● CEOミッションの共有
中長期戦略	● 中長期での市場環境と当社の成長計画 ● 中期経営計画およびその先の成長戦略 ● 財務戦略、資本政策、人材戦略 ● 国内外の開発・生産施設の増強 ● 業務改革プロジェクト ● 生産革新、プロアクティブな調達戦略 ● フロントライン強化
サステナビリティ	● マテリアリティの見直し ● 環境、ネットゼロへの取り組み ● DE＆Iへの取り組み ● 人的資本への投資、知的財産活動

リスク・コンプライアンス	● リスクマネジメント ● 法務・コンプライアンス ● 情報セキュリティ ● 地政学リスク
コーポレートガバナンス	● 内部監査に関する報告 ● 投資先・政策保有株式の状況 ● IR活動の状況 ● 指名委員会、報酬委員会の活動状況 ● 後継者育成計画の進展状況 ● 取締役会実効性評価の課題進捗確認 ● コーポレートオフィサー制度のレビュー ● 代表取締役評価クローズドセッション (代表取締役を除く取締役会メンバー)

CSS (Corporate Senior Staff)

当社は、グループ全体で経営戦略に対する共通認識を図るとともに、各担当領域の短期的視点に捉われることなく、グローバルな横串の視点や中長期的経営の観点から、経営計画の進捗管理や追加施策のレビューをおこなうことで戦略遂行を効率的かつ強力に推し進めることなどを目的として、当社執行役員および海外現地法人の経営幹部などから構成されるCSS (Corporate Senior Staff) を設置し、年に4回、CSSメンバーによるミーティングを実施しています。

2024年3月に台湾で実施

コーポレートオフィサー制度

当社は、半導体製造装置業界のリーディングカンパニーとして、ガバナンスのさらなる強化と、より迅速な意思決定ならびに機動的な業務執行を図るため、2022年6月から、当社独自のコーポレートオフィサー制度を導入しています。コーポレートオフィサーは、当社グループの執行側の最高位の職位であり、CEOと同じ視座で、全社の経営執行に責任をもっています。また、コーポレートオフィサーが取締役会に出席し、業務執行に関する説明をおこなうことは、取締役会が執行側を適切に監督するとともに、取締役会での議論を適切かつスピーディーに業務執行に活かす上で有益であるとともに、攻めの経営の推進にも寄与しています。

併せて、執行側の最高意思決定機関としてコーポレートオフィサーズ・ミーティングを設置しています。コーポレートオフィサーズ・ミーティングは、コーポレートオフィサーの他、コーポレートオフィサーではない社内取締役や社内監査役も参加して原則月1回開催され、取締役会から執行側へ権限委譲された事項をはじめ、執行側の重要な事項を、素早く審議・決定することにより、機動的な業務執行の実現に寄与しています。

なお、2024年7月から、各本部組織の長である本部長を改称し、ディビジョンオフィサーというポジションを設置しました。ディビジョンオフィサーは、各本部におけるグローバルなオペレーションの責任者であり実効性ある戦略の立案と遂行を図るとともに、リスクマネジメントをはじめとする“攻めと攻めのガバナンス”を推進する役割を担います。

当社グループにおける執行側の最高位の職位	CEOと同じ視座をもち、全社の経営執行に責任を有する
コーポレートオフィサーズ・ミーティングのメンバー	執行側の重要な事項を、素早く審議・決定し、機動的な業務執行を実現する
取締役会に出席（議決権はなし）	取締役会での議論を適切かつスピーディーに業務執行に活かす

コーポレートオフィサーメッセージ

長久保 達也
コーポレートオフィサー
専務執行役員

1 コーポレートオフィサー制度導入の効果

コーポレートオフィサー制度は、仕組みとして定着し、より意義のあるものになっていると感じています。各コーポレートオフィサーは「CEOと同じ視座をもつこと」をさらに強く意識するようになっており、取締役会においても高い視座から積極的に発言をしています。また、執行側の最高意思決定機関として機能しているコーポレートオフィサーズ・ミーティングは、取締役会から権限移譲された事項をはじめ、適時かつ活発な意見交換がなされており、それらは導入後2年間を経て進化していると実感します。また、コーポレートオフィサーズ・ミーティングの審議内容は取締役会でも共有しており、取締役会による執行の監督という面でも役割を果たしていると考えています。

2 今後に向けての課題

中長期の成長戦略と企業価値向上に向けた重要テーマを力強く推進していくため、各コーポレートオフィサーの後継者の登用と育成が急務であると認識しており、コーポレートオフィサー全員で時間をかけて議論し、後継者計画が着実に進捗しています。これにより、CEOと同じ視座をもつコーポレートオフィサーは、より高次な経営課題に取り組むことができるようになっています。

役員報酬制度の設計

役員報酬の基本方針

当社グループの役員報酬の基本方針として、以下の点を重視しています。

1 グローバルに優秀な経営人材を確保できるための競争力のある水準と制度
2 短期的業績および持続的な成長に向けた中長期の企業価値向上との高い連動性
3 報酬決定プロセスの透明性・公正性、報酬の妥当性の確保

報酬構成

取締役のうち、社内取締役の報酬は、2024年3月期より、年次業績連動報酬における株式報酬の比率を増やし、その一部を非業績連動報酬（株式報酬）としたことで、「固定基本報酬」「年次業績連動報酬」「中期業績連動報酬」「非業績連動報酬（株式報酬）」で構成されます。

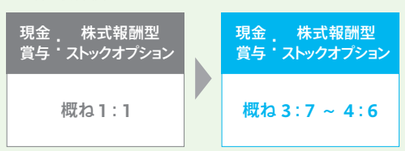
報酬の種類別の方針・決定方法などの概要は下表のとおりです。

報酬の種類		対象者 社内取締役	対象者 社外取締役	対象者 監査役	報酬の概要
固定基本報酬		○	○	○	● 月例報酬とし、株主総会で決議された固定基本報酬限度額の範囲内で決定 ● 社内取締役については、外部専門機関（ウイリス・タワーズワトソン）の職務等級フレームワークを参照し、職責の大きさに応じて設定
年次業績連動報酬	現金賞与	○	—	—	● 事業年度ごとの業績向上への意識を高めること等を目的に、当年度の業績に連動して支給 ● 現金賞与と株式報酬型ストックオプションで構成 ● 年次業績連動報酬と非業績連動報酬の合計の現金賞与対株式報酬型ストックオプションの割合は、職責に応じて、概ね3対7から4対6 ● 具体的な支給額・付与個数は当年度の会社業績と個人パフォーマンスの評価結果に応じて決定 • 会社業績の評価指標は、親会社株主に帰属する当期純利益および連結ROEを採用し、営業利益率・営業利益成長率の競合企業との比較結果を支給額に反映 • 個人パフォーマンスの評価項目には、ESG等を含む短期および中期経営戦略目標に対する貢献度を含む ● 事業年度ごとの業績に応じた利益配分型の報酬とし、固定基本報酬に対する支給割合は設定しない ● 株式報酬型ストックオプションには、中長期にわたり株主目線の共有および企業価値増大への意識を高めることを目的に、権利付与から3年間の権利行使制限期間を設定
	株式報酬型ストックオプション	○	—	—	
中期業績連動報酬	パフォーマンスシェア（株式報酬）	○	—	—	● 中期の業績向上への意識を高めること等を目的に支給 ● 支給率が100%の場合、支給額は職責に応じて固定基本報酬の30%~100%程度に設定 ● 対象期間（3事業年度）における業績目標達成度に応じて交付株式数を決定 ● 業績評価指標には、連結営業利益率と連結ROEを採用
非業績連動報酬	株式報酬型ストックオプション	○	—	—	● 中長期的な企業価値向上への意識を高めること等を目的に支給 ● 支給額は職責に応じて固定基本報酬の概ね2~3倍の範囲で設定 ● 中長期にわたり株主目線の共有および企業価値増大への意識を高めることを目的に、権利付与から3年間の権利行使制限期間を設定
	リストリクテッド・ストック・ユニット（株式報酬）	—	○	—	● 中長期的な企業価値向上の視点から経営に対して助言をおこなうという期待役割に対しより整合した報酬体系とすることを目的に支給 ● 現金報酬と株式報酬を適切なバランスで支給するべく、支給額を固定基本報酬の50%~60%程度に設定 ● 対象期間（3事業年度）終了後に株式を交付

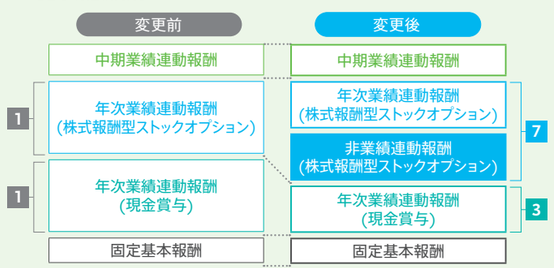
非業績連動報酬（株式報酬）導入に伴う変更

■ 現金賞与と株式報酬型ストックオプションの構成割合

＜当社取締役・コーポレートオフィサー＞



■ CEO報酬構成



取締役会の実効性評価

取締役会の実効性評価の概要

当社のガバナンスおよび取締役会の実効性をさらに高めるために、2016年3月期以降、毎年取締役会の実効性評価を実施し、その結果の概要を開示しています。

2024年3月期の取締役会実効性評価

- **評価対象**　取締役会全体
  (指名委員会、報酬委員会の活動内容を含む)
- **プロセス**　アンケートおよび個別インタビューに基づく、外部専門家による分析結果を踏まえて、社外役員による意見交換会や取締役会において討議を重ね、自己評価を実施しました。
- **評価項目**　実効性評価の主たる評価項目は以下のとおりです。

- 全体評価
- 取締役会の構成
- 取締役会の事前準備
- 取締役会の運営
- 取締役会での審議
- 指名委員会、報酬委員会の役割、運営状況
- 監査役の役割
- コーポレートオフィサー制度

前期の実効性評価における課題への対応状況

課題	対応状況
当社が中長期的にグローバルNo.1となるために、取締役会の監督機能および執行側の経営・執行機能のさらなる強化に向けて、以下の各事項に継続的に取り組むとともに、定期的に進捗をレビューすることで、その実効性をさらに高める	● オフサイトミーティングにて機関設計に関する討議を実施し、現状は監査役会設置会社を継続する方針を確認した ● 取締役会やオフサイトミーティングにて、各項目の取り組み状況や課題について討議を実施した
中長期戦略や成長課題に沿ったアジェンダの計画的な設定と長期目線に立った議論の充実を図る	● 年間予定議案の一覧表を提示した ● オフサイトミーティングにて中長期戦略に関する重要テーマを討議するも、ビジョンの実現に向けた取り組み等については、さらなる深化・具体化の余地がある
執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティングの実効性をさらに高める	● 会議体の見直しを含む、議案決定プロセスの最適化に取り組んでいる ● 取締役会に対して、コーポレートオフィサーズ・ミーティングの説明資料や議事録を共有するとともに、審議内容を定期的に報告している
取締役会の審議状況の分析や審議ポイントのさらなる明確化を図るとともに、取締役会やオフサイトミーティング以外の場での社外役員に対する情報提供機会の拡充を進める	● 資料や情報の粒度の改善に継続的に取り組んでいるが、説明時間の短縮、審議の充実に向けて、さらなる改善の余地がある ● 取締役会議長と社外役員のフリーディスカッション、CEOと社外役員の情報交換会を定期的に開催したほか、オフサイトミーティングに合わせて工場見学を実施した

2024年3月期の評価結果の概要

当社取締役会は、取締役会の役割・責務を、総じて高い実効性を担保しながら適切に果たしており、指名委員会・報酬委員会を含め有効に機能していると認識しております。

外部専門家の分析・評価結果においても、当社取締役会は、実効的に運営されており、自由闊達な議論がおこなわれていること、また、前期の課題に関しては、改善傾向にあることが確認されました。加えて、さらなる実効性の向上に向けて、取締役会における議論を「グローバルなリーディングカンパニー」という高い視座で捉えるべきステージに入っており、その前提として取締役会が果たすべき役割が問われているとの指摘がなされました。

外部専門家の分析・評価結果を踏まえ、持続的成長に向けた会社のありたい姿に照らし、取締役会がどのような機能と役割を担うべきかについて継続的に議論していくとともに、執行側においては経営・執行機能のさらなる強化を図っていくことが必要であると認識しました。

今後の取り組み

当社は、今回の評価結果を踏まえ、以下の事項に取り組み、定期的に進捗をレビューすることで、その実効性をさらに高めてまいります。

取締役会の機能と役割

- 持続的な成長という将来展望から逆算し、中長期視点での当社のありたい姿を取締役会およびオフサイトミーティングで共有し、取締役会が果たすべき機能・役割やガバナンス体制の在り方について継続的に議論していく
- 当社の企業価値向上につなげていく観点から、今後も取締役会のアジェンダ設定を適切におこない、中長期の成長戦略に対する目線合わせと戦略的な議論のさらなる充実を図る

執行体制のさらなる強化と後継者計画の加速

- 従来のコーポレートオフィサーが本部長を兼務する体制を改め、新たにディビジョンオフィサー制度を導入する。これにより、CEOと視座を共にするコーポレートオフィサーはより高度な経営課題に注力するとともに、次世代経営人材を中心に構成されるディビジョンオフィサーが各本部の業務執行を統括する体制とする

新任社外役員メッセージ

半導体製造装置業界をリードする東京エレクトロンの取締役会メンバーの一員に加わることを光栄に思います。当社のVision & Valueには大変共鳴しており、誇りに思える理念と価値観です。マネジメントチームが掲げる成長戦略、技術革新、そして価値創造への取り組みを最大限サポートしていきたいと考えています。また、取締役としての役割である監督と助言においても建設的かつ積極的に取り組んでまいります。

グローバル企業はかつてないほど地政学リスク、情報セキュリティ、産業競争、アクティビズム、そして社会的責任などの課題に直面しています。

私は国際金融業に40年近く携わり、その一環でマクロ経済、安全保障、金融および財政政策そして日米政局について考えてまいりました。当社の発展のため、社員はじめステークホルダーの皆さまのご期待に添えられるよう、誠意をもって取締役の責務を果たしてまいります。

ジョセフ・クラフト
新任社外取締役

東京エレクトロンは、「半導体の技術革新を牽引し社会の持続的な発展を支える」という重要な使命を担っています。当社のイノベーションを支えてきた“変化をチャンスと捉えやり遂げる”という企業風土を尊重し、取締役会の一員として、新しいことへのチャレンジ、健全なリスクテイクを積極的にサポートしていきます。

不透明さが高まる環境下、経営にはますます多様な視点が求められていると認識しています。私はこれまで全く異なる業界でブランド事業やDE&Iを担当してきました。異質なキャリアを活かし、当社が目指す姿を描く際の盲点を減らすこと、そしてイノベーションを支える組織能力、すなわち多様性を活かす企業文化を発展させることに貢献したいと考えます。

ステークホルダーの期待に応えるべく、取締役会メンバーや執行リーダーシップチームとの建設的な議論を通じて、未来を見据えた揺らがない経営基盤と企業価値向上に努めていきます。

鈴木 ゆかり
新任社外取締役

半導体産業のフロンティアを切り拓き続けている東京エレクトロンの社外監査役に就任することを光栄に存じます。当社は、技術専門商社として創業して以来、一貫して顧客とともにイノベーションの最先端を歩み、事業形態を変革、発展させつつ、多くの荒波を乗り越えて今日の地位を築き上げてきました。創業後60年余にしてなお、旺盛なフロンティア精神と思考の柔軟さが当社の特質であり、競争力の源であると考えています。

私は金融界で高度成長、バブル崩壊と経営危機、金融資本市場の改革と金融技術革新への対応という激動と変革の時代を過ごし、企業家精神の維持向上と実効性あるガバナンスの確立を両立することの大切さと難しさを痛切に感じてきました。

その経験と教訓、そして金融の専門家としての知見を活かし、誠実にかつ公正な立場から活力に満ちた実効的なコーポレートガバナンスの実現に貢献し、ひいては持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できるよう精励いたします。

遠藤 寛
新任社外監査役

スキルマトリックス

各取締役・監査役が、「グローバルビジネス」「ガバナンス」「サステナビリティ」のほかに、指名委員会および取締役会において定めた、以下のようなスキルを発揮することにより、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を実現します。

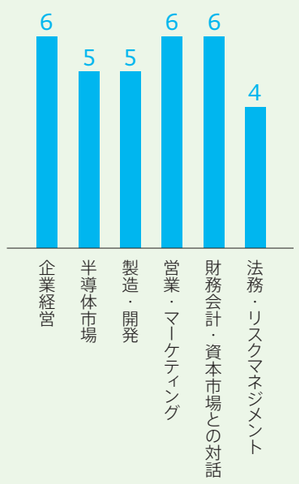
氏名				期待するスキル項目					
				企業経営	半導体市場	製造・開発	営業・マーケティング	財務会計・資本市場との対話	法務・リスクマネジメント
取締役	河合　利樹	再任		●	●	●	●		
	佐々木　貞夫	再任		●	●	●	●		
	布川　好一	再任			●	●	●	●	
	佐々木　道夫	再任	社外	●		●	●		
	市川　佐知子	再任	社外					●	●
	ジョセフ・クラフト	新任	社外					●	●
	鈴木　ゆかり	新任	社外	●			●		
監査役	田原　計志			●	●	●	●		
	七澤　豊				●			●	
	和貝　享介		社外					●	●
	三浦　亮太	再任	社外						●
	遠藤　寛	新任	社外	●				●	

期待するスキル項目の定義および選定理由

企業経営	取締役会の監督機能を果たすとともに、攻めと攻めのガバナンスを実現するためには、企業経営の経験 (代表取締役、会長・社長経験者) が必要である。
半導体市場	技術革新が速く、市場の変化も活発な半導体製造装置業界において攻めの経営をより一層推進していくためには、半導体市場に関する知見が必要である。
製造・開発	技術動向やお客さまのニーズを踏まえた研究開発力を強化するとともに、環境に配慮した効率的な製造オペレーションを構築していくためには、当社または他の製造業における製造・開発に関する知見・経験が必要である。
営業・マーケティング	お客さまの唯一無二の戦略的パートナーとして、最適なソリューションの提案によるお客さまのさらなる価値創造に寄与するためには、当社または他の製造業における営業・マーケティングに関する知見・経験が必要である。
財務会計・資本市場との対話	成長戦略や財務戦略の策定と実行、資本効率の向上、株主還元を通した株主価値のさらなる向上を目指していくためには、財務会計、M&Aに関する知見、または、資本市場との対話についての知見・経験が必要である。
法務・リスクマネジメント	複雑化、多様化するリスクについて、ビジネスの成長の機会として、グループ全体で適切に対応するためには、法務、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する知見が必要である。

取締役・監査役に期待するスキル項目

(単位: 名)



取締役、監査役、およびコーポレートオフィサー一覧 (2024年7月1日現在)

取締役

かわい としき
河合 利樹
代表取締役社長
CEO
コーポレートオフィサー

さ さ き さだお
佐々木 貞夫
代表取締役副社長
コーポレートオフィサー
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ (株)
代表取締役会長

ぬのかわ よしかず
布川 好一
取締役
取締役会議長

さ さ き みちお
佐々木 道夫
社外取締役
(株) SHIFT取締役副社長

いちかわ さ ち こ
市川 佐知子
社外取締役
田辺総合法律事務所
パートナー
オリンパス (株) 社外取締役
アズビル (株) 社外取締役
公益社団法人
会社役員育成機構 理事

ジョセフ・クラフト
社外取締役
Rorschach Advisory Inc.
CEO
ソニーグループ (株)
社外取締役

すずき
鈴木 ゆかり
社外取締役
セコム (株) 社外取締役

監査役

た は ら かずし
田原 計志
監査役

ななさわ ゆたか
七澤 豊
監査役

わ が い きょうすけ
和貝 享介
社外監査役
和貝公認会計士事務所
所長
持田製薬 (株) 社外監査役

みうら りょうた
三浦 亮太
社外監査役
弁護士法人三浦法律事務所
パートナー
テクマトリックス (株)
社外取締役 (監査等委員)
エーザイ (株) 社外取締役

えんどう ゆたか
遠藤 寛
社外監査役

コーポレートオフィサー

ながくぼ たつや
長久保 達也

いけだ せいすう
池田 世崇

み た の よしのぶ
三田野 好伸

おおくぼ たけし
大久保 豪

あきやま けいいち
秋山 啓一

いしだ ひろし
石田 博之

Chapter 3 バリューチェーンによる価値創造

取締役会議長・社外役員座談会

佐々木 道夫
社外取締役
指名委員会委員長
報酬委員会委員長

市川 佐知子
社外取締役
指名委員会委員

布川 好一
取締役会議長
指名委員会委員
報酬委員会委員

三浦 亮太
社外監査役

和貝 享介
社外監査役

東京エレクトロンでは、グローバル競争を勝ち抜き、持続的な成長を遂げるために、コーポレートガバナンスを重要視しています。今回は、取締役会議長と社外役員が「攻めと攻めのガバナンス」の取り組み評価、指名委員会の実効性、さらなる企業価値向上に向けた課題について議論しました。

「攻めと攻めのガバナンス」の評価について お聞かせください。

布川取締役会議長　多くの企業がガバナンスを「守り」とし、事業戦略を「攻め」とする中で、当社は一歩先を行き、ガバナンスを「攻め」として戦略的に取り組んでいます。このアプローチを「攻めと攻めのガバナンス」と呼び、実効性の向上に努めています。2024年3月期は、安全、品質、コンプライアンス、DE&I、社員やステークホルダーとのエンゲージメントに関して、上層部から社員まで意識の徹底を目指して活動し成果を上げることができました。情報セキュリティを含むリスクマネジメントは、終わりのない改善と体制強化が重要と考えております。特に「Safety, Quality, and Compliance」は社内でも強調して伝え、確認と報告を徹底しています。例えば、TCIR(労働時間20万時間当たりの人身事故発生率)については、全社員に目標値0.10以下の意義を説明し、納得してもらうことで現場への理解浸透を図っています。

佐々木取締役　意識の徹底については、トップからの発信を、海外拠点を含めた社員集会や経営会議、3カ月に1度の中期経営計画の進捗会議などで繰り返し発信しています。非常に変化の激しい世の中なので、外部環境の変化を予測するリサーチや、注力分野の比重のかけ方など常に変化する状況を把握するセンシング能力を高めて正しい判断をし、変化に合わせて柔軟に対応できる組織にしていくことが今後の課題になると思います。

和貝監査役　従業員のマインドセットは、さまざまな施策が機能する基盤となっています。「攻めと攻めのガバナンス」を機動的に展開するために、取締役会とは別に執行責任機能を明確にしたコーポレートオフィサー制度の設置や、コーポレート部門組織の更新・新設、ディビジョンオフィサーの選任など攻めの組織改革を実行している点は評価できます。

市川取締役　「攻めと攻めのガバナンス」への取り組みは高く評価できます。しかし、思いがけないところで、セキュリティやコンプライアンス問題は発生する可能性があるため、さらなる攻めの姿勢が必要です。現在の取り組みの延長線上にとどまらず、対応をもう一段と進め、新たな課題にも積極的に対応する必要があります。

三浦監査役　監査役として、監査法人・法務・知財など、当社を取り巻くさまざまな部門と日々連携しており体制や運営は問題ないと思っています。ただ、ガバナンスやリスクマネジメントはゴールのない不断の努力が必要な取り組みなので、さらなる攻めの姿勢が必要だと思います。例えば「バッドインフォメーション・ファースト」も当社は情報共有が速い方だと思いますが、さらに速く連絡がくるような体制を期待しています。

指名委員会の成果と課題について お聞かせください。

佐々木取締役　前期は10回の指名委員会を開催し、主に「CEOのサクセッションプラン」と「社外取締役候補者」について議論を重ねました。CEOのサクセッションプランについては、後継者候補と育成計画について時間軸を含めて協議しましたが、まだ十分とは言えず、体系的かつ継続的な進め方が必要です。今回の2名の社外取締役候補については、企業経営、資本市場、リスクマネジメント、グローバルでのマネジメント経験の観点から候補者を選出しました。

市川取締役　前回の取締役会実効性評価で、指名委員会に対してはCEOのサクセッションプランの透明性不足と社外取締役候補の人数不足の指摘がありました。これはガバナンスの実効性が機能している証拠であり、大変ありがたいことと受け止めています。これを踏まえ、スキルマトリックスの考え方を整理し、指名委員会が作成する候補者リストを充実させるために、リストの作成方法やフィルタリング手順を定めました。また、経営層候補者の選出についても具体的な時間軸を確認しました。

三浦監査役　人材の獲得・育成については、どの企業の取締役会でも主要なテーマとなる共通した課題で、特にCEOのサクセッションプランは、企業にとって最も難しい問題です。指名委員会として共有できること・できないことがありますが、採用や育成のプロセスや実績などについて具体的な情報が取締役会のメンバーに共有されることが望ましいです。役員がそれぞれ「指名」「報酬」「監査」の3つの役割を担う中で、どのように情報連携を実施していくかが課題です。

さらなる企業価値向上への課題について お聞かせください。

市川取締役　半導体業界は世界的に大幅な成長を遂げており、当社は参入障壁の高い市場で堅調な業績を誇っています。しかし、寡占市場において競合他社は非常に手強く、今後の競争はさらに熾烈になることが予想されます。さらに、技術革新のスピードが速く、突然のゲームチェンジが起こる可能性があります。このような状況において当社は、開発分野の目利き力を高め、M&Aなどで積極的に新しい技術を取り入れる必要があります。また、異業種から高度なスキルをもつ人材を獲得し、その能力を活かす多様性のある組織体制の構築が必要です。

佐々木取締役　長期戦略においては、新技術や新事業への投資が重要です。他社の追随を許さない技術革新を生み出すためには、超長期の展望をもち、外部環境の変化を踏まえた「集中と分散」の議論が必要です。分散の技術開発の中で柔軟に投資判断をおこない、芽が出そうな技術に集中することが重要です。

三浦監査役　顧客である半導体メーカーが求める付加価値の高いプロダクトを製造できるかどうかが当社の成長を左右すると理解しています。そのためには、研究開発への資本投下先の選定と人材の確保・育成は、企業価値向上のための課題です。超長期の展望を見据えつつ、足元のやるべきことをしっかり固めるバランスが重要です。

和貝監査役　グローバルリーディングカンパニーとして、企業価値と社会的価値の向上を同時に達成し、持続的な循環を生み出すことが使命です。そのためには、マテリアリティに基づく重要指標の確実な実行とその成果の開示が重要です。

布川取締役会議長　ネットゼロやサステナビリティへの取り組みが企業価値をさらに高めるドライバーとなります。世界の電力需要の増加を抑制するためには、半導体の低消費電力化が重要です。半導体製造装置業界のリーダーとして、すべてのステークホルダーとともにネットゼロを目指していきます。社外役員の皆さまには当社を的確に理解していただき、当社の将来を考えていただいた上での発言を嬉しく聞かせていただきました。皆さま、今後ともよろしくお願いします。

資本市場との対話

当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営層が率先してIR (Investor Relations)・SR (Shareholder Relations) 活動に取り組んでいます。

IR活動においては、四半期ごとの決算説明会や中期経営計画説明会にCEOおよび各担当役員が登壇し、事業戦略や成長ストーリーをステークホルダーの皆さまや機関投資家さまに共有しています。また、当社では投資家さまとの深い議論ができるよう、経営戦略本部の中にIR専門部署を設置しています。2024年3月期においては、ニューヨークにIR分室を設け、北米地域における投資家さまとの対面での対話の機会が増加し、当社をはじめとする日本の半導体製造装置業についての認知が広がりました。

SR活動においても、当社役員を中心に主要な投資家さまや議決権行使助言会社との建設的な対話を図っています。株主総会前における議案の説明に留まらず、年間を通してコーポレートガバナンスやサステナビリティに関する方針や環境・人権・DE&Iへの取り組みなど、さまざまなテーマに関して対話を重ね相互理解を深めています。投資家さまとの対話で得られたご意見などは、定期的に経営層および取締役会に報告しています。

主な活動

対話の機会※1	IR活動	●機関投資家さま向け個別ミーティング 東京本社528件、ニューヨーク拠点201件、その他80件※2、計809件 ●海外ロードショー※3 10の国と地域 ●工場見学会 13件
	SR活動	●機関投資家さま向け個別ミーティング 23件
情報の提供	決算説明会 中期経営計画説明会	●同時通訳や字幕を活用した配信 ●説明会から1営業日以内のアーカイブ配信、2営業日以内の質疑応答集の開示
	定時株主総会	●招集通知のウェブサイト掲載や早期発送
資料の開示	IR関連	●有価証券報告書、統合報告書、ファクトブック (各年1回) ●四半期報告書、決算短信、決算説明会資料、コーポレートアップデート (各年4回)

※1 2024年3月期　※2 工場見学会、海外ロードショーを含む　※3 海外ロードショー：株主・投資家さまを直接訪問するIR活動

コンプライアンス

コンプライアンスの考え方

当社は、業界のリーディングカンパニーとして、企業倫理およびコンプライアンスを重要な価値観として位置づけています。コンプライアンスは安全・品質と同様に、企業の信頼と持続的な成長の基盤となるものであり、個人や組織の行動においては、法令や規制の遵守は当然のこと、高い倫理観と誠実さが求められます。また、コンプライアンス違反を未然に防ぐためにコンプライアンス意識の啓発と行動変革の仕組みを強化するとともに、実効性のあるプログラムを推進します。これらの取り組みによって当社の企業価値向上を支えていきます。

コンプライアンス体制

当社では、グローバル企業として求められるコンプライアンスプログラムを効果的に推進するため、本社にチーフ・コンプライアンス・オフィサー (CCO) や専任部署であるコンプライアンス部を設置しています。また、海外の主要拠点においてはコンプライアンス担当責任者を任命し、CCOおよびコンプライアンス部に直接報告する体制を整えています。

コンプライアンスの取り組み

企業倫理およびコンプライアンス

すべての役員および従業員を対象とした行動規範である「東京エレクトロングループ倫理基準」を制定し、倫理委員会を設置することで、企業倫理およびコンプライアンスのより効果的な浸透・推進を図っています。懲戒処分においては、合理的かつ相当性のある処分および適正な手続きの実行を目的として、懲戒委員会を倫理委員会の下部組織として設置しています。さらに、各グループ会社との定期的な会議を通じて、コンプライアンス推進に関する施策を討議・実行しています。

また、当社グループにおいて意識の向上やコンプライアンス文化の醸成を促すため、企業倫理およびコンプライアンスに関して優れた活動をおこなった従業員に対する表彰制度を設けています。

贈収賄防止および競争法に関する取り組み

贈収賄防止においては、「贈収賄・腐敗防止に関する基本方針」および「贈答・接待のガイドライン」を、競争法においては「競争法コンプライアンスに関する基本方針」および「ガイドライン」を、グローバル共通で制定しています。当社は違法行為を未然に防止するために定期的に啓発活動をおこない、これらの方針およびガイドラインの理解の促進と浸透に取り組んでいます。

内部通報制度

当社は、従業員が安心して安全に職制以外のルートで情報提供および救済を求められるように、法令または企業倫理に反する行為もしくはその可能性のある行為について通報・相談できる内部通報制度を確立しています。この制度では、「守秘・匿名性の確保、報復行為および不利益取り扱いの禁止」を徹底し、コンプライアンス違反行為に関与した従業員などが自ら通報・相談をおこなった場合には、懲戒処分などを減免できる「社内リニエンシー制度」を導入しています。これにより、積極的な情報提供を促し、問題の早期発見・解決につなげています。

この内部通報制度では、お取引先さまや退職者も利用可能な、第三者機関のシステムを利用したグローバル統一の社内窓口「TELグループ倫理・コンプライアンスホットライン」および弁護士事務所に直接相談できる社外窓口を設置し、運用しています。社内窓口は、電話や専用サイト経由で24時間365日利用可能であり、従業員が使用するすべての言語に対応しています。

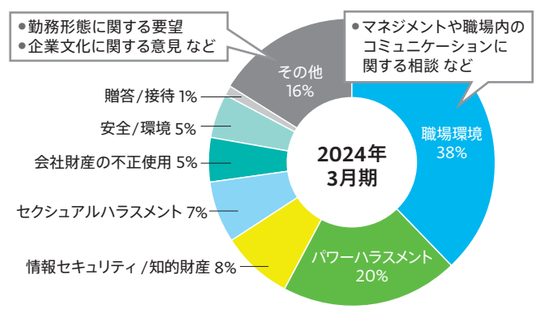
これらの窓口で受領した通報・相談には、真摯な姿勢で対応し、社内規程に則って調査を実施しています。コンプライアンス違反が認められた場合、就業規則に基づく処分、職場環境の改善など必要な是正措置および再発防止策を講じています。

2024年3月期に内部通報窓口に寄せられた通報・相談件数は110件で、そのうちコンプライアンス違反と認定された事案は16件※でした。通報・相談の主な内容は、ハラスメントを含む職場環境に関するものでした。この結果に基づき、当社では引き続きハラスメント防止を目的として、従業員に対して定期的な教育を実施し、当事者および関係者へのフォローアップを徹底しています。また、CCOからマネージャー層に対して風通しの良い職場環境構築の重要性を含むコンプライアンス研修をおこないました。

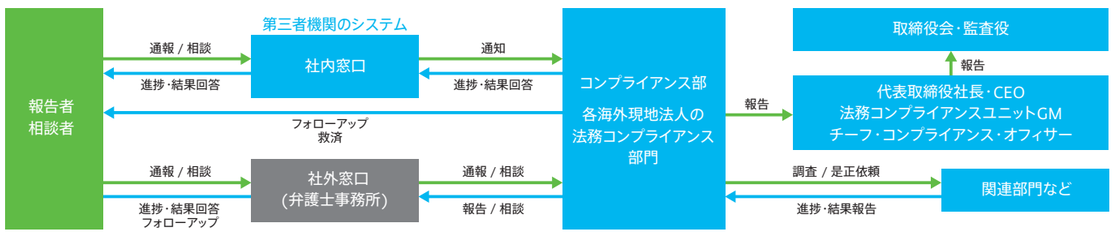
なお、当社の事業および地域社会に深刻な影響を与えるような法令違反に関する通報や事案は確認されませんでした。

※ 当局に立件、起訴された事案なし

通報・相談内容の内訳



グローバル内部通報の対応フロー



リスクマネジメント

リスクマネジメントについての考え方

当社グループでは、半導体を取り巻く地政学や市場変化などのさまざまなリスクに適切かつ迅速に対応するとともに、持続的な成長を実現すべくリスクマネジメント体制を構築し展開しています。事業を遂行する上で直面し得るリスクについて、将来を見据えて十分に検討をおこなうことにより影響を最小化するのみならず、それらを事業機会として捉え、適切に対応することが社会から信頼される企業であるために不可欠であると考えています。

リスクマネジメントの体制と実行

2024年4月には、より実効的な活動を推進するためコーポレート企画＆リスクマネジメント推進室 (CPRO) をCEO直轄の戦略部門として本社に設置し、エンタープライズ・リスクマネジメント※1のさらなる推進に努めています。

事業活動における重要リスクについては、以下のようなPDCAサイクルをグループ全体で展開しています。

1. CPROと各業務の担当所管部門が連携して事業活動におけるコンプライアンス、人事・労務、事業継続などに関するさまざまなリスクを当社グループへの影響度と蓋然性から網羅的に洗い出し、12のリスク項目を特定するとともに各リスクオーナーを設置
2. 特定した12のリスク項目については各リスクオーナーが参加するリスクマネジメント委員会において共有
3. リスクの排除は業績向上に直接つながる機会という認識のもと、CEOや各ディビジョンオフィサーが参加する四半期レビュー会議では、12のリスク項目のうち特に課題がある項目について取り組み状況の確認と改善策について討議

当社グループにおけるリスクマネジメントに関する活動については定期的に取締役会に報告し、取締役会は各リスクオーナーを中心に実行されるさまざまな取り組みについての監督をおこなっています。今後も、自律性および実効性の高いリスクマネジメントを実践していくために、グループ全体で機動的なオペレーションを展開していきます。

加えて、グループ全社を対象としたBCPの見直しや運用改善にも引き続き注力しており、緊急時における事業継続対応をおこなうための実践的な能力の向上を図るために、定期的にBCP訓練や防災訓練などを実施しています。

さらに、リスクマネジメント活動においても積極的にDXの推進をおこなっており、2023年3月期よりデジタル技術を活用したGRCツール※2を導入しています。この導入により、グループ全社におけるリスク評価やリスク対応策の可視化と各オーナー、各担当所管部門間でのグローバルで横断的な情報連携を可能にしました。

今後も、自律性および実効性の高いリスクマネジメントを実践していくために12のリスク項目に対して各オーナーが、リスクマネジメントをより強化する活動をグループ全体に展開していきます。

※1 エンタープライズ・リスクマネジメント: リスクマネジメント活動に関する全社的な仕組みやプロセス

※2 GRCツール: 企業活動に関連するGRC (Governance・Risk・Compliance) 対応を統合することで、多層化・複雑化した企業の管理機能と収集される管理情報を体系的に整理し、適時に経営の意思決定に寄与する仕組み

リスクに対する取り組み

当社はリスクマネジメントの現状を把握し、当社を取り巻く将来の潜在的・顕在的なリスクのみならず、中長期視点での新興リスクについても特定と対策の検討を開始しています。

2024年3月期においては、経営成績や財政状態、またキャッシュ・フローの状況などに重大な影響を与える可能性の観点から、これまでに認識した12項目のリスクについてのレビュー、見直しをおこない、各リスクに対する取り組みをさらに進めました。

12項目のリスク

項目	想定される主なリスク	リスクに対する主な取り組み
1 市場変動	● 半導体市場が急激に縮小した場合、過剰生産および在庫が増加 ● 急激な需要の増加に対応できない場合、お客さまに製品をタイムリーに供給できず、販売機会を損失	● 取締役会などの重要会議において市場環境や受注状況について定期的にレビューし、設備投資や人員・在庫計画などを適正化 ● 世界中のお客さまと緊密な連携を図る専門組織を設置し、お客さまのニーズや投資動向をいち早く把握することで、販売体制および顧客基盤対応力を強化
2 研究開発	● 新製品をタイムリーに投入できない場合や、お客さまのニーズに合致しなかった場合、製品競争力が低下	● Corporate Innovation本部を設置し、革新的な技術開発と各開発本部がもつ技術を融合する全社的な開発体制を構築 ● 研究機関との共同研究や、複数世代にわたる技術ロードマップを最先端顧客と共有することにより、競争力の高いnext-generation productsを競合に先行して提供
3 地政学	● 国際秩序やグローバルなマクロ経済情勢に影響を与える地政学的な対立や地域紛争が、各国・各地域の安全保障、外交政策、産業政策および環境政策に影響をおよぼし、その結果サプライチェーンの停滞やマクロ経済環境が悪化した場合、事業活動に制約が発生	● 国際情勢や各国・各地域の外交・安全保障上の措置、産業政策の動向を注視 ● 製品の輸出入や技術開発に関する規制やマクロ経済の変動による事業への影響を分析し、政策当局や業界団体、有識者などとの対話をおこないながら、対応策を事前に検討
4 調達・生産・供給	● 自然災害などにより当社の生産が停止した場合、またお取引先さまの経営状態悪化や、供給能力を上回る需要の増加、法改正や労働人口減少などにより部品調達が滞った場合や国内外の物流網が逼迫した場合、お客さまへの製品供給に遅延が発生	● 事業継続計画 (BCP) などを策定し、一例として、代替生産体制の確立、生産棟の耐震強化、生産の標準化、情報システムのバックアップ体制整備や重要部品のマルチソース化、適正在庫の確保などを実施 ● 半導体の需要予想をベースとしたフォーキャストをお取引先さまと共有するとともに、製品の安定供給体制を構築
5 安全	● 当社製品の安全性に関する問題や、重大な人身事故が発生した場合、お客さまへの損害や損害賠償が発生、また当社における安全への取り組みに対する信頼や社会的信頼が低下	● 「Safety First」の考えのもと、製品開発段階におけるリスク低減を意識した本質的な安全設計 ● 現場作業においても危険予知ミーティングなどのリスクアセスメントをおこなうことにより、潜在的なリスクを特定して未然防止策の実行と各従業員の業務に合わせた社内の資格認定と安全教育の推進、事故発生時の報告システムの整備などを全社的に実施
6 品質	● 製品不具合が発生した場合、損害賠償や対策費用が発生、また当社グループのブランドおよび信頼が低下	● 品質保証体制および最高水準のサービス体制の構築に取り組むべく、従業員およびお取引先さまへの継続的な品質教育を実施 ● 設計段階から技術的な課題を解決 ● 不具合の原因を究明し、再発防止・類似不具合の未然防止策を実施 ● お取引先さまの品質状態の把握、監査、改善支援を実施
7 環境対応	● 各国の気候変動政策や環境法令、およびお客さまのニーズに適切に対応できない場合、新規製品の開発や仕様変更などの追加対応費用が発生、製品競争力および社会的信用が低下	● ネットゼロを含む業界をリードする中長期環境目標の達成に向け、製品使用時における温室効果ガス排出量の削減、事業所における再生可能エネルギーの使用比率の向上、エネルギー使用量の削減、梱包材の見直し、モーダルシフトの推進などを実施 ● E-COMPASSの展開により、半導体デバイスの高性能化や低消費電力化に寄与する技術などを提供
8 法令・規制	● 事業を展開する各国・各地域の法令・規制に抵触した場合、社会的信用が低下、また課徴金・損害賠償や事業活動の制限が発生	● チーフ・コンプライアンス・オフィサーのもと、国内外主要拠点のコンプライアンスに関する活動状況を把握 ● 外部機関によるアセスメントを実施し、抽出された課題をCEO、取締役会、監査役会に報告の上、迅速かつ効果的な対策を実施
9 知的財産	● 独自技術の専有化ができない場合、製品競争力が低下 ● 第三者が保有する知的財産権を侵害した場合、生産・販売の制約や損害賠償が発生	● 知的財産戦略を事業戦略および研究開発戦略と三位一体で推進し、適切な知的財産権ポートフォリオを構築 ● 継続的な他社特許モニタリングを実施し、事業および研究開発部門と連携して適切な対策を講じる体制を整えることにより、他社特許侵害リスクを低減
10 情報セキュリティ	● 当社およびお取引先さまに対するサイバー攻撃、内部不正等による情報漏洩やサービス停止などが発生した場合、競争力・技術的優位性の棄損、製品生産活動を含めた業務の停止、社会的信用の低下および損害賠償が発生	● サイバーセキュリティに関するソリューションを導入し、セキュリティ監視、内部不正対策といった技術面・運用面の対策に加えて、グローバルセキュリティポリシーの策定と教育活動を通じて情報資産の適切な管理・保護を実施 ● 情報セキュリティ委員会を設置しグループ各社を含めた組織的強化を図り、内部監査と外部機関によるアセスメントなどの活動を通じて、情報セキュリティ対策の実効性を強化
11 人材	● 必要な人材を継続的に採用・維持することができない場合や、多様な価値観・専門性をもった人材が活躍できる環境を整備できない場合、製品開発力や顧客サポートの質が低下	● 労働環境の継続的な改善および多様な働き方や健康経営の推進 (経営層による方向性の共有、今後を担う人材の育成計画の構築、社員のキャリアパスの見える化、魅力的な報酬・福利厚生の提供など) ● 産官学連携の半導体人材育成やグローバルでの大学とのパートナーシップの強化
12 感染症・自然災害など、その他	● 経済環境、金融・株式市場、外国為替変動などによる影響に加え、地震や風水害などの自然災害、感染症などの発生により、当社の事業活動が停滞および世界経済が悪化	● それぞれのリスクに対して適切な対策を講じて対応するとともに、事業継続に影響をおよぼすおそれがある場合に関しては、CEOを本部長とする緊急対策本部を設置し、影響を最小限に抑えるための対策を実施

情報セキュリティ

当社では、情報セキュリティの確保を経営上の重要課題と位置づけ、お客さまやお取引先さまの情報や先端技術に関する情報を中心とした機密情報を適切に保護しています。これに加え、サプライチェーン全体の安定的な稼動を担保するべく情報セキュリティの強化に努めています。

主な活動

情報セキュリティ体制

本社および国内外のグループ各社において、情報セキュリティ担当GMと責任者、推進者を設置しています。各社内や機能ごとに議論を重ね連携を図ることで、グループ全体で共通の認識をもち、セキュリティの強化に取り組んでいます。

情報セキュリティリスク対策

2024年3月期は情報セキュリティのリスクを再定義するとともに、Security Development Goalsと名付けた当社グループ共通のフレームワークを構築し、情報セキュリティにおける中期経営計画の目標を定めました。

情報セキュリティマネジメント

各部門において毎年情報資産の洗い出しとリスクアセスメントを実施し、リスクの評価および技術的・人的・組織的・物理的なセキュリティ対策の改善活動をおこなっています。また、全役員・従業員に対して情報セキュリティ教育およびフィッシングメール訓練を定期的に実施するとともにニュースレターを配信するなど、情報セキュリティの意識向上に努めています。さらに2025年3月期からは、情報セキュリティマネジメントの国際規格であるISO/IEC 27001の取得を段階的に目指しています。

サイバーセキュリティ対策・内部不正対策

ランサムウエアなどのサイバー攻撃への防御と、産業スパイをはじめとする内部不正への対策を目的として、業界標準のサイバーセキュリティソリューションの導入をおこない、監視体制とインシデント対応体制を構築し、運用しています。2024年3月期には、ネットワークセキュリティの強化や当社の社外向けウェブサイトに対するペネトレーションテスト※1、エンドポイントセキュリティ※2ソリューションの導入、監視レベルの強化などの対策を実施しました。

製造拠点や製品におけるセキュリティ

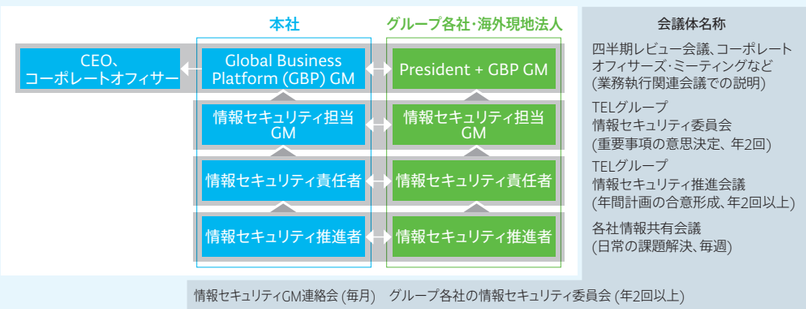
製造拠点が安全かつ安定的に稼動するよう、必要なソリューションの導入と監視などのオペレーションによる製造拠点でのセキュリティを強化しています。またお客さまに納入する製品について、SEMIが定めるサイバーセキュリティ規格であるE187/E188をはじめとする業界標準や欧州サイバーレジリエンス法などの各国の法規制を踏まえたセキュリティ対策を講じることで、お客さまの工場の安定稼動に資する製品セキュリティの確保にも取り組んでいきます。

サプライチェーンセキュリティ

お取引先さまに対してリスクアセスメントを実施し、認識された課題についてお取引先さまとともに改善に取り組むことで、サプライチェーン全体のセキュリティ改善を図っています。

社外セキュリティ団体との連携・人材の強化

2023年12月にSEMI主催で半導体業界各社の情報セキュリティ管轄部門が参画するSemiconductor Manufacturing Cybersecurity Consortiumが設立され、当社は運営委員会のメンバーに選出されるとともに各種ワーキンググループでの議論やSEMICON Japanでの講演をおこないました。今後は海外のイベントにおいても講演や会議への参加を予定しています。また、技術研修や専門の人材採用を通して情報セキュリティに関する資格保有者を増やし組織の人材の強化を図るとともに、日本シーサート協議会※3に参画し、情報セキュリティのさらなる研鑽に努めています。



※1 ペネトレーションテスト: ネットワーク、PC・サーバーやシステムの脆弱性を検証するテスト手法の1つ
※2 エンドポイントセキュリティ: インターネットや社内LAN、仮想環境下の末端に接続された端末を、サイバー攻撃から守るためのセキュリティ対策
※3 日本シーサート協議会:「一般社団法人 日本コンピュータセキュリティインシデント対応チーム協議会」のことで、チーム間の緊密な連携を図り、課題解決に貢献するための組織

外部からの評価

当社のサステナビリティへの取り組みは、世界の代表的なESG投資インデックスの投資銘柄に継続して選定されています。例えば、「Dow Jones Sustainability™ Asia/Pacific Index」「FTSE4Good Index Series※1」「MSCI ESG Leaders Indexes※1」「Euronext Vigeo World 120 Index」「STOXX Global ESG Leaders indices」などが挙げられます。昨年に引き続き「Sustainalytics' ESG Risk Ratings※2」においては「Low Risk」企業の評価を獲得しました。2024年4月には、長期的かつ持続的な企業価値向上に取り組む先進的企業として「SX銘柄※3」にも選定されました。

また「東京エレクトロン 統合報告書 2023」は、年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF) の国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」に3年連続で選定され、さらに「第3回日経統合報告書アワード」では「優秀賞」に選ばれました。

※1 使用ロゴの説明:
当社ウェブサイト「外部からの評価」 www.tel.co.jp/sustainability/review.html
※2 Copyright ©2024 Sustainalytics. All rights reserved. This article contains information developed by Sustainalytics (www.sustainalytics.com) . Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third party suppliers (Third Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.
※3 SX銘柄: 2024年に経済産業省と東京証券取引所で創設された銘柄

国際的なイニシアティブへの参画

当社は、さまざまな国際的なイニシアティブに積極的に参画し、事業活動においてサステナビリティを推進しています。

2013年に国連グローバル・コンパクト (UNGC) に署名し、UNGCが掲げる10原則に則り、「健全なグローバル化」と「持続可能な社会」の実現に貢献しています。

2015年にRBA (Responsible Business Alliance) に加盟し、お取引先さまとともに「労働」「環境」「安全衛生」「倫理」「マネジメントシステム」で構成されるRBA行動規範の遵守に取り組んでいます。

2020年に気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) の提言に賛同し※1、気候変動が事業におよぼすリスクや機会について、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の枠組みに基づく開示をおこなっています。

2023年に自然資本および生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価するための自然関連財務情報開示タスクフォース (TNFD)※2 の理念に賛同し、TNFDフォーラムに参画しています。

1978年から半導体産業のグローバルな発展を目指す国際半導体製造装置材料協会 (SEMI)※3 のメンバー企業として参加し、国際基準の制定や標準化の推進、サステナビリティの推進などに取り組んでいます。

※1 「気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) 」提言に関する取り組み P. 55-56
※2 TNFD: Taskforce on Nature-related Financial Disclosures
※3 SEMI: Semiconductor Equipment and Materials International

Chapter 4 さらなる成長に向けて

中長期的な展望

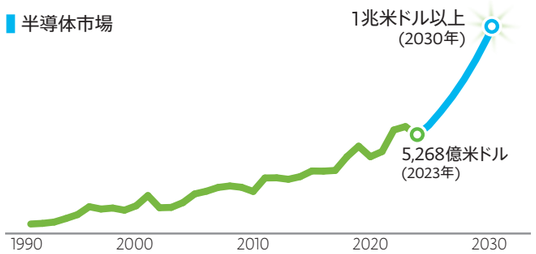
テクノロジーの進化と半導体の未来

近年、革新的な技術の実用化により社会のデジタル化がさらに加速され、情報処理を担うコンピュータ技術もさらなる進化を遂げています。インターネットを駆使したサービスやプラットフォームの拡大によるデータ通信量の増加とともに、今後はAIや自動運転、仮想現実※1など、大規模な計算を必要とするアプリケーションがテクノロジードライバーとなり、市場がさらに成長していくことが予想されます。

このような動向を中心的に支えるのは半導体です。スマートフォンやPC、データセンターのサーバー向けに使用される先端半導体の他、IoTなどデータ社会を支えるMAGIC※2向けデバイスの技術の進化と需要の拡大により、世界の半導体市場規模は、2030年には1兆米ドルを超え、半導体および製造装置を含む関連産業はこれからも力強く成長すると予想されています。

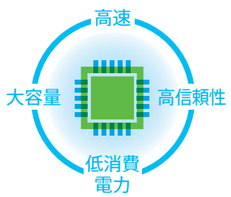
※1 VR (Virtual Reality)、AR (Augmented Reality)、MR (Mixed Reality) などを含む
※2 多様化する半導体市場への展開 P. 40

半導体市場



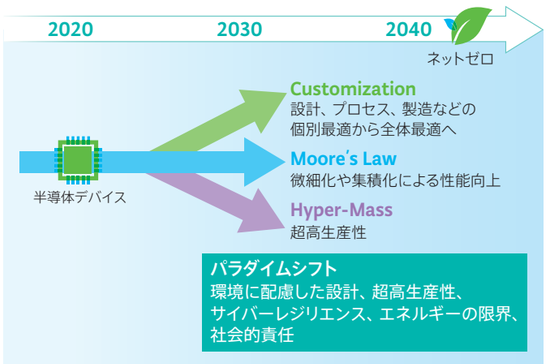
Source: 1990-2023 (WSTS)/ 2024-2030 (IBS, May 2024)

半導体業界には大きな成長ポテンシャルがある一方、課題となるのがコンピューティングにおける消費電力です。消費電力が現在のペースで指数関数的に増大し続けると、近い将来、需要が供給を上回り、世界で電力が不足する可能性があります。また、電力需要の高まりに伴い、温室効果ガスの排出量が増加することなどによる地球環境保全への影響が危惧されています。デジタル社会の発展には、半導体の高速化や大容量化、高信頼性に加え、低消費電力化が不可欠です。



人々の生活を支える半導体は今後より多様な形で進化していくと考えられます。半導体の性能はこれまでも微細化や集積化によって向上してきましたが、大量のデータを高速かつ低消費電力で処理できるコンピュータ技術の実現のため、さらなる性能向上に対する要求が高まっています (Moore's Law)。またアプリケーションやサービスの多様化に伴い、半導体の設計や製造技術およびシステム全体を用途に応じて最適化していくことが求められています (Customization)。さらに大容量のデータ通信やそれらの処理・解析には膨大な量の半導体が必要となり、コンピュータ技術の恩恵を誰もが享受できる世界を実現するためには規模の経済による半導体の低コスト化が必要です (Hyper-Mass)。

また中期的には市場においてさまざまなパラダイムシフトが予想されますが、半導体製造装置メーカーにとっては、微細化や集積化における技術およびコスト面での課題を解決すること、お客さまの多様な要望に対してそれぞれに最良のソリューションを迅速に提案すること、そして極めて高い生産性と環境負荷の最適化を実現する製造方法を提供することが、これからの価値創造における鍵となっていきます。



半導体製造装置の発展

1兆米ドルの時代やさらにその先に向けて、半導体製造においては、デバイス構造や集積化技術の高度化、開発・生産にかかるコストや時間、人材不足、工程数の増加への対応などの課題を解決してく必要があります。このような状況において装置メーカーにとってはAIやデジタル技術を駆使したデジタルトランスフォーメーション (DX) によるソリューションの提供が重要であると考えられます。

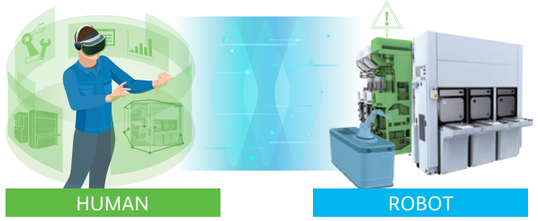
今後は、装置の開発において、さまざまなシミュレーションを統合し、サイバー空間にデジタルの試作品をつくるデジタルツインが鍵になります。現在は、実機試作によるトライ＆エラーを繰り返すやり方が主流であり、多くのリソースや労力が必要ですが、実機ではなくデジタルツインを用いた試作により、最適な設計をより早く、少ない労力でおこなうことができます。

また、デバイスの量産に使われる装置におけるキーワードは「自律化」です。オペレーターによる管理のもと、各装置は温度や圧力から加工状況まで、あらゆるデータをセンシングし、AIによる分析をおこないます。プロセス条件が変動した場合は、自律的に最適な条件に戻すなど、プロセス品質を保つための調整が完全に自動化されます。

加えて、保守・管理においては、エンジニアが現地に到達するまでのタイムラグが課題であり、これを解決するのが遠隔オペレーションです。装置の不具合時にARグラスなどを通して状況を視認し、身振りで操作することにより、現場のロボットがそれに同期して修理・調整・パーツ交換作業を実施します。トラブル対応は仮想空間を通じておこなえるようになり、場所や時間を問わずにタイムリーな対応が可能となります。

デジタルツイン

遠隔オペレーション

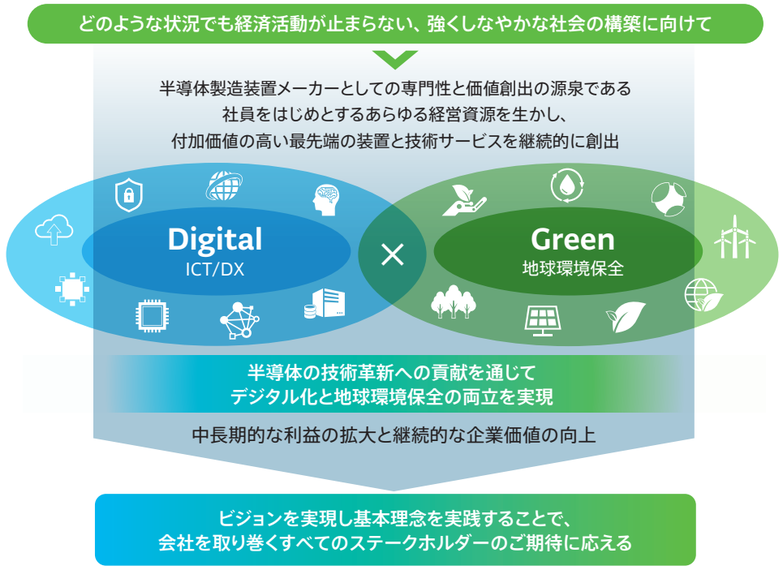


夢と活力のある会社を目指して

どのような状況でも経済活動が止まらない、強くしなやかな社会の構築に向けて、世界は今後もICT (情報通信技術) を強力に実装するとともに、脱炭素化の実現に取り組んでいきます。

東京エレクトロンは、半導体製造装置メーカーとしての専門性と価値創出の源泉である社員をはじめとするあらゆる経営資源を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出します。そして社会における役割と責任を確実に果たすべく、半導体の技術革新への貢献を通じてデジタル化と地球環境保全の実現に寄与します。

中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上に努め、ビジョンの実現による基本理念の実践につなげ、当社を取り巻くすべてのステークホルダーのご期待に応えていきます。



財務概況

経営成績

2024年3月期の世界経済については、コロナ禍以降急騰していた資源・エネルギー価格は前期途中から下落し、それに伴って物価の上昇率は、当年度末には、主要国の中央銀行が中長期的な目標の目安としている2%程度まで低下しました。また、欧米諸国を中心とした政策金利の引き上げは若干緩和しましたが、円安水準は継続する状況にありました。

当社グループが参画しているエレクトロニクス産業においては、PCやスマートフォンなどの最終製品の需要が一巡したことに伴い、前期後半から半導体メーカーにおける生産の抑制がおこなわれました。その結果、在庫の調整が進捗し、2024年3月期において、半導体の需給バランスは徐々に改善しています。

このような状況のもと、調整局面を迎えていた半導体製造装置向け設備投資も底打ちの兆候が見られました。メモリおよび先端ロジック/ファウンドリ向け半導体に対する設備投資は、まだ全体的に抑制傾向にあったものの、生成AI用途のアドバンスドパッケージ向け設備の引き合いが増加しました。また、半導体の自給率向上に向けた中国におけるIoTおよび車載や産業用の成熟世代向け設備投資は、前期に引き続き堅調に推移しました。情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、電子機器を支える半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっており、中長期的に半導体製造装置市場はさらなる成長が見込まれています。

2024年3月期の経営成績の状況は以下のとおりとなりました。

2024年3月期の売上高は1兆8,305億円 (前期比17.1%減) となりました。国内売上高が1,849億円(前期比22.9%減)、海外売上高が1兆6,455億円 (前期比16.4%減) となり、連結売上高に占める海外売上高の比率については89.9%となりました。

売上原価は1兆2億円 (前期比18.3%減)、売上総利益は8,302億円 (前期比15.7%減) となり、売上総利益率は45.4% (前期比0.8ポイント増) となりました。

販売費及び一般管理費は3,740億円 (前期比2.0%増) となり、連結売上高に対する比率は20.5% (前期比3.9ポイント増) となりました。

これらの結果、営業利益は4,562億円 (前期比26.1%減) となり、営業利益率は24.9% (前期比3.1ポイント減) となりました。

税金等調整前当期純利益は4,734億円 (前期比24.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は3,639億円 (前期比22.8%減) となりました。

この結果、1株当たり当期純利益は783円75銭 (前期の1株当たり当期純利益は1,007円82銭) となりました。

なお、2024年3月期から、報告セグメントを「半導体製造装置」の単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載を省略しています。

財政状態

2024年3月期末の財政状態の状況は以下のとおりとなりました。

2024年3月期末の流動資産は、前期末に比べ405億円減少し、1兆7,004億円となりました。主な内容は、未収消費税等の減少878億円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少734億円、棚卸資産の増加1,107億円によるものです。

有形固定資産は、前期末から782億円増加し、3,373億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から1,070億円増加し、4,186億円となりました。

これらの結果、総資産は、前期末から1,448億円増加し、2兆4,564億円となりました。

流動負債は、前期末に比べ179億円減少し、6,118億円となりました。主として、支払手形及び買掛金の減少239億円、未払法人税等の増加88億円によるものです。

固定負債は、前期末に比べ22億円増加し、843億円となりました。

純資産は、前期末に比べ1,606億円増加し、1兆7,601億円となりました。主として、親会社株主に帰属する当期純利益3,639億円を計上したことによる増加、前期の期末配当および2024年3月期の中間配当2,024億円の実施による減少によるものです。この結果、自己資本比率は71.1%となりました。

キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の2024年3月期末残高は、前期末に比べ108億円減少し、4,616億円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資109億円を加えた残高は、前期末に比べ5億円減少し、4,725億円となりました。2024年3月期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローについては、前期に比べ84億円増加の4,347億円の収入となりました。主な要因については、税金等調整前当期純利益4,734億円、未収消費税等の減少880億円、売上債権及び契約資産の減少848億円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,189億円、棚卸資産の増加977億円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、主として有形固定資産の取得による支出1,169億円により、前期の417億円の支出に対し1,251億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払2,024億円、自己株式の取得による支出1,200億円により、前期の2,565億円の支出に対し3,250億円の支出となりました。

生産、受注および販売の実績

当社グループは、市場の変化に柔軟に対応して生産活動をおこなっており、生産の実績は販売の実績と傾向が類似しているため、記載を省略しています。受注の実績については、短期の受注動向が顧客の投資動向により大きく変動する傾向にあり、中長期の会社業績を予測するための指標として必ずしも適切ではないため、記載していません。

なお、主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。

2023年3月期 (自　2022年4月1日　至　2023年3月31日)

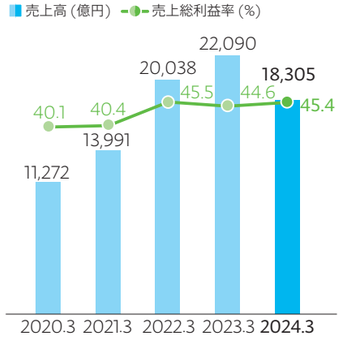
相手先	販売高 (百万円)	割合 (%)
Intel Corporation	357,636	16.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	320,427	14.5
Samsung Electronics Co., Ltd.	275,916	12.5

2024年3月期 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)

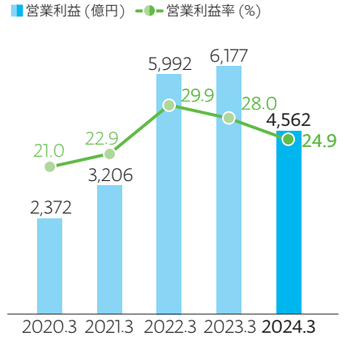
相手先	販売高 (百万円)	割合 (%)
Samsung Electronics Co., Ltd.	237,441	13.0

※ 販売高には、当該顧客と同一の企業集団に属する顧客に対する販売高を含めています

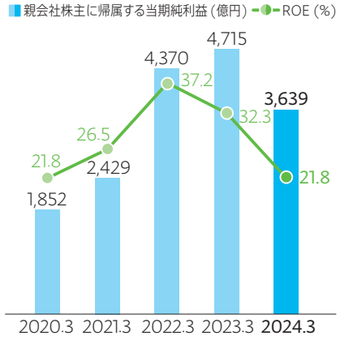
売上高および売上総利益率



営業利益および営業利益率



親会社株主に帰属する当期純利益およびROE



財政状態

(百万円)

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
流動資産	¥962,484	¥1,015,696	¥1,408,703	¥1,740,959	¥1,700,451
有形固定資産	175,580	196,967	223,078	259,088	337,366
投資その他資産	140,431	212,699	262,676	311,545	418,644
総資産	1,278,495	1,425,364	1,894,457	2,311,594	2,456,462
流動負債	382,578	327,661	468,578	629,893	611,899
負債合計	448,802	400,801	547,408	712,069	696,282
純資産	829,692	1,024,562	1,347,048	1,599,524	1,760,180

キャッシュ・フロー

(百万円)

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥253,117	¥145,888	¥283,387	¥426,270	¥434,720
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,951	△18,274	△55,632	△41,756	△125,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	△250,374	△114,525	△167,256	△256,534	△325,012
現金及び現金同等物期末残高	247,959	265,993	335,648	472,471	461,608

経営成績の状況に関する認識および分析・検討内容

当社グループの2024年3月期の経営成績については、連結売上高は1兆8,305億円（前期比17.1%減）、営業利益は4,562億円（前期比26.1%減）と、前期から減収減益となりました。これは主に、コロナ禍においてPCやスマートフォンなどの最終製品の需要が急激に拡大したことに伴い、半導体メーカーによる積極的な半導体製造装置向け設備投資が短期間に集中した結果、需給が緩み、前期後半から2024年3月期前半にかけて、投資の調整と生産の抑制がおこなわれたことによるものです。しかしながら、半導体メーカーによる在庫調整の順調な進捗と生成AIなどの新たなアプリケーションの出現に加え、半導体の自給率向上に向けた中国地場の顧客による設備投資の加速によって、半導体製造装置市場は底打ちし、2024年3月期後半から回復基調に転じました。

営業利益率は、前期比3.1ポイント減の24.9%となりました。これは主に、翌期以降の市場回復期において、シェアを拡大できるように、2024年3月期においては売上高が減少したにも関わらず、研究開発投資を増額したことに起因しています。現在の中期経営計画で目標としている財務モデルの達成に向けて、また将来のさらなる成長を目指して、研究開発費の総額は、前期から116億円増加（前期比6.1%増）し、過去最高の2,028億円となりました。なお、インフレによる部材や資源価格の高騰はありましたが、付加価値の高い製品を投入することで価格を適正化し、売上総利益率は、前期比0.8ポイント増の45.4%となりました。

営業利益に、営業外損益および特別損益を反映し、税金費用を差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は3,639億円となり、売上高に対する比率は、前期から1.4ポイント下降し、19.9%となりました。なお、2024年3月期に計上している特別利益108億円は、主に米国テキサス州オースチン市の固定資産（土地および建物など）の売却によるものです。これらの結果、1株当たり当期純利益は、783円75銭となりました。

経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標などについては、当社グループでは売上高、営業利益率、ROE（自己資本利益率）を中期経営計画上の財務モデルにおける指標として使用しています。

財政状態およびキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容、ならびに資本の財源および資金の流動性にかかる情報

財政状態については、2024年3月期末における総資産が2兆4,564億円となり、前期末から1,448億円増加しました。これは主に、棚卸資産、有形固定資産と、投資その他の資産に含まれる投資有価証券の増加によるものです。なお、現金及び現金同等物の2024年3月末残高は、前期末から108億円減少し、4,616億円となりました。

流動資産は、前期末に比べ405億円減少し、1兆7,004億円となりました。これは主に、未収消費税等の減少878億円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少734億円、棚卸資産の増加1,107億円によるものです。棚卸資産は、翌期以降の市場回復やコスト、サプライチェーンのサステナビリティなどを考慮し、部材調達の平準化などの施策を実行した結果、前期末から1,107億円増加し、7,629億円となりました。有形固定資産は、最先端技術の研究開発に必要となる装置や測定器の取得、国内、韓国および台湾におけるオペレーションの強化を目的とした各事業所の新設・改修に加え、竣工した山梨県韮崎市の開発棟、建設中である熊本県合志市の開発棟や宮城県大和町の開発棟、岩手県奥州市の物流センターなどを反映し、前期末から782億円増加し、3,373億円となりました。投資有価証券は、政策的に保有している上場株式の時価評価額が上昇したことにより、前期末から1,121億円増加し2,777億円となりました。なお、総資産回転日数※は前期の347日から475日へ増加しました。

流動負債は、前期末に比べ179億円減少し、6,118億円となりました。これは主に、原材料の購入量減少に伴う支払手形及び買掛金の減少239億円に起因しております。固定負債は、前期末に比べ22億円増加し、843億円となりました。

純資産は、前期末に比べ1,606億円増加し、1兆7,601億円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益3,639億円を計上したことによる増加、投資有価証券の評価額および為替変動に伴う為替換算調整勘定の増加によるその他の包括利益累計額の増加1,143億円に加え、前期の期末配当および2024年3月期の中間配当2,024億円の実施による減少、自己株式の取得1,200億円に起因しております。この結果、自己資本比率は71.1%となりました。

キャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物に、満期日または償還日までの期間が3カ月を超える定期預金および短期投資を加えた残高は、前期末から5億円減少し、4,725億円となりました。これは主に、市場の調整期においても、前述のとおり、2024年3月期における営業利益率は、24.9%と高い水準を維持し、親会社株主に帰属する当期純利益は3,639億円となる一方で、連結配当性向50%の株主還元政策に基づく配当金の支払いに加え、自己株式の取得のための支出をおこない、同時に翌期以降の市場回復を見据えた調達戦略と成長投資を実行したことによるものです。

営業活動によるキャッシュ・フローについては、前期に比べ84億円増加の4,347億円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4,734億円、未収消費税等の減少880億円、売上債権及び契約資産の減少848億円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,189億円、棚卸資産の増加977億円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローについては、主として有形固定資産の取得による支出1,169億円により、前期の417億円の支出に対し1,251億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについては、主に配当金の支払2,024億円、自己株式の取得による支出1,200億円により、前期の2,565億円の支出に対し、3,250億円の支出となりました。

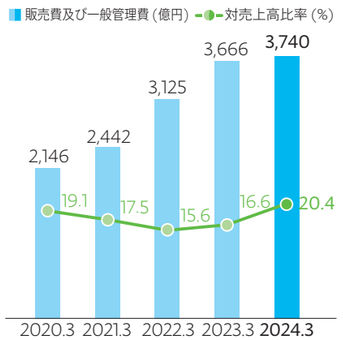
2024年3月期においては、部材調達の平準化などの戦略的な施策の実行に伴い、前期に過去最高となった棚卸資産の水準をさらに上回るなど、必要な運転資本が増加する中、高まる技術要求に対応し、競合との差別化を図ることができる革新的で付加価値の高い技術の創出のための研究開発、生産技術革新や環境負荷低減を考慮したサプライヤーとの協業などへの成長投資を継続しました。一方で、当社グループの株主還元政策である連結配当性向50%に基づく配当金の支払いと自己株式の取得によって、計3,224億円を株主に還元しました。これらは、事業運営を通じて獲得した手元資金によって賄っています。引き続き、高利益率によってつくり上げた強固な財務基盤を維持しながら、将来への成長投資と積極的な株主還元に取り組んでいきます。

なお、経営指標の1つであるROE（自己資本利益率）については、21.8%となりました。

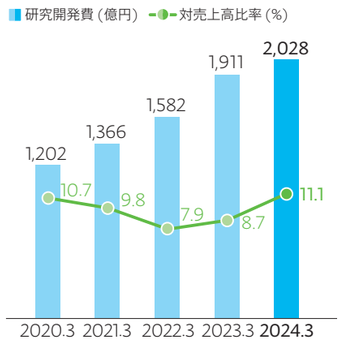
※ 総資産回転日数＝2024年3月期期首・期末の総資産の平均÷2024年3月期の売上高×365

財務データの詳細につきましては、当社ウェブサイトの「有価証券報告書」をご参照ください
www.tel.co.jp/ir/library/fs/

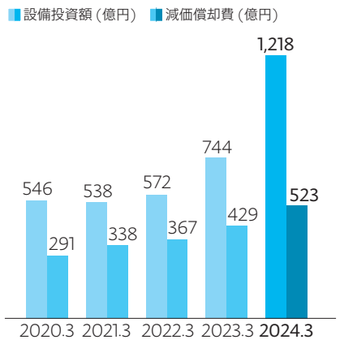
販売費及び一般管理費および対売上高比率



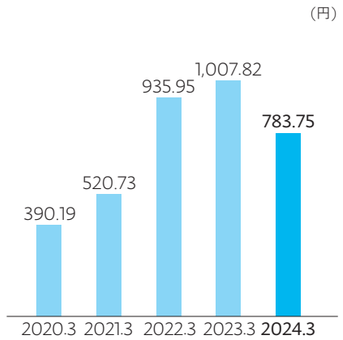
研究開発費および対売上高比率



設備投資額および減価償却費



1株当たり当期純利益



（注）
当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。2020年3月期から当該株式分割がおこなわれたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しています

11年間の主要財務データ

東京エレクトロン株式会社および連結子会社
2014年3月期から2024年3月期

2016年3月期以前まで四捨五入にて表示しております百万円、千円および千米ドル単位未満の金額ならびに千株未満の株数は、2017年3月期より切り捨てで表示しています。
このため、2017年3月期以降においては、合計値が各項目に表示された数値の合計と一致しない場合があります。

	（千米ドル）												（百万円）
	2024.3	2024.3	2023.3	2022.3※6		2021.3	2020.3	2019.3※5	2018.3	2017.3	2016.3	2015.3	2014.3
売上高※1	$12,089,870	¥1,830,527	¥2,209,025	¥2,003,805		¥1,399,102	¥1,127,286	¥1,278,240	¥1,130,728	¥799,719	¥663,949	¥613,125	¥612,170
半導体製造装置	—	—	2,155,206	1,943,843		1,315,200	1,060,997	1,166,781	1,055,234	749,893	613,033	576,242	478,842
FPD製造装置	—	—	53,674	59,830		83,772	66,092	111,261	75,068	49,387	44,687	32,710	28,317
PV製造装置	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	3,618	3,806
電子部品・情報通信機器	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	100,726
その他	—	—	144	131		129	197	197	425	438	6,229	555	479
営業利益	3,013,430	456,263	617,723	599,271		320,685	237,292	310,571	281,172	155,697	116,789	88,113	32,205
税金等調整前当期純利益	3,126,868	473,439	624,856	596,698		317,038	244,626	321,508	275,242	149,116	106,467	86,828	(11,756)
親会社株主に帰属する当期純利益	2,403,828	363,963	471,584	437,076		242,941	185,206	248,228	204,371	115,208	77,892	71,888	(19,409)
包括利益	3,158,846	478,281	501,421	486,183		305,801	187,084	242,696	206,152	119,998	60,984	80,295	(10,889)
国内売上高	1,221,734	184,982	239,937	230,368		197,566	161,812	208,796	148,760	101,122	121,808	95,046	161,631
海外売上高	10,868,136	1,645,544	1,969,088	1,773,437		1,201,535	965,474	1,069,443	981,967	698,597	542,141	518,079	450,539
減価償却費※2	345,682	52,339	42,927	36,727		33,843	29,107	24,323	20,619	17,872	19,257	20,878	24,888
設備投資額※3	804,709	121,841	74,432	57,288		53,868	54,666	49,754	45,603	20,697	13,341	13,184	12,799
研究開発費	1,339,893	202,873	191,196	158,256		136,648	120,268	113,980	97,103	83,800	76,287	71,350	78,664
総資産	16,223,915	2,456,462	2,311,594	1,894,457		1,425,364	1,278,495	1,257,627	1,202,796	957,447	793,368	876,154	828,592
純資産	11,625,259	1,760,180	1,599,524	1,347,048		1,024,562	829,692	888,117	771,509	645,999	564,239	641,163	590,614
従業員数（人）		17,702	17,204	15,634		14,479	13,837	12,742	11,946	11,241	10,629	10,844	12,304
	（米ドル）												（円）
1株当たり当期純利益:													
1株当たり当期純利益※7	$5.18	¥783.75	¥1,007.82	¥935.95		¥520.73	¥390.19	¥504.53	¥415.16	¥234.09	¥153.70	¥133.69	(¥36.10)
潜在株式調整後1株当たり当期純利益※4 ※7	5.16	781.20	1,003.86	931.30		517.76	388.01	502.41	413.74	233.45	153.33	133.38	—
1株当たり純資産額※7	24.92	3,773.11	3,389.68	2,857.48		2,170.73	1,755.99	1,790.59	1,558.16	1,306.50	1,142.79	1,189.08	1,075.31
1株当たり配当額※7	2.60	393.00	1,711.00	1,403.00		781.00	588.00	758.00	624.00	352.00	237.00	143.00	50.00
発行済株式総数（単位：千株）※7		471,632	157,210	157,210		157,210	157,210	165,210	165,210	165,210	165,211	180,611	180,611
株主総数（人）		48,167	51,723	34,258		29,547	30,348	50,843	35,186	21,937	24,664	20,829	30,563
													(%)
ROE（自己資本利益率）		21.8	32.3	37.2		26.5	21.8	30.1	29.0	19.1	13.0	11.8	(3.3)
営業利益率		24.9	28.0	29.9		22.9	21.0	24.3	24.9	19.5	17.6	14.4	5.3
自己資本比率		71.1	68.7	70.5		71.1	64.1	70.0	63.8	67.2	70.9	73.0	69.8
総資産回転率（回）		0.77	1.05	1.21		1.03	0.89	1.04	1.05	0.91	0.80	0.72	0.76
	（米ドル）												（千円）
従業員1人当たり売上高	$682,966	¥103,407	¥128,401	¥128,169		¥96,629	¥81,468	¥100,317	¥94,653	¥71,143	¥62,466	¥56,540	¥49,754

※1 2015年3月期より、連結子会社であった東京エレクトロンデバイス（株）が持分法適用会社へ異動したため、電子部品・情報通信機器をのぞいています。2016年3月期からは、PV製造装置は、その他に含まれています。2024年3月期からFPD製造装置は、その他に含まれています
※2 のれん償却額および減損損失は含まれていません
※3 設備投資額は、有形固定資産の増加分を示しています
※4 2014年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であるため、記載していません
※5「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を2019年3月期の期首から適用しています
※6「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）などを2022年3月期の期首から適用しています。2022年3月期以降にかかる主要財務データについては、当該会計基準などを適用した後の財務データとなっています
※7 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。2014年3月期の期首に当該株式分割がおこなわれたと仮定し、1株当たり当期純利益、潜在株式調整後1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しています。なお、2014年3月期から2023年3月期の1株当たり配当額、発行済株式総数については、当該株式分割前の配当金の額および株式数を記載しています

サステナビリティデータ

Environment: 環境

東京エレクトロン株式会社および連結子会社

2020年3月期から2024年3月期

※ ●を付したデータにつきましては、「東京エレクトロン サステナビリティデータ2024」において第三者保証を受けています
www.tel.co.jp/sustainability/data/index.html

※ 合計については四捨五入の関係で一致していないことがあります

温室効果ガス排出量

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3	
スコープ1 排出量	スコープ1排出量 (千t-CO_2)	28	29	16	22	21	
	日本-エネルギー起源※1	10	10	10	10	10	●
	海外-エネルギー起源※1	2	2	2	2	2	
	エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量合計※2 (千t-CO_2e)	16	17	4	10	9	
	エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量 (千t-CO_2e) (日本)	16	17	4	10	9	
	日本-HFC類	0.2	0.1	0.7	3.4	2.3	
	日本-PFC類	10.6	13.2	1.3	5.6	4.8	
	日本-SF_6	5.0	3.1	1.4	1.2	1.1	
	日本-その他	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	
	エネルギー起源以外の温室効果ガス排出量 (千t-CO_2e) (海外)	—	—	0.1	0.0	0.0	
	海外-HFC類	—	—	0.0	0.0	0.0	
	海外-PFC類	—	—	0.0	0.0	0.0	
	海外-SF_6	—	—	0.0	0.0	0.0	
	海外-その他	—	—	0.1	0.0	0.0	
スコープ2※3 排出量	スコープ2排出量 (マーケット基準) (千t-CO_2)	144	157	74	20	22	
	日本	118	128	55	0	0※4	●
	海外	26	29	19	20	22	
	スコープ2排出量 (ロケーション基準) (千t-CO_2)	156	169	168	180	192	
	日本	129	138	136	144	155	
	海外	26	31	33	36	37	
スコープ3※5 排出量	スコープ3排出量 (千t-CO_2)	7,910	9,386	13,238	14,335	11,829	
	カテゴリ1 購入した物品・サービス	1,796	2,395	3,332	4,053	3,239	
	カテゴリ2 資本財	164	162	172	224	366	
	カテゴリ3 燃料、エネルギー関連の活動	23	25	27	29※6	31	
	カテゴリ4 上流の輸送・流通	9	9	15	19	12	
	カテゴリ5 事業から発生する廃棄物	2	2	3	3	3	
	カテゴリ6 出張	2	1	4	14	27	
	カテゴリ7 従業員の通勤	12	11	12	14	15	
	カテゴリ9 下流の輸送・流通	90	80	121	120	65	
	カテゴリ11 販売された製品の使用	5,808	6,696	9,548※6	9,854	8,068	
	カテゴリ12 販売された製品の廃棄後の処理	3	3	4	5	4	
スコープ1、2 (マーケット基準) 排出量合計	スコープ1、2 (マーケット基準) 排出量 (千t-CO_2)	171	186	90	42	43	
スコープ1、2 (マーケット基準)、3 排出量合計	スコープ1、2 (マーケット基準)、3排出量 (千t-CO_2)	8,081	9,572	13,328	14,377	11,872	

※1 スコープ 1: 自社が所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出。算定方法: 排出量＝Σ (燃料使用量×CO_2排出係数)。排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数

※2 スコープ 1: 非エネルギー起源CO_2およびCO_2以外の温室効果ガス。算定方法: 排出量＝Σ (使用量×単位使用量当たりの排出量－回収・適正処理量) ×地球温暖化係数
地球温暖化係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地球温暖化係数。2022年3月期より回収・適正処理量の数値を見直しました

※3 スコープ2: 自社が購入した電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出。算定方法: 排出量＝Σ (購入電力量×CO_2排出係数)。日本の排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別の調整後排出係数。日本以外の排出係数は、国際エネルギー機関 (IEA) 発行のEmissions Factors 2019 editionを使用

※4 非化石証書「相当分」控除後の数値。非化石証書相当分控除前のスコープ2排出量8千t-CO_2、非化石証書相当分8千t-CO_2

※5 スコープ3: スコープ1、2を除く製品輸送、社員の業務上の移動、アウトソーシングした主な生産工程など企業のバリューチェーンからの排出。全体が15 のカテゴリに分類されているうち「カテゴリ1·2·3·4·5·6·7·9·11·12」を算出。自社の活動に含まれないもしくは他カテゴリで計上した「カテゴリ8·10·13·14·15」を除外

※6 数値を見直しました

水関連

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3	
水	取水量 (千m^3)	1,305	1,397	1,417	1,495	1,542	
	日本	1,098	1,183	1,204	1,255	1,293	●
	地下水	390	430	440	402	373	
	上水	411	450	479	520	569	
	工業水	297	303	285	333	350	
	海外	207	214	213	240	249	
	水消費量 (千m^3)	227	202	223	223	221	
	日本	198	177	195	193	196	
	海外	29	25	28	30	24	
	排水量 (千m^3)	1,078	1,195	1,194	1,272	1,321	
	日本	900	1,006	1,009	1,062	1,096	
	海外	178	189	185	210	225	

エネルギー使用量・発電量

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3	
エネルギー	使用量 原単位 (売上) (kL / 億円)	7.5	6.8	5.0	4.8	5.6	
	使用量 (原油換算) (kL) ※1	85,074	94,746	100,265	106,637	102,260	
	日本※2	70,642	78,126	82,703	87,137	82,999	●
	海外	14,432	16,620	17,562	19,499	19,261	
電力	使用量 (MWh)	320,193	357,744	380,127	404,964	435,514	
	日本※3	267,872	297,435	316,017	333,572	353,428	●
	海外	52,321	60,309	64,110	71,392	82,086	
ガス (都市ガス、LPG)	使用量 (原油換算) (kL) ※1	3,565	3,820	3,796	3,898	3,800	
	日本	2,611	2,728	2,738	2,776	2,850	●
	海外	954	1,092	1,058	1,122	951	
燃料 (A重油、軽油、灯油、ガソリン)	使用量 (原油換算) (kL) ※1	1,624	1,667	1,625	1,526	1,747	
	日本	1,603	1,651	1,612	1,513	1,735	●
	海外	21	16	13	13	12	
再生可能エネルギー (電力)	購入量 (MWh)	3,334	4,980	227,523	365,876	393,383	
	日本	0	0	197,137	330,791	353,428	
	海外	3,334	4,980	30,386	35,085	39,955	
太陽光発電システム	発電量 (MWh)	3,804	4,068	3,890	4,110	3,901	
	日本	3,804	4,068	3,890	4,110	3,901	
	海外	0	0	0	0	0	
オンサイト太陽光発電システムによる自家消費量	自家消費量 (MWh)	2,579	2,783	2,695	2,780	2,837	
	日本	2,579	2,783	2,695	2,780	2,837	
	海外	0	0	0	0	0	
販売した電力	電力販売量 (MWh) ※4	1,225	1,285	1,195	1,330	1,063	
	日本	1,225	1,285	1,195	1,330	1,063	
	海外	0	0	0	0	0	
再生可能エネルギー (電力) 使用割合	電力使用割合 (%)	2	2	60	91	90	
	日本	1	1	63	100	100	
	海外	6	8	47	49	49	

※1「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の燃料、ガスおよび電気の換算係数を使用して算出

※2 省エネ法の改正 (2023年4月1日施行) により2024年3月期分より換算係数が改正されたため、エネルギー使用量にオンサイト太陽光発電システムによる自家消費量を含みます

※3 2024年3月期より過去に遡り、電力使用量にオンサイト太陽光発電システムによる自家消費量を含みます

※4 熱、蒸気は販売していません

物流に関わる環境負荷

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
CO_2	排出量 (千t-CO_2)	99	89	136	139	76
	日本	9	9	15	19	12
	海外	90	80	121	120	64
海運利用率 (海外向け) (%)		31.9	34.3	33.2	39.0	42.1
強化ダンボールの使用	木材使用量の削減 (t) (日本)	—	—	—	2,000	1,915

廃棄物排出量

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
廃棄物	排出量 (t)	13,989	14,997	14,459	18,249	19,714
	日本	12,973	13,705	12,921	17,047	18,527
	海外	1,016	1,292	1,538	1,202	1,187
リサイクル	再資源化量 (t)	13,748	14,814	14,189	17,978	19,480
	日本	12,831	13,587	12,789	16,912	18,376
	海外	917	1,227	1,400	1,066	1,103
単純焼却・埋立処分	処分量 (t)	241	183	270	271	234
	日本	142	118	132	135	151
	海外	99	65	138	136	84
危険・有害な廃棄物	排出量 (t)	6,228	7,227	5,231	5,634	7,743
	日本 (特別管理産業廃棄物)	5,911	6,718	4,705	5,239	7,448 ●
	海外 (国別に定める危険・有害な廃棄物)	317	509	526	395	296
危険・有害な廃棄物 リサイクル	再資源化量 (t)	6,228	7,226	5,193	5,596	7,703
	日本	5,911	6,718	4,705	5,239	7,448
	海外	317	508	488	357	256
危険・有害な廃棄物 単純焼却・埋立処分	処分量 (t)	0	1	38	38	40
	日本	0	0	0	0	0
	海外	0	1	38	38	40

化学物質使用・排出量 (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
PRTR法第一種指定化学物質※1	取り扱い量 (t)	121	144	119	104	61
	塩化第二鉄	98	106	85	76	—
	ふっ化水素およびその水溶性塩	12	24	22	16	47
	メチルナフタレン	10	13	11	10	11
	テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド	—	—	—	—	2
	VOC※2類	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	その他	1	1	1	1	1
	移動量 (廃棄物量) (t)	111	131	108	94	48
	移動量 (下水道) (t)	0	0	0	0	2
	消費量 (t)	10	13	11	10	11
NOx	排出量 (t)	11.9	13.0	13.1	12.7	12.9
SOx	排出量 (t)	4.0	4.9	4.8	4.5	4.6

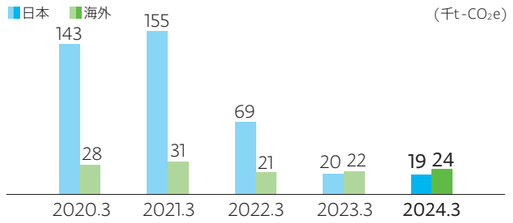
※1 2024年3月期より対象物質の見直しによる追加、対象外物質があります
※2 VOC: Volatile Organic Compounds。揮発性有機化合物

その他

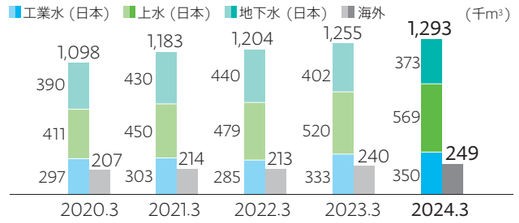
		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
ISO 14001	認証取得事業所数	9	11	11	11	11
	日本	5	5	5	5	5
	海外	4	6	6	6	6
環境投資	環境投資の効果 (百万円)	82	32	30	31	16
	環境投資の効果 (t-CO_2)	1,043	455	973	799	334
生物多様性	生態観察会回数※	18	18	16	22	20
	生態観察会参加人数※	368	52	87	138	289
環境法規制	環境法令違反数	0	0	0	0	0
	法令違反に対する罰金額	0	0	0	0	0
製品総出荷量 (t)※		31,184	28,862	41,352	48,922	35,769
コピー用紙※	使用量 (t)	132	38	32	138	88

※ 対象: 日本

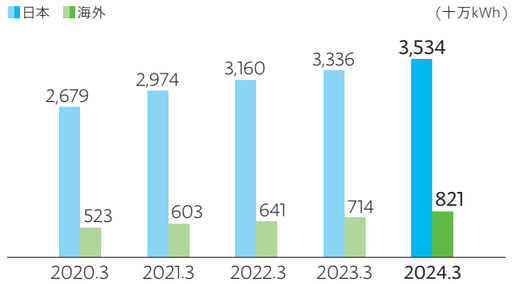
スコープ1排出量とスコープ2排出量(マーケット基準)の合計の推移



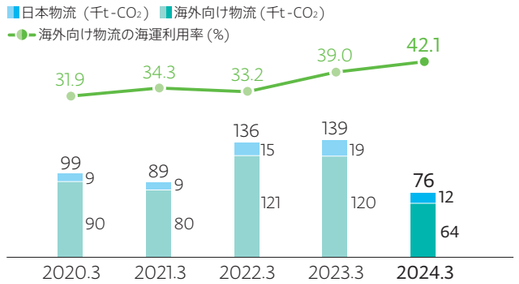
水使用量の推移



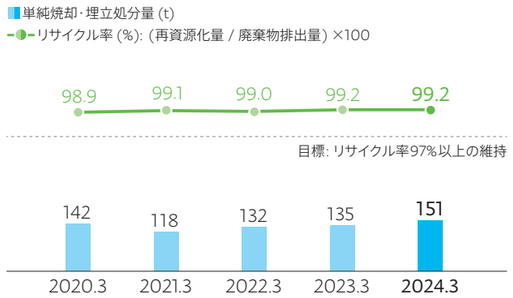
電力使用量の推移



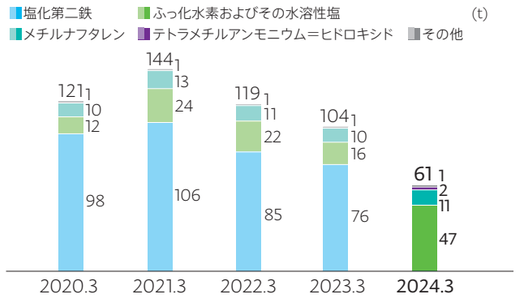
物流におけるCO₂排出量と海運利用率の推移



リサイクル率と単純焼却・埋立処分量の推移 (日本)



PRTR法第一種指定化学物質取り扱い量の推移 (日本)



Social: 社会

東京エレクトロン株式会社および連結子会社
2020年3月期から2024年3月期
※ ●を付したデータにつきましては、「東京エレクトロン サステナビリティデータ2024」において第三者保証を受けています
www.tel.co.jp/sustainability/data/index.html

従業員数 (グループ全体)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
	正規従業員数	13,542	14,022	15,140	16,605	17,071
正規従業員 (地域別)	日本	7,806	7,921	8,234	8,796	9,150
	その他アジア	3,494	3,796	4,328	4,819	4,854
	欧州・中東	528	509	578	669	708
	北米	1,714	1,796	2,000	2,321	2,359

従業員構成 (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
従業員 (雇用形態別)	従業員数	8,100	8,296	8,661	9,325	9,746
	正規従業員	7,806	7,921	8,234	8,796	9,150
	男性	6,681	6,722	6,944	7,429	7,716
	女性	1,125	1,199	1,290	1,367	1,434
	非正規従業員	294	375	427	529	596
	男性	263	348	403	490	553
	女性	31	27	24	39	43

採用・雇用 (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
新卒採用	採用数	281	253	209	231	353
	30歳未満	280	252	208	231	351
	男性	233	207	177	193	304
	女性	47	45	31	38	47
	30歳以上50歳未満	1	1	1	0	2
	男性	1	1	0	0	2
	女性	0	0	1	0	0
	50歳以上	0	0	0	0	0
	男性	0	0	0	0	0
	女性	0	0	0	0	0
	女性比率	16.7	17.8	15.3	16.5	13.3
キャリア採用	採用数	150	191	400	580	271
	30歳未満	42	56	131	209	89
	男性	35	49	96	185	72
	女性	7	7	35	24	17
	30歳以上50歳未満	96	123	250	355	172
	男性	82	92	202	306	141
	女性	14	31	48	49	31
	50歳以上	12	12	19	16	10
	男性	10	11	17	13	8
	女性	2	1	2	3	2
	女性比率	15.3	20.4	21.3	13.1	18.5
障がい者雇用	雇用率 (単体)	2.06	2.43	2.32	2.03	2.18
	雇用率 (国内グループ)	2.01	2.30	2.37	2.27	2.34
再雇用制度	利用者数	242	313	389	475	545
	男性	235	305	376	451	510
	女性	7	8	13	24	35
業績とキャリアについての定期的評価を受けている正規従業員比率		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性管理職 (グループ全体)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
女性管理職 ※1 ※2	人数	—	—	163	182	221
	比率	—	—	5.5	5.7	6.3
	人数 (上級管理職※3)	—	—	10	16	20
	比率 (上級管理職※3)	—	—	2.2	3.3	3.7

※1 女性管理職比率　算定方法: 女性管理職人数 / 管理職人数×100　管理職人数には高度専門職 (2022年3月期より)、定年後再雇用者 (2024年3月期より) を含む
※2 3月31日現在　※3 グローバル人事制度による一定レベル以上または一定職位以上の社員

女性管理職 (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
女性管理職※1※2	人数	23	26	46	51	67
	比率	2.0	2.2	2.6	2.7	3.1

※1 女性管理職比率　算定方法: 女性管理職人数 / 管理職人数×100　管理職人数には高度専門職 (2022年3月期より)、定年後再雇用者 (2024年3月期より) を含む　※2 3月31日現在

社員の定着 (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
社員の定着	入社3年後定着率※	93.8	94.1	94.7	92.7	93.1
	男性	94.6	94.8	95.0	93.2	93.6
	女性	88.6	89.3	93.5	90.6	90.9
	平均勤続年数	17年2カ月	17年4カ月	17年2カ月	16年8カ月	16年6カ月
	男性	17年5カ月	17年7カ月	17年6カ月	16年10カ月	16年8カ月
	女性	15年11カ月	15年10カ月	15年8カ月	15年7カ月	15年7カ月

※ 直近5年平均

離職 (グループ全体)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
離職※	離職者数	—	—	589	599	415
	男性	—	—	507	509	351
	女性	—	—	82	90	64
	離職率	—	—	4.2	3.9	2.5

※ 自己都合による離職

離職 (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
離職※	離職者数	82	87	87	98	113
	男性	54	75	69	81	93
	女性	28	12	18	17	20
	離職率	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2

※ 自己都合による離職

ワーク・ライフ・バランス (日本)

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
年次有給休暇	取得率※1	72.6	62.5	64.6	70.0	80.6
リフレッシュ休暇	取得者数	901	688	512	1,731	630
	男性	773	610	435	1,485	547
	女性	128	78	77	246	83
配偶者出産休暇	取得者数	184	148	137	149	169
育児休業	取得者数	46	41	70	96	153
	男性	12	16	36	57	122
	女性 (取得率)	34 (97.1)	25 (92.6)	34 (97.1)	39 (97.5)	31 (100)
	復職者数	48	54	60	76	155
	男性	8	15	32	43	120
	女性	40	39	28	33	35
	復職率	94.1	96.4	95.2	98.7	100.0
	定着率	93.3	95.0	90.0	97.9	91.2
短時間勤務制度	利用者数	149	132	110	105	103
	男性	11	9	7	10	10
	女性	138	123	103	95	93
子の看護休暇	取得者数	625	510	547	599	661
	男性	428	353	373	424	513
	女性	197	157	174	175	148
子育て応援休暇	取得者数	125	86	80	98	113
	男性	26	29	23	33	45
	女性	99	57	57	65	68
介護休業	取得者数	2	2	1	4	6
	男性	2	0	0	4	5
	女性	0	2	1	0	1
介護休暇	取得者数	95	110	87	85	100
	男性	56	69	57	53	54
	女性	39	41	30	32	46
介護勤務制度	利用者数	2	0	4	0	1
	男性	1	0	2	0	1
	女性	1	0	2	0	0
配偶者転勤休業制度	利用者数	—	—	—	—	3

※1 年次有給休暇取得率　算定方法: (従業員※2の有給消化日数) / (従業員※2の有給付与日数) ×100　※2 非正規従業員を含む

製品 / イノベーション

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数		0	0	0	0	0
保有特許 (国・地域別) ※1	保有件数	18,137	18,692	19,572	21,645	23,249
	日本	5,348	5,484	5,703	6,307	6,715
	米国	4,606	4,822	4,988	5,360	5,603
	欧州	191	206	167	—※2	—※2
	韓国	3,223	3,363	3,731	4,683	5,111
	台湾	2,948	2,925	3,014	3,120	3,326
	中国	1,821	1,892	1,969	2,175	2,494

※1 2020年3月期~2022年3月期は社内データ、2023年3月期~はLexisNexis® PatentSight®データに基づき作成　※2 欧州については集計対象外

	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12	2022.12
グローバル特許出願率※1	79.8	74.3	74.6	80.1※2	79.9※2

※1 各年 (暦年) において出願に至った発明件数のうち、日本以外へ出願された割合
※2 各国への出願分に特許協力条約 (PCT: Patent Cooperation Treaty) に基づく国際出願分を追加

		2019.12	2020.12	2021.12	2022.12	2023.12
特許許可率※	日本	83.1	84.9	79.8	74.5	81.8
	米国	85.5	87.3	83.9	81.5	80.7

※ 各年 (暦年) において審査が完了した特許出願のうち、許可された割合

顧客

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
顧客満足度調査において「大変満足」または「満足」回答を選択した割合	93.3	96.7	100.0	100.0	100.0

安全

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
基礎安全教育受講率	100	100	100	100	100
上級安全教育受講率	100	100	100	100	100
休業災害度数率 (LTIR)	0.51	0.63	0.66	0.83	0.31
労働時間20万時間当たりの人身事故発生率 (TCIR)	0.23	0.27	0.30	0.33	0.15

調達

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
社会的クライテリアを使用してスクリーニングした新規重要サプライヤーの比率	100	100	100	100	100
サプライチェーンサステナビリティアセスメント改善率	35.8	23.1	31.5	30.5	29.2
サプライチェーンBCPアセスメント改善率	16.0	20.3	24.4	22.2	20.4
特定したRMAP準拠製錬所数 (特定率)	261 (100)	236 (100)	243 (100)	234 (100)	238 (100)

ガバナンス

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
取締役会に通知された重大な懸念事項の総数	0	0	0	0	0
組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、法的措置を受けた事例の総数	0	0	0	0	0
腐敗防止に関する研修を受講した執行役員数※1	0	15	20	28	0
取締役のうち腐敗防止に関する組織の方針や手順の通達をおこなったメンバーの総数 (比率) ※1	11 (100)	11 (100)	12 (100)	6 (100)	6 (100)
取締役のうち腐敗防止に関する研修を受講したメンバーの総数 (比率) ※1	11 (100)	0 (0)	0 (0)	3 (50)	0 (0)
業界団体などへの支出 (千円) ※2	29,927	32,036	56,374	73,313	82,263
政治関連団体への支出 (円)	0	0	0	0	0
取締役の平均在任年数	4.84	6.09	6.58	5.16	6.16
取締役会の平均出席率	99.39	98.96	99.50	98.62	99.09

※1 対象: 日本　※2 2022年3月期より対象団体を見直しました

コンプライアンス

	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
倫理基準教育・誓約の実施率※1	—	98.8	91.6	96.1	94.9※2
情報セキュリティ規約遵守の同意書確認率	100.0	99.4	99.9	100.0	99.3
社会経済分野の法規制違反により組織が受けた重大な罰金および罰金以外の制裁措置の総数	0	0	0	0	0
コンプライアンス違反により懲戒処分に至った件数※1 ※3	—	—	—	—	59
贈収賄/腐敗行為	—	—	—	—	0
競争法/独占禁止法違反	—	—	—	—	0
マネーロンダリング/インサイダー取引	—	—	—	—	0
情報セキュリティ違反/知的財産権侵害/個人情報保護違反	—	—	—	—	3
利益相反行為	—	—	—	—	0
ハラスメント行為	—	—	—	—	22
その他 (服務規律違反)	—	—	—	—	34

※1 対象: グループ全体　※2 対象期間2024年3月～5月　※3 東京エレクトロングループ倫理基準、社内規程などの違反を含む

社会貢献

		2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
社会貢献支出額 (百万円) ※		250	244	170	301	533
現金寄附内訳比率	慈善寄附 (チャリティー団体への資金・物資の拠出)	4	13	15	9	7
	コミュニティ投資 (地域の活動を支援するための支出)	68	62	75	40	76
	コマーシャル・イニシアティブ (自社事業成長に向けた支出)	28	25	10	51	17

※ 災害義援金を除いた当社社会貢献活動の支出額

株式情報 (2024年3月31日現在)

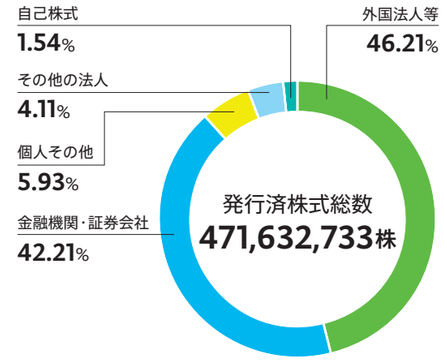
社名	東京エレクトロン株式会社 〒107-6325 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー
設立	1963年11月11日
定時株主総会	6月
株式の状況	一単元の株式数　100株 発行可能株式総数　900,000,000株 発行済株式の総数　471,632,733株 株主数　48,167名
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場 (証券コード: 8035)
会計監査人	有限責任 あずさ監査法人
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先・電話照会先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031 (フリーダイヤル)
ウェブサイト	www.tel.co.jp

大株主の状況

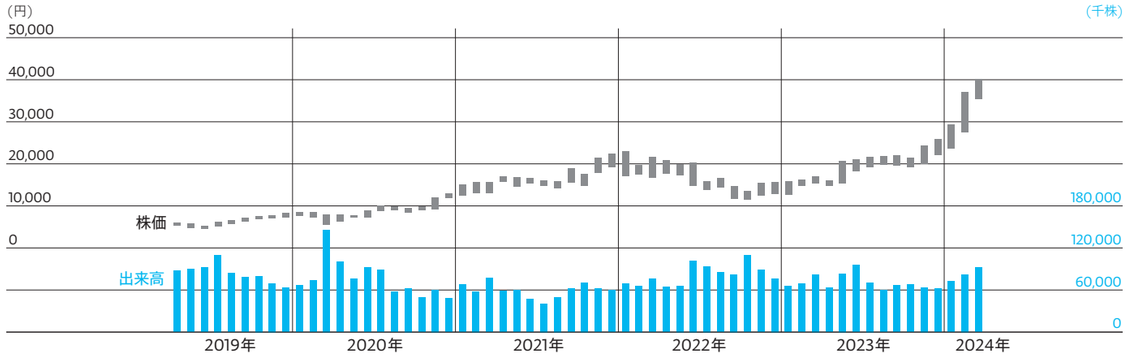
株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	117,029	25.20
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	48,367	10.41
JP MORGAN CHASE BANK 385632	15,743	3.39
株式会社TBSホールディングス	15,112	3.25
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234	9,778	2.10
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	8,374	1.80
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES	7,291	1.57
GOVERNMENT OF NORWAY	7,288	1.56
JP MORGAN CHASE BANK 385781	6,196	1.33
JPモルガン証券株式会社	4,706	1.01

(注) 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています

所有者別株式分布状況



株価・出来高の推移



	2020.3	2021.3	2022.3	2023.3	2024.3
最高株価 (円)	8,625	15,773	23,057	20,943	40,160
最低株価 (円)	4,587	6,308	14,223	11,517	14,810
株主総利回り (%) (比較指標: 配当込みTOPIX)	130.9 (90.5)	301.0 (128.6)	412.6 (131.2)	328.8 (138.8)	777.3 (196.2)

※ 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しています。2020年3月期から当該株式分割がおこなわれたと仮定して株価を算出しています